

证券代码：300735

证券简称：光弘科技



惠州光弘科技股份有限公司

DBG Technology Co., Ltd

(惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号)

向特定对象发行股票 募集说明书

保荐人（主承销商）



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(中国（上海）自由贸易试验区商城路618号)

二〇二五年十一月

声 明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意以下风险，欲详细了解，请认真阅读本募集说明书“第八节 与本次发行相关的风险因素”。

一、经营与业务风险

（一）国际形势动荡及国际化管理的风险

现阶段国际贸易形势复杂多变，为整个电子行业带来诸多不确定因素。公司从事的电子制造行业可能会受到关税政策的影响。关税政策会推动电子制造供应链在具有地缘优势、政策优势和成本优势的地区投资布局新产能，降低因特定区域加征关税所带来的经营风险；同时也会促使企业推动技术创新，提高产品附加值，增强在高关税环境下的竞争力。在此背景下，公司正积极向海外市场进军，加速在东南亚、欧洲、美洲、非洲等地区布局，在绕开贸易保护主义所带来的壁垒的同时寻找新的机遇。

公司国内工厂生产的产品主要提供给境内客户，由客户实现终端销售，直接外销的金额及占比有限。公司在海外布局的生产场地以在当地实现终端销售为主。本次收购完成后，公司的全球化布局从东南亚进一步拓展至在美洲（墨西哥）、欧洲（法国）以及非洲（突尼斯）新增制造基地，全球化布局进一步完善，可以更灵活调整供应链策略以应对包括加征关税在内的限制性政策影响。

报告期内，公司境外收入分别为 125,289.95 万元、238,174.42 万元、295,448.93 万元、167,374.67 万元，占公司当期收入比例分别为 29.98%、44.09%、42.93%、50.44%，比重逐步提升且报告期最后一期末占比较高，主要系 2025 年 5 月完成对 AC 公司的收购，合并了 AC 公司的境外销售收入，使得境外收入金额占比逐步提升。海外布局的推进为公司新时代下全球化管理带来了新的挑战，海外市场的拓展及全球化管理体系的构建都存在不确定性，可能存在公司实际经营结果不及预期的风险。

（二）客户集中的风险

2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月，公司来自前五名客户（合并口径）的销售收入金额分别为 306,289.68 万元、411,750.85 万元、497,100.25

万元和 201,124.30 万元，占营业收入的比例分别为 73.28%、76.22%、72.23%和 60.61%，主要客户收入占比较高。如果主要客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，公司可能无法持续获得客户订单以及项目收入，将对公司的生产经营带来不利影响。

二、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金投资项目是发行人结合目前行业政策、行业发展、竞争趋势以及发行人发展战略等因素，在现有业务良好的发展态势和充分市场调研的基础上提出的。项目的实施将使得发行人的业务规模和范围将进一步扩展，行业地位提升，有利于发行人进一步增强核心竞争力。但在项目实施过程中，不排除因市场环境、产业政策、技术革新等不确定或不可控因素；或发行人综合管理能力、市场竞争能力、资金实力、技术实力不足等内部因素所带来的风险，从而对项目的顺利实施和预期效益造成不利影响。

（二）标的资产海外经营的合规风险

收购标的资产前，本公司没有在欧洲、美洲、非洲的投资项目，对设立于欧洲、美洲、非洲公司的企业文化、法律法规、商业惯例以及工会制度等经营环境将需一段时间适应，公司因而面临一定的管理和运营风险。同时，AC 公司及其子公司分布于境外多个国家，其实际运营受到不同国家税务、人力资源、环境保护等法律的监管。如公司后续无法对 AC 公司开展统筹管理，未能发现标的资产在海外经营中可能存在的因税务、人力资源、环境保护等各方面不符合当地法规而导致诉讼、处罚等情况，则可能引发生产经营与财务管理等方面的风险，进而对本公司的盈利状况、长远发展与股东价值的实现造成负面影响。

（三）标的公司经营业绩亏损风险

2024 年度，标的公司营业收入为 317,872.82 万元，净利润为-5,434.84 万元。标的公司经营业绩亏损，主要系当期标的公司产生较大的汇兑损失，使得当期财务费用大幅提高所致。目前，标的公司整体经营状况良好，且为应对此类风险，标的公司已对部分外币结算的销售和采购交易签订了远期外汇合同，用于管理外

汇风险。但如果未来行业竞争加剧、汇率持续波动或标的公司整合情况不及预期等，可能导致标的公司经营业绩进一步恶化，进而对上市公司整体经营业绩产生不利影响。

三、财务风险

（一）业绩波动风险

2025 年 1-6 月，公司经营情况良好，实现营业收入 331,848.72 万元，同比增长 0.17%，实现净利润 11,167.20 万元，同比下滑 16.02%。公司营业收入增长的情况下净利润有所下降，主要系行业竞争加剧、产品结构调整及业务整合等因素影响，使得毛利额下降和期间费用有所增加。公司持续打造国内、国外双循环的业务体系，满足品牌客户市场全球化的需求，致力于与客户在全世界范围展开更广泛合作。随着收购 AC 公司等一系列业务布局举措落地，公司有望迎来新一轮业绩增长点。但若市场、行业发展及业务拓展发展未达到预期，公司经营业绩可能存在下滑的风险。

（二）毛利率下滑的风险

2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 18.56%、17.53%、12.83%和 11.57%，整体存在一定的下降趋势，主要系行业竞争加剧、产品结构调整及业务模式变化等因素综合导致。

报告期内，公司营业收入主要来自消费电子类业务和汽车电子类业务。消费电子类、汽车电子类业务的收入、占比和毛利率情况具体如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 1-6 月			2024 年度			2023 年度			2022 年度		
	金额	占比	毛利率	金额	占比	毛利率	金额	占比	毛利率	金额	占比	毛利率
消费电子类	183,437.16	55.28	14.13	471,347.83	68.50	14.65	425,468.00	78.75	18.66	333,464.92	79.78	19.50
汽车电子类	114,418.63	34.48	7.14	159,190.39	23.13	5.64	70,291.68	13.01	10.79	17,055.58	4.08	20.30
小计	297,855.79	89.76	—	630,538.22	91.63	—	495,759.68	91.76	—	350,520.50	83.86	—
营业收入合计	331,848.72	100.00	11.57	688,141.22	100.00	12.83	540,244.90	100.00	17.53	417,978.02	100.00	18.56

报告期各期，公司的消费电子业务毛利率分别为 19.50%、18.66%、14.65%和 14.13%，主要系（1）业务模式占比变化：自购料模式可以大大加深与客户的合作，是 EMS 企业进一步发展的必经之路，公司自购料模式（OEM 业务）销售占

比逐年增长，毛利率较公司传统的客供料模式低；（2）生产环节增加：随着经济环境变化及行业竞争逐步激烈，客户通过向上游转移更多生产环节/工艺以降低成本，导致上游企业毛利率下滑。

报告期各期，公司汽车电子业务毛利率分别为 20.30%、10.79%、5.64%和 7.14%，主要系（1）公司汽车电子类业务在报告期内逐步开拓，成功进入知名汽车零部件供应商的供应链行列，2023 年以来随着市场及客户的开拓，业绩规模快速增长，公司为开拓市场给予新进客户一定的价格让利，故毛利率有所下降；

（2）2024 年以来，公司汽车电子类业务从销售传感器为主逐步开拓至销售高单位售价的 ADC 制成板，其销售占比上升，其成本也更高，且公司为开拓汽车电子市场采取更具有竞争力的定价策略，因此毛利率略低；（3）2025 年 5 月起，AC 公司收入纳入公司合并范围，汽车电子业务为 AC 公司最主要业务，导致公司汽车电子产品结构发生变化，来自汽车电子业务的收入及占比大幅提升；产品毛利率较上年同期增加 2.63%，主要系经过前 2 年对汽车电子市场的开拓，以及逐渐开始形成规模经济，若剔除 AC 公司，2025 年 1-6 月光弘科技汽车电子产品的毛利率为 6.02%，较上年同期增加 1.51%，毛利率有所上升；以及 AC 公司主营业务为汽车电子类，且在该行业深耕多年，相对而言毛利率略高。

未来，若上述因素出现重大不利变化或公司未能把握新兴市场机遇、维持客户和品牌优势、积极推进产品升级，可能面临毛利率继续下降的风险，对经营业绩造成不利影响。

（三）应收款项回收风险

2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 6 月末公司应收账款账面价值分别为 100,206.99 万元、157,100.11 万元、136,568.76 万元和 174,622.06 万元，占资产的比例分别为 17.21%、20.85%、16.62%、18.15%，虽然公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，且公司已经采取了严格的应收账款回收管理措施，以降低应收账款不能按期收回的风险，但是随着业务规模的扩大，公司应收账款金额可能进一步增加。如部分客户经营状况等发生不利变化或公司对应收账款催收不力，公司可能面临应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账的风险，进而影响公司的经营业绩和资金的正常周转。

（四）汇率波动风险

公司外销收入主要以卢比等外币结算。报告期内，公司境外销售收入分别为125,289.95万元、238,174.42万元、295,448.93万元和167,374.67万元，占营业收入的比例分别为29.98%、44.09%、42.93%和50.44%。未来公司计划有序拓展海外市场，外销收入整体规模预计将逐渐增加。近年来我国央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，人民币的国际化程度有望进一步提高，人民币汇率的双向波动呈现常态化。人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定因素，汇率的波动将影响公司外销产品的价格水平及汇兑损益，进而对公司经营业绩产生一定影响。

（五）本次收购完成后的商誉减值风险

截至2025年6月30日，发行人因本次收购形成商誉账面价值为10,639.79万元。根据企业会计准则规定，商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。若未来发生商誉减值，则可能对本公司业绩造成重大不利影响。

四、与本次发行相关的风险

（一）审批风险

本次发行尚需深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公司本次发行能否取得相关批准或核准，以及最终取得批准及核准的时间存在一定不确定性。

（二）募集资金不足的风险

本次发行方案为向不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象定向发行股票募集资金。投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，可能面临募集资金不足乃至发行失败的风险。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、经营与业务风险	2
二、募集资金投资项目风险	3
三、财务风险	4
四、与本次发行相关的风险	6
目 录	7
第一节 释 义	10
第二节 发行人基本情况	13
一、公司概况	13
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况	13
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况	15
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容	31
五、技术水平及研发情况	40
六、现有业务发展安排及未来发展战略	43
七、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况	45
八、财务性投资情况	48
九、最近一期业绩波动的原因及合理性	51
十、报告期内深交所对公司年度报告的问询情况	53
第三节 本次证券发行概要	54
一、本次发行的背景和目的	54
二、发行对象及其与公司的关系	57
三、本次发行方案概要	58
四、本次发行是否构成关联交易	60
五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	61
六、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	61
七、发行人符合国家产业政策情况	62

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	64
一、本次发行募集资金使用计划	64
二、本次募集资金投资项目的具体情况	64
三、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响	72
四、本次募集资金投资项目可行性分析结论	72
五、本次募投项目是否涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业	72
六、募集资金投向与现有业务、前次募投项目的区别和联系	73
七、本次募集资金用于研发投入的情况	74
八、本次募集资金用于非资本性支出情况	75
九、募投项目实施后新增同业竞争或关联交易的情况	75
第五节 本次募集资金收购资产的有关情况	76
一、标的公司基本情况	76
二、标的公司的股权及控制关系	76
三、本次收购的背景及目的	77
四、标的公司重要经营性资产、主要负债、对外担保以及重要专利或关键技术情况	78
五、标的公司业务发展情况和主要财务情况	80
六、收购完成后对标的公司的影响	81
七、本次交易相关协议的主要内容	82
八、董事会对本次资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析	90
九、本次评估情况	91
十、本次收购资产最近三年评估或交易情况	92
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	93
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构变动情况	93
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响	94
三、本次发行后公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的业务和管理关系、关联交易及同业竞争变化情况	95
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人、控股股东及其关联人提供	

担保的情形	95
五、本次发行对公司负债情况的影响	95
六、本次发行融资间隔合理性说明	95
第七节 前次募集资金使用的基本情况	96
一、前次募集资金情况	96
二、对到账时间超过五年的前次募集资金用途是否存在变更的核查	101
第八节 与本次发行相关的风险因素	102
一、经营与业务风险	102
二、募集资金投资项目风险	103
三、财务风险	104
四、与本次发行相关的风险	107
第九节 与本次发行相关的声明	109
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明	109
二、发行人控股股东声明	116
三、发行人实际控制人声明	117
四、保荐人（主承销商）声明	118
五、发行人律师声明	120
六、发行人会计师声明	121
七、发行人资产评估机构声明	123
八、发行人董事会声明	124
附件一：发行人及其子公司拥有的不动产权情况	128
附件二：发行人及其子公司房屋情况	131
附件三：发行人及其子公司租赁房屋情况	133
附件四：发行人及其子公司拥有的专利情况	136
附件五：发行人及其子公司拥有的注册商标情况	144
附件六：发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权情况	146
附件七：发行人及其子公司集成电路布图设计情况	150
附件八：发行人及其子公司域名情况	151
附件九：发行人及其子公司经营资质情况	152

第一节 释 义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般释义		
光弘科技、公司、本公司、上市公司、发行人	指	惠州光弘科技股份有限公司
光弘投资、控股股东	指	光弘投资有限公司（DBG Investment Holdings Limited）
宏天创富	指	宏天创富有限公司
进科投资	指	进科投资有限公司
光弘集团	指	光弘集团有限公司（DBG Holdings Limited）
印度光弘	指	DBG Technology（India）Private Limited
华勤技术	指	华勤技术有限公司
龙旗科技	指	上海龙旗科技股份有限公司
航天科技	指	航天科技控股集团股份有限公司
AC 公司	指	All Circuits S.A.S.
MSL	指	MSL Circuits S.A.S.
BMS	指	BMS Circuits S.A.S.
TIS、TIS 工厂	指	TIS Circuits SARL
GDL	指	GDL Circuits S.A. de C.V.
AC Holdings	指	All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.，公司于新加坡设立的子公司
标的公司	指	All Circuits S.A.S.和 TIS Circuits SARL
标的资产	指	All Circuits S.A.S. 100%股权和 TIS Circuits SARL 0.003%股权
IEE 公司	指	IEE International Electronics & Engineering S.A.
交易对方	指	IEE International Electronics & Engineering S.A.、Hiwinglux S.A.
本次收购	指	上市公司通过向交易对方支付现金的方式购买其持有的 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的交易行为
本次发行、本次向特定对象发行	指	光弘科技本次向特定对象发行股票的行为
报告期、最近三年一期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月
最近一年及一期	指	2024 年度和 2025 年 1-3 月
北交所	指	北京产权交易所
保荐人、主承销商、国泰海通证券	指	国泰海通证券股份有限公司
发行人律师、中伦	指	北京市中伦律师事务所
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

评估师、国众联	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
募集说明书	指	《惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《适用意见第 18 号》	指	《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第 18 号》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《惠州光弘科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
专业释义		
SMT	指	Surface Mount Technology, 表面贴装技术, 新一代电子组装技术, 将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器件, 可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本, 以及生产的自动化
物联网	指	IoT (Internet of Things) 通过信息传感设备, 按约定的协议, 把任何物品与互联网相连接, 进行信息交换和通信, 以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
EMS	指	Electronic Manufacturing Services, 电子制造服务, 指生产厂商为电子产品品牌拥有者(客户)提供制造、采购、物流等一系列服务
PCBA	指	Printed Circuit Board Assembly, 经贴装元件的 PC 板称为 PCBA, 同时也指 PCB 空板经过 SMT 上件, 再经过插件的整个制程
NPI	指	New Product Introduction, 即新产品导入, 是现代制造业中的一个重要环节, 主要负责从产品概念设计到产品量产整个过程的技术实现与优化
IC 集成芯片	指	Integrated Circuit Chip, 是将大量的微电子元器件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上, 做成一块芯片, IC 集成芯片包含晶圆芯片和封装芯片
5G	指	第五代移动通信技术与标准, 是 4G 技术的延伸, 2019 年投入商用。关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络架构等
RoHS	指	即《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances), 主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准, 使之更加有利于人体健康及环境保护
REACH	指	即化学品注册、评估、许可和限制(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), 是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规
IQC	指	指来料的质量控制, 简称来料控制

PQC	指	制程控制，指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制
FQC	指	成品质量检验
ODM	指	是指由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式

注：本募集说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 发行人基本情况

一、公司概况

公司名称	惠州光弘科技股份有限公司
曾用名	惠州大亚湾光弘科技电子有限公司、惠州市大亚湾光弘科技电子有限公司
英文名称	DBG Technology Co., Ltd.
股票简称	光弘科技
股票代码	300735
统一社会信用代码	914413006178909639
注册资本	76,746.0689 万元人民币
法定代表人	唐建兴
成立日期	1995 年 3 月 24 日
上市时间	2017 年 12 月 29 日
注册地址	惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号；惠州市大亚湾西区响水河工业园永达路 8 号；惠州大亚湾石化大道西 38 号星华电子工业园 2 栋厂房 4 层，3 栋厂房 1、2 层，10 栋厂房 3、4 层；惠州大亚湾西区龙海三路 95 号
主要办公地址	惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号
邮政编码	516083
公司网站	http://www.dbg.ltd
电子邮箱	ir@dbg.ltd
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）股权结构

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的股权结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本比例
有限售条件股份	1,004.34	1.31%
无限售条件流通股份	75,741.73	98.69%
总股本	76,746.07	100.00%

（二）前十名股东情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	光弘投资有限公司	39,569.17	51.56
2	中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	933.38	1.22
3	苏志彪	615.22	0.80
4	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	570.77	0.74
5	香港中央结算有限公司	490.68	0.64
6	朱建军	452.64	0.59
7	中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	356.95	0.47
8	厦门恒兴集团有限公司	189.78	0.25
9	魏锦裕	135.88	0.18
10	李正大	111.31	0.15
合计		43,425.78	56.60

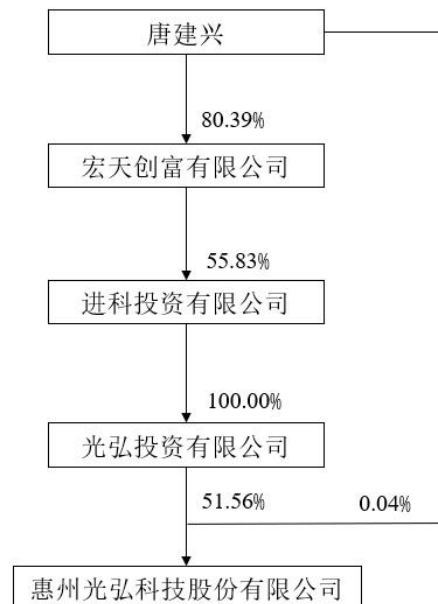
（三）控股股东及实际控制人情况

截至 2025 年 6 月 30 日，唐建兴直接持有公司股份 282,000 股，占公司总股本的 0.04%，并通过宏天创富、进科投资、光弘投资间接控制公司 395,691,660 股股份，占公司总股本的 51.56%；从而，唐建兴先生合计控制公司 395,973,660 股股份，占公司总股本的 51.60%，为公司实际控制人。唐建兴基本情况如下：

唐建兴先生，1957 年出生，香港特别行政区永久性居民，中学学历。1975 年 3 月至 1982 年 8 月就职于上海市商业一局，任业务员；1983 年 3 月至 1997 年 12 月就职于香港三洋电机有限公司，任高级经理；1998 年 1 月至 2001 年 2 月任光弘有限副总经理，2001 年 3 月至 2002 年 8 月任光弘有限总经理，2002 年 9 月至 2016 年 2 月任光弘有限董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，并兼任光弘科技电子（香港）有限公司、光弘集团有限公司、进科投资有限公司、

光弘投资有限公司、宏天创富有限公司、大亚湾发展有限公司、光弘电子（投资）有限公司、光弘电子（惠州）有限公司董事。

公司与实际控制人的具体股权控制结构如下图所示：



三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）发行人所处的行业

公司的主营业务为专业从事消费电子类、汽车电子类、网络通讯类、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整的电子制造服务（EMS），根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（二）行业主管部门、监管体制

公司所处行业的主管部门为国家工业和信息化部，其主要职能是负责统筹制订并组织实施相关产业政策、规划，对行业发展方向进行宏观调控；并承担电子信息产品制造的行业管理，组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化，促进电子信息技术推广应用等工作。

公司所处行业的自律性组织主要为中国电子企业协会，其主要职能是负责进行与电子信息相关业务的调查和研究；组织推广电子信息技术及应用成果，传达

工信部的政策及重点工作；为会员提供相关法律与法规指导，促进企业发展等。

公司提供电子制造服务的部分产品属于中国强制性产品认证（CCC 认证）制度目录中的第三类低压电器、第九类信息技术设备和第十一类电信终端设备。产品需要通过中国国家认证认可监督管理委员会制定的认证机构认证合格，取得相关证书并施加认证标志后，方能出厂、销售和在经营服务场所使用。

（三）行业主要法律法规及产业政策

为推动我国电子制造业技术水平提升，改善产业发展环境，促进行业持续、健康发展，国家相关部门出台了一系列法律法规及政策，具体如下：

序号	相关政策法规	时间	颁发部门	相关内容
1	《制造业企业数字化转型实施指南》	2024 年 12 月	工信部等三部门	深化新一代信息技术融合应用，加快产业模式和企业组织形态变革，提升企业核心竞争力，促进形成新质生产力
2	《工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》	2024 年 2 月	工信部等七部门	到 2035 年，制造业绿色发展内生动力显著增强，碳排放达峰后稳中有降，碳中和能力稳步提升，在全球产业链供应链绿色低碳竞争优势凸显，绿色发展成为新型工业化的普遍形态
3	《电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案》	2023 年 8 月	工信部、财政部	加快信息技术领域关键核心技术创新和迭代应用，加强 Micro-LED、印刷显示等前瞻性产业布局。面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G 通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关，研究建立电子材料产业创新公共服务平台，发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功能
4	《关于促进电子产品消费的若干措施》	2023 年 7 月	发改委、工信部等七部委	加快电子产品技术创新，鼓励市场主体积极应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品智能化水平，培育电子产品消费新增长点，同时切实加强电子产品隐私保护、支持电子产品下乡、打通电子产品回收渠道等，促进电子产品消费持续恢复
5	《政府工作报告》	2023 年 3 月	国务院	加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。加快前沿技术研发和应用推广，促进科技成果转化
6	《数字中国建设整体布局规划》	2023 年 2 月	国务院	规划指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉。加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。
7	《科技部关于支持建设新一代人工智	2022 年 8 月	科技部	针对流程制造业、离散制造业工厂中生产调度、参数控制、设备健康管理等关键业务环节，综合

序号	相关政策法规	时间	颁发部门	相关内容
	能示范应用场景的通知》			运用工厂数字孪生、智能控制、优化决策等技术，在生产过程智能决策、柔性化制造、大型设备能耗优化、设备智能诊断与维护等方面形成具有行业特色、可复制推广的智能工厂解决方案
8	《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025年）的通知》	2022年5月	国务院	开展智能制造试点示范行动，遴选一批智能制造示范工厂和典型场景，促进提升产业链整体智能化水平
9	《政府工作报告》	2022年3月	国务院	启动一批产业基础再造工程项目，促进传统产业升级，大力推进智能制造，加快发展先进制造业集群，实施国家战略性新兴产业集群工程
10	《“十四五”数字经济发展规划》	2022年1月	国务院	实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系等
11	《“十四五”智能制造发展规划》	2021年12月	工信部等八部门	拓展智能制造行业应用，促进区域智能制造发展，提升产业集群智能化水平。大力发展智能制造装备，加强自主供给，壮大产业体系新优势
12	《“十四五”信息通信行业发展规划》	2021年11月	工业和信息化部	全面推进5G网络建设；推进移动物联网全面发展；推动数据中心高质量发展；构建互通共享的数据基础设施；加快车联网部署应用等
13	《习近平总书记在中共中央政治局第三十四次集体学习时的重要讲话》	2021年10月	-	推进重点领域数字产业发展，聚焦战略前沿和制高点领域，立足重大技术突破和重大发展需求，增强产业链关键环节竞争力，完善重点产业供应链体系，加速产品和服务迭代
14	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	2021年3月	国务院	聚焦新一代信息技术、通信设备、核心电子元器件、物联网等战略性新兴产业。提出深入实施智能制造和绿色制造工程，建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化
15	《政府工作报告》	2021年3月	国务院	推动产业数字化智能化改造，战略性新兴产业保持快速发展势头。加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型

（四）发行人所处行业的基本情况

1、EMS 行业基本情况及发展概况

（1）EMS 行业基本情况

EMS 行业系从集成电路表面贴装技术发展而来，随着电子产品的不断升级，其经过持续革新已逐渐成为全球电子产业垂直分工体系的重要一环。EMS 服务通常包含原材料采购、NPI、PCBA、成品组装、仓储物流等环节。EMS 行业发展初期主要为品牌商提供 SMT 服务，随着产业链分工的进一步细化以及上下游

合作模式的不断完善，品牌商逐渐将产品设计、工程开发、物料采购与管理、生产制造、物流运输、测试与售后服务等环节委托给 EMS 厂商，使得 EMS 行业的业务范围已全面覆盖整个产品生命周期的服务，行业市场规模逐渐增大。

（2）EMS 行业发展概况

随着 EMS 行业模式的日益成熟以及行业内企业服务能力的持续提升，全球 EMS 行业呈现出服务范围日益广泛、业务总量整体上升的发展趋势，根据 New Venture Research 的报告显示，2017 至 2023 年，全球 EMS 行业市场规模从 3,718 亿美元增长至 5,150 亿美元，年均复合增长率约为 5.58%，总体呈稳定增长态势。随着电子产品的更迭换代与技术创新步伐的加快，EMS 行业市场规模将持续稳步增长，预计 2028 年全球 EMS 市场规模有望达到 6,449 亿美元，复合增长率约为 4.60%。全球 EMS 行业的市场规模及预测情况如下所示：



数据来源：New Venture Research

随着消费电子、汽车制造、通信设备等下游行业集中化、专业化进程的不断推进，综合制造能力将成为行业选择服务商的重要考量，综合性的 EMS 制造服务可能逐步替代单一 SMT 贴片业务，将使得行业规模不断增长。

2、行业需求状况

EMS 行业需求主要来源于下游电子产品市场。近年来，以消费电子、汽车电子、网络通讯等为代表的细分电子产品市场发展迅速，创新技术层出不穷，为 EMS 行业带来了巨大的市场需求。未来，电子产品市场预计仍将保持增长趋势，为 EMS 行业发展提供充足的业务支持。

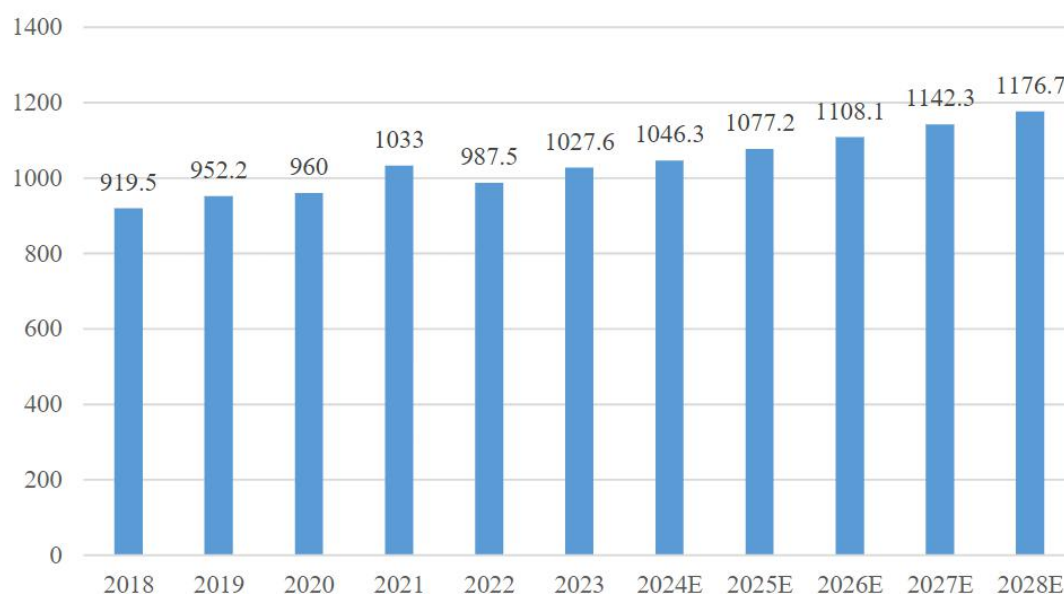
（1）消费电子行业基本情况及发展概况

消费电子类产品是用于个人和家庭日常使用的电子产品。近年来，随着移动通信技术的发展、居民收入水平的增加、以及消费电子产品功能不断完善，智能手机、平板电脑等产品市场需求旺盛，同时，消费电子产业的新兴领域也快速增长，整体产业保持高度活跃。

①消费电子市场发展情况

近年来，伴随着互联网技术的发展、消费电子产品制造水平的提高、居民收入水平的提升，促使消费电子产品与互联网相融合逐步成为趋势，使用消费电子产品逐步成为居民日常生活的一部分，消费电子产品的销售额也不断提高。根据 Statista 数据显示，2018 年至 2023 年，全球消费电子产品市场整体呈增长态势，市场规模从 2018 年的 9,195 亿美元增长至 2023 年的 10,276 亿美元，预计 2028 年将进一步增长至 11,767 亿美元，整体依旧保持高位。

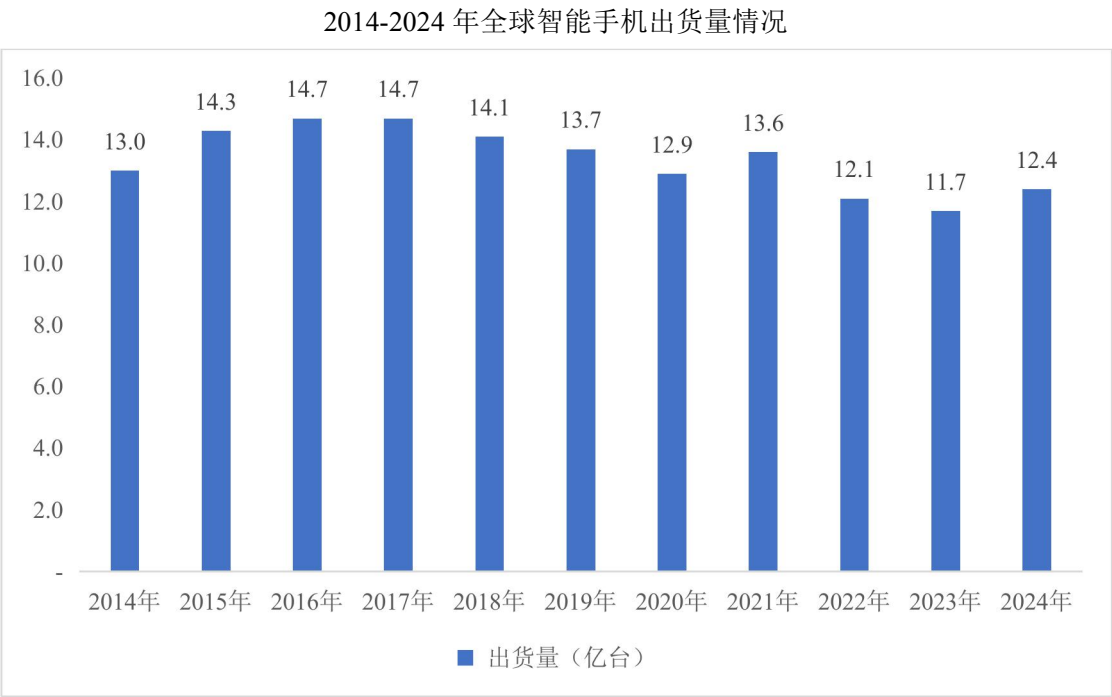
2018-2028（E）全球消费电子市场规模（单位：十亿美元）



数据来源：Statista

②智能手机市场发展情况

在全球消费电子设备制造市场中，以智能手机为代表的移动终端设备不断进行改革升级，形成了较大的市场需求。近几年全球智能手机市场情况见下图所示：



数据来源：IDC

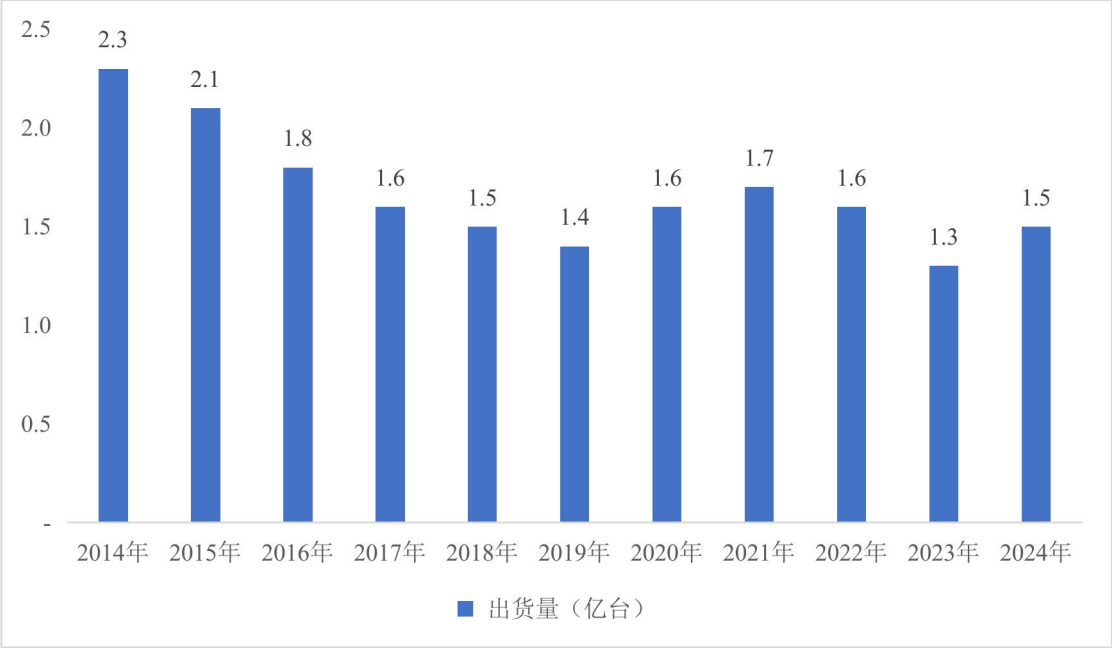
近年来，受智能手机渗透率在发达国家和中国等核心亚太市场趋于饱和，全球智能手机出货量自 2017 年达到峰值后略有下降。

从手机厂商来看，2024 年全球智能手机市场上苹果、三星、小米、传音、OPPO 出货量排名前五位，出货量分别为 2.26 亿部、2.23 亿部、1.69 亿部、1.07 亿部、1.04 亿部。尽管全球智能手机出货量有所下降，但中国主要手机厂商（小米、OPPO、传音）的出货量仍处于较高水平。

③平板电脑市场发展情况

受手机大屏化等因素的影响，在经历了前期的快速发展阶段之后，近年来平板电脑市场进入了平稳发展阶段。近几年全球平板电脑出货量如下图所示：

2014-2024 年全球平板电脑出货量情况

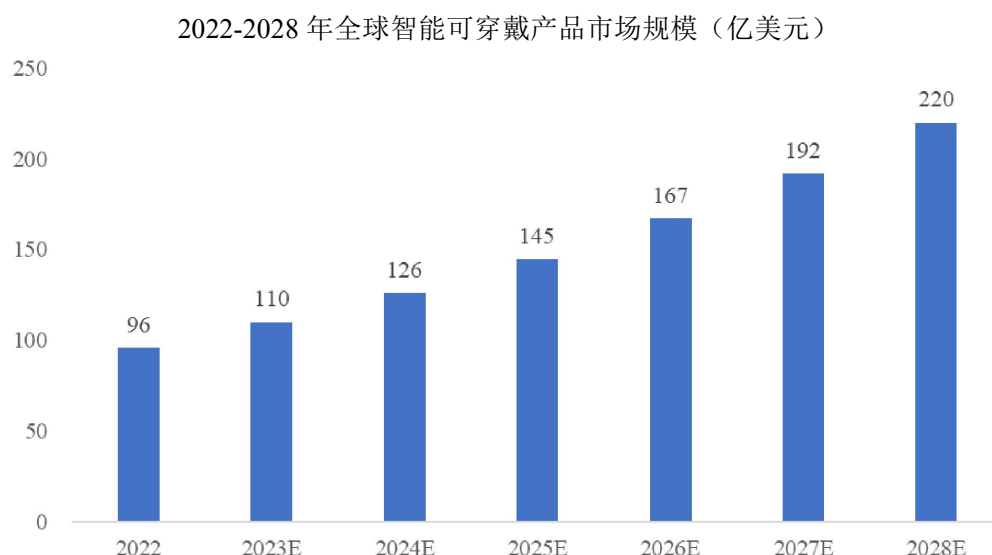


数据来源：IDC

2017 年 8 月，我国工信部发布《移动互联网综合标准化体系建设指南》，明确发展智能终端、移动业务与应用等领域，以促进我国移动互联网产业生态体系的进一步完善。在国家产业政策支持的背景下，二合一平板电脑在多媒体教育、信息化移动办公等领域有着广阔的发展空间。

④智能可穿戴市场

智能穿戴式产品是通过将传感、识别、通信、多媒体、音频等技术与穿戴产品相融合，实现个人娱乐、社交互动、健康检测等功能的智能硬件，包括 TWS 无线耳机，VR/AR 眼镜以及智能手表、智能手环等产品。据 Market.us 和 Globalnewswire 研究，全球智能可穿戴产品市场规模 2028 年将达到 220 亿美元，2023 年至 2028 年的复合增长率预计达 14.87%，市场规模持续快速增长。



数据来源：Market.us、Globalnewswire

随着物联网技术的普及、音频技术与各新兴应用场景的深度融合以及消费者对于娱乐、社交、健康等方面的需求日益增长，智能穿戴式产品类型不断丰富，各大主流消费电子品牌厂商正在积极推出智能可穿戴产品，为消费者提供全面的智能产品矩阵方案，全球智能穿戴式产品市场规模有望保持持续增长。

（2）汽车及汽车电子行业基本情况及发展概况

汽车及汽车电子行业是公司下游服务领域，汽车及汽车电子行业的相关情况具体如下：

①全球汽车行业基本情况及发展概况

汽车行业是全球经济重要的支柱产业之一，经过一百多年的发展和演变，产业已较为成熟。汽车的研发、生产以及销售对其他工业领域有较强的引领和带动作用，具有产业联系紧密、资金技术密集等特点。

过去十余年时间，全球汽车行业产销量整体呈稳步增长态势。根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，2019 年全球汽车销量超过 9,000 万辆，系近年高点。2019 年后，全球汽车产销量有所下滑。2021 年后，随着全球主要市场的恢复以及新能源汽车渗透率提升，汽车行业需求逐步提振，产销量有所回升，至 2023 年，全球汽车产销已基本恢复至 2019 年相近水平。

从全球汽车生产和消费地区来看，欧美等发达国家和地区仍是汽车产销的主要市场，规模较为稳定。而新兴国家汽车人均保有量较低，具有较大潜在需求。

以中国为例，2023 年，中国汽车产销量分别占全球汽车产销量的 32.24%，已成为全球最主要的汽车产销市场之一。总体而言，全球汽车行业规模近年保持稳步增长态势。

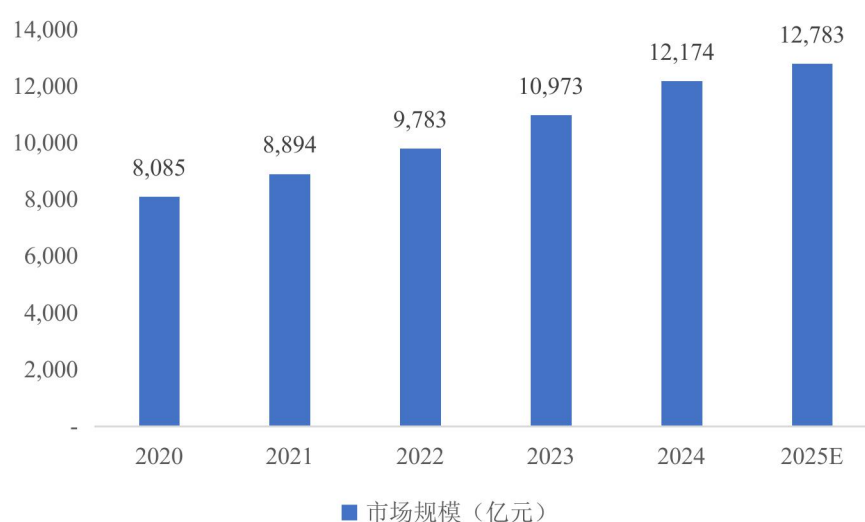
②汽车电子行业基本情况

汽车零部件制造业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的重要领域。汽车电子是车身电子控制系统和车载电子系统的总称，是汽车零部件的重要组成。其中，车身电子控制系统主要包括动力及传动系统、底盘及安全系统和车身及舒适系统；车载电子系统主要用于增强用户在车内的体验感，主要包括安全舒适系统及信息娱乐与网联系统等，包括汽车仪表、车载导航系统、汽车娱乐系统、车载通信系统等。

③汽车电子行业发展概况

汽车电子于二十世纪 70 年代引入汽车工业，最早应用于发动机燃油喷射控制系统，随着汽车功能的不断开发和电子技术的不断发展，汽车电子创新性用途不断开发，汽车电子开始广泛应用于汽车的各个领域，汽车电子成本占整车成本比例也逐渐抬升。随着新能源汽车渗透率的进一步提升，预计汽车电子成本占比至 2025 年有望达到 60%。

2020-2025 年中国汽车电子市场规模预测



数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院

随着汽车电子在汽车产业应用逐渐扩大，汽车电子行业规模持续增长。根据中商产业研究院发布的《2025-2030 年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研

究报告》，2024 年中国汽车电子市场规模约为 1.22 万亿元，较上年增长 10.95%。中商产业研究院分析师预测，2025 年中国汽车电子市场规模将达到 1.28 万亿元。

随着汽车工业的稳步增长及汽车电动化带来的汽车电子成本占比不断提升，汽车电子及相关的汽车领域 EMS 服务市场有望保持较为稳定的增长。

(3) 网络通讯行业基本情况及发展概况

网络通讯类产品是实现网络通信传输和转化的硬件设备，是用户与通信网络进行信息交互必不可少的媒介。由于网络通讯行业技术发展快速，互联网在加速信息交流、促进知识创新、推动经济社会发展、丰富人们娱乐生活等方面已经成为不可或缺的工具。在全球移动互联网用户数量不断增加的推动下，全球网络通讯市场的需求量也在迅速增加。以中国为例，互联网+、宽带中国战略的实施和宽带普遍服务补偿机制等政策的推行为互联网通信设备市场发展提供了强劲的市场发展动力，宽带建设已经作为通信产业重点建设项目。根据工信部数据，我国互联网接入端口数量从 2019 年的 9.2 亿个增加到 2024 年的 12.0 亿个，其中，光纤接入（FTTH）端口占比达到 96.5%。包括中国在内的全球各国政府对网络建设的大力投入，将为网络通讯类产品厂商带来巨大的市场机会。

2019-2024 年互联网宽带接入端口发展情况



数据来源：工信部

3、行业发展趋势

(1) 高集成度、小型化产品对 EMS 厂商制程能力提出了更高要求

随着集成电路技术的不断发展，电子信息制造业向高集成度、小型化方向发展的速度加快，对 EMS 厂商工艺制程能力提出了更高要求。元器件逐步小型化

导致 PCBA 焊接组装的密度越来越高，焊接组装难度越来越大；片状元器件、小引脚间距的大集成电路被大量使用在电子产品中，将对锡膏印刷机、贴片机、再流焊机设备及检测技术提出更高要求，需要更高的贴片精度及更精确的检测手段；此外，小型轻便高频的电子产品惧怕灰尘及颗粒物的污染，对车间环境洁净度的要求也更高。

（2）EMS 厂商柔性化智能制造能力不断提升

柔性生产即通过系统结构、人员组织、运作方式和市场营销等方面的改革，使生产系统能够生产不同类别产品，满足客户的多样化需求，提高设备利用率和员工劳动生产率，增强制造企业的响应速度和应变能力。随着下游品牌商对交付时间及交付品质要求的不断提升，部分 EMS 厂商逐渐开始引进升级智能制造装备和综合化信息系统，提升自身的柔性化智能制造能力，以求在不断加剧的竞争环境中取得竞争优势。

（3）定制化研发支持、定制化服务能力的重要地位不断凸显

伴随技术创新尤其电子信息技术创新，电子产品升级迭代不断加速，为 EMS 行业发展带来发展空间的同时，电子产品自身呈现多样化、个性化（小批量、多品种）的特点，品牌商的相应定制化需求也越来越多，EMS 厂商对品牌商客户的定制化研发支持、定制化服务能力的重要地位不断凸显。

（五）行业竞争格局

1、EMS 行业总体竞争状况

（1）全球行业竞争格局及主要企业

全球电子制造服务行业生产厂商众多，属于充分竞争行业，而行业内龙头企业积累了丰富的客户资源和行业经验，资产和营收规模大，保持相对稳定的领先地位，市场整体高度集中。随着全球知名电子品牌商陆续进入中国，国内 EMS 厂商综合实力不断提升，2022 年，全球排名前十 EMS 厂商中中国台湾企业占据领先地位，美国等外资企业实力较强，而中国大陆本土企业市场份额和影响力逐渐提升。近年来，我国在高精密电子产品和关键元器件制造能力上的创新实力逐渐凸显，加上中国拥有广阔的消费市场、丰富的劳动力资源以及日趋完善的产业配套体系，吸引不少电子品牌商从在中国设立办事处或制造分支机构，逐渐转变

为在本地完成核心零部件采购和整机组装，我国本土电子产业在国家政策的支持下也呈现快速发展态势，同时，随着我国对智能制造装备产业的大力支持，我国智能制造水平快速提升，本土 EMS 企业凭借自身的灵活性和配合客户需求的积极性，形成一定的制造规模与综合服务实力，赢得了国内外主流电子品牌商的认可，在 EMS 市场中占据的份额逐渐提升。

（2）中国行业竞争格局及主要企业

经过多年发展，我国大陆地区 EMS 行业形成了国际大型 EMS 企业和本土领先 EMS 企业相互竞争、共同发展的格局。比亚迪电子、环旭电子、深科技等部分领先的本土 EMS 企业紧紧跟随电子制造行业的发展趋势，逐渐形成了快速响应市场需求、总成本领先及产品质量稳定等优势。凭借自身经营优势，本土领先 EMS 企业与国际大型 EMS 企业展开竞争互动，承担了部分国际知名品牌商及主要本土品牌商的电子产品制造服务业务，获取了一定的市场份额。

2、行业内主要企业

公司是国内领先的 EMS 企业，拥有规范的生产管理体系、标准的操作流程、精细的检测标准和可视化的管控程序，具有市场响应速度快、运营效率高等特点，较强的整体制造能力和服务水平使其从本土 EMS 企业中脱颖而出，除发行人外，目前行业内其他代表性企业基本情况如下：

（1）环旭电子

环旭电子成立于 2003 年，于 2012 年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 601231。其业务范围涉及通讯类、计算机及存储类、消费电子类、工业电子类及车用电子类等的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等电子制造服务。

（2）工业富联

工业富联成立于 2015 年，于 2018 年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 601138。公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。

(3) 卓翼科技

卓翼科技成立于 2004 年，于 2010 年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为 002369。公司主要为通讯、计算机、消费类电子等 3C 产品网络通信、智能家居、可穿戴、自动化及消费产品领域的品牌商提供电子制造服务。

(4) 共进股份

共进股份成立于 1998 年，于 2015 年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 603118。公司主营业务为生产和销售各种电脑功能电路板、智能电路板、电脑软件、微型电脑整机等电子产品，包括网通及数通业务（PON 系列、AP 系列、DSL 系列等各类宽带接入终端，交换机、核心路由、服务器等数通产品）、移动通信业务（4G/5G 小基站设备、固定无线接入设备以及以移动通信为技术基础的专业和综合应用产品）、汽车电子业务（自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件研发、生产）等。

3、进入行业的主要壁垒

(1) 进入品牌商供应链的资质壁垒

国内外知名品牌商是 EMS 企业的优质客户来源，其对供应商的遴选、评审周期较长且要求严格。电子产品品牌商选择合作的 EMS 企业时，通常需经过 1-2 年时间的严格审核，对 EMS 企业是否具备安全的财务状况、规范的质量管理体系、先进的生产和检测设备、完善的仓储物流能力、良好的售后服务以及工人素质等多方面进行全面审核。EMS 企业经审核认证成功后成为品牌商的合格供应商，双方形成稳定的合作关系后一般不轻易更改。这种严格的资质审查和长期稳定的合作关系对拟进入者形成很高的壁垒。同时，新进入者由于缺乏相关领域的制造经验及市场口碑，即使采用低成本策略，也很难进入品牌商的制造供应链。

(2) 资金壁垒

EMS 行业是资金密集型行业，初期投入的资金门槛较高。EMS 企业不仅需要投入大规模资金购置设备、建设厂房及配套设施，还需要投入大规模资金开展原材料采购、提供仓储运输服务，并聘用相关的生产、技术人员。随着电子产品技术升级，满足新制造工艺的 SMT 设备和检测设备也需要不断升级换代，特别是精度高、自动化程度高的先进设备，其投入相对较大。此外，EMS 为满足日

常经营运转对流动资金需求也相对较高。

（3）技术壁垒

随着电子产品升级换代不断加速，EMS 企业必须在工艺技术上紧跟趋势，才能满足电子产品对配套供应链的需求。以智能手机为例，轻薄化、多功能化以及高性能化的发展需求要求 EMS 企业在更小尺寸、多层叠加的 PCB 上完成 SMT 贴装工艺，EMS 企业不仅需要引进新设备、新工艺，保证整体制造能力和生产工艺的先进性，同时需培养专业人才进行新工艺的开发、实施和管理，各环节缺一不可。这对拟进入此行业的 EMS 企业提出了很高的要求。

（4）规模化管理壁垒

不同品牌商的订单具有数量多、种类繁、规格各异等特征，对 EMS 企业的规模化生产能力要求较高。面对生产线体繁多、原材料品类复杂、订单数量大和客户需求多样等复杂情况，为实现大规模生产、低成本、高品质和高效率的目标，EMS 企业必须建立规范的生产管理体系、标准的操作流程、明确的检测标准和全过程可视化的监督机制，方能有效管理大规模生产过程。对拟进入的企业来说，规模化生产管理能力和成为又一道较高的门槛。

（5）供应链管理壁垒

大型 EMS 企业涉及的下游细分领域众多，包括消费电子、网络通讯、汽车电子等多个领域；提供的服务内容丰富，涵盖了原材料采购、生产制造、质量控制、物流配送乃至售后服务等；业务布局区域广阔，为配合知名品牌商的全球市场布局，EMS 企业需贴近目标市场进行全球采购、配送。因此，建立一套全面、有效的上下游供应链管理体系，在每一个服务环节及时、准确地满足不同领域、不同区域、不同客户对供应链配套的不同需求，是一项较为复杂的工作，对新进入行业企业形成了较高的壁垒。

4、公司主要业务的市场地位

公司是 EMS 提供商，在 EMS 中，公司以客户需求为导向，为其提供定制化的电子产品制造服务，服务内容涵盖原材料采购、新产品导入、半成品及成品组装、仓储物流等完整的电子产品制造环节。

目前全球 EMS 行业的市场集中度相对较高。经过多年发展，我国大陆地区 EMS 行业形成了国际大型 EMS 企业和本土领先 EMS 企业相互竞争、共同发展的格局。EMS 行业提供电子产品的制造服务，一般不涉及生产许可、特许经营等。EMS 企业与上游原材料供应商和下游消费电子、网络通讯、汽车电子、新能源等电子产品品牌商均按照市场化原则形成合作关系，不存在行政性壁垒，行业市场化程度较高。公司是国内领先的 EMS 企业，拥有规范的生产管理体系、标准的操作流程、精细的检测标准和可视化的管控程序，具有市场响应速度快、运营效率高等特点，较强的整体制造能力和服务水平使其从本土 EMS 企业中脱颖而出。

公司成立至今，始终致力于打造全球一流的电子制造平台，以匠心精神，推动制造业向智能化、绿色化、信息化方向发展。公司连续多年位列全球 EMS 50 强之列，2024 年度排名全球第 14 位。公司凭借质量高、交期准的优势，获得了国内外知名企业的认可。在智能手机、平板电脑和网络终端产品上，公司成功进入荣耀、小米、三星、OPPO 等全球知名品牌商，以及华勤技术、龙旗科技和闻泰通讯等领先 ODM 企业的供应链。在汽车电子领域，公司成功进入法雷奥等汽车产业链知名企业的供应商目录，为知名汽车品牌提供汽车电子部件制造服务，同时公司也为中国造车新势力提供全方位的汽车电子制造服务。2025 年 5 月，公司顺利完成总部位于法国的汽车电子 EMS 企业 AC 公司的收购，进一步拓宽汽车电子领域布局。

5、公司的竞争优势

（1）快速响应能力

随着电子产品生命周期越来越短，品牌商对 EMS 企业在快速响应方面的要求越来越高，EMS 企业能否根据市场和客户的需求变化快速组织生产并实现及时交货，决定了其是否能获取持续的订单并保持盈利。公司的快速响应能力主要体现在新产品导入快、生产周期短和仓储配送快三个方面。

（2）品质管控优势

公司已通过 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485、ISO45001 和 ANSI/ESD S20.20 等多项管理体系认证，建立了质量、环境及职业健康安全一体

化管理体系。此外，公司的品质管控能力得到了监督机构和客户的高度认可，荣获“中国质量诚信企业”、中国质量认证中心“A类企业”“荣耀金牌奖”“小米最佳合作奖”“华勤技术战略供应商”等荣誉。

（3）客户资源优势

公司自成立以来始终专注于为客户提供高质量的电子制造服务，掌握了多个领域的核心工艺技术，在客户资源的深度与广度上形成了自身独有的优势。在客户深度上，凭借一流的技术和过硬的产品质量，公司积累了一大批优质的客户，主要包括荣耀、小米、华勤技术、龙旗科技、闻泰通讯、法雷奥、诺基亚等业内领先企业，并与之建立了长期稳定的合作关系。在客户广度上，公司致力于打造多元化客户领域，主要客户广泛分布于消费电子、汽车电子、网络通讯、物联网、新能源等领域。

（4）领先的整体制造能力

上市以来，公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置，持续坚持对研发技术的大力投入，努力革新传统制造工艺，不断提升自动化生产水平，将制造工艺平台化。此外，公司高度重视学习探索先进制造工艺与产品应用，建立了工程技术中心统管公司研究开发和生产技术改造工作。公司目前已拥有专业化的工程开发与分析实验室，每年投入足额的实验、测试经费开展各种电子产品可靠性分析，以及各种电子及包装物料成分分析等实验，并在点胶技术、电子产品制造执行系统、焊接系统自动化技术等领域形成了核心技术。SMT段采用世界最先进的设备，工艺水平达到03015细小元件（0.1mm*0.05mm）以及微型球状栅格阵列封装的各种微细间距元器件，拥有芯片堆叠贴装工艺能力。整机组装、测试和包装产线达到高度自动化，实现贴片、组装、测试、包装全流程作业，达到国际领先水平。与核心客户共同建立先进技术开发实验室，共同开发前沿技术。公司将坚持推进智能制造与工业4.0的深度融合，既改善工艺技术水平，满足了客户差异化和柔性化需求，也有效提升了生产效率，降低消耗，提升了企业经营效益；继续深度融合数字化与先进制造，实现生产全流程和产品全生命周期的动态管理，提升柔性制造能力和品质一致性，持续推动产业数字化、智能化全面升级。

(5) 人才优势

公司的管理团队较为稳定，主要管理人员具有多年的电子制造业生产管理经
验，对 EMS 行业理解深刻，能准确把握行业发展趋势，根据公司的实际情况制
定清晰可行的发展战略。公司注重技术人才的引进和培养，公司的技术骨干大部
分具有通讯、电子电路、工业设计、软件开发、机电一体化等专业背景和丰富的
从业经验。

(6) 总成本领先优势

在精益生产方式的要求和指导下，公司建立了高效的节约文化，并将成本控
制的理念渗透到经营的各个环节，具有明显优于同行业的总成本领先优势。公司
目前已获 140 项专利技术和 57 项软件著作权授权。同时公司拓展与国内外专业
科研院所合作，开展课题研究和合作开发，借助外部的研发、技术与信息优势，
提升公司内部工艺技术水平。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

(一) 发行人主营业务基本情况

公司专业从事消费电子类、汽车电子类、网络通讯类、新能源类等电子产品
的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、
仓储物流等完整的电子制造服务（EMS）。

(二) 发行人主要产品与服务

公司提供电子制造服务的主要产品包括消费电子类（智能手机、平板电脑）、
汽车电子类、网络通讯类、新能源、数据中心等电子产品。

1、消费电子类

产品图示	产品功能	应用领域
 智能手机	以鸿蒙、Android 操作系统为 主，具备卫星通信、AI 助手、 快充、超远拍摄等多项功能	应用于通讯、娱乐、拍摄、智 能控制等场景

 平板电脑	一种小型、方便携带的个人电脑,以触摸屏作为基本的输入设备,具有手写识别、拍照、录像、无线网络通信等功能	应用于娱乐、影音、商务等场景
---	---	----------------

2、汽车电子类

产品图示	产品功能	应用领域
 感知相关产品	包括雷达、摄像头等,可监控周围环境、进行汽车定位	应用于汽车对行人、车辆的识别,以及导航、定位等
 域控相关产品	包括汽车主机、控制屏、公放产品、温度控制系统、行驶控制系统等,用于汽车控制、媒体显示等	应用于汽车控制,以及车内影音等
 汽车三电类产品	包括电机、电池、电控,为汽车提供制动力,是新能源汽车的动力来源	应用于汽车启动、制动,以及为运行提供动力等
 智能驾驶相关产品	辅助驾驶、提升驾驶体验,能实现自适应巡航、自动泊车、碰撞预警等功能	应用于汽车智能驾驶功能板块
 其他产品	包括 tbox、车灯等产品,让汽车可联网通信	应用于汽车移动网络、照明等

3、网络通讯类

产品图示	产品功能	应用领域
 网络路由器	连接网络并将网络信息导向其他网络上的设备	应用于家庭、办公室等环境网络接入
	各类基站相关产品,负责无线信号的发送、传输、接收	应用于基站建设

基站相关产品		
--------	--	--

4、其他主要产品

产品图示	产品功能	应用领域
 充电桩相关产品	从电网获取电能并转换、调节，最终传输到新能源汽车，可以进行快充、无线充等	应用于新能源汽车充电
 光伏、储能产品相关产品	包括逆变器、储能系统相关产品，可以转换电流，并实现电能的存储	应用于光伏、储能系统建设
 数据中心相关产品	实现数据的处理、计算、存储与管理	应用于数据中心建设

（三）发行人主营业务模式

公司是 EMS 提供商，在 EMS 中，公司以客户需求为导向，为其提供定制化的电子产品制造服务，服务内容涵盖原材料采购、新产品导入、半成品及成品组装、仓储物流等完整的电子产品制造环节。

公司具体的采购模式、生产模式、销售模式情况如下：

1、采购模式

（1）实行“以产定购”的采购模式

公司实行“以产定购”的采购模式，设立了采购统括部专门负责采购事宜，采购的原材料包括主材料（如电子元器件、PCB、五金件、塑胶件、包装材料等组成产品的单元或部件）和辅材料（如锡制品等）。公司结合生产计划所需用料预算和材料库存等情况，拟定出物料需求计划然后进行采购；针对各工场之间可通用的辅材料，先进行内部协调、统计、汇总，然后根据实际需求情况按月集中采购。

（2）采购渠道分为境内采购和境外采购

境内采购的原材料包括电子元器件、PCB、五金件、塑胶件、包装材料、锡

膏、助焊剂等，原材料国内市场供给充足，质量符合标准，且采购方便快捷。公司根据生产用料需求直接与供应商洽谈采购条件，并签订采购合同，收货并验收合格后在合同约定的账期内完成付款。

境外采购的原材料主要是部分客户 BOM 表选用的国际品牌主材料，主要包括电子元器件、PCB 等。公司通过子公司光弘集团进行境外采购，其操作流程具体如下：①公司根据用料需求提出采购条件、采购计划并制定采购单下达光弘集团；②光弘集团负责与境外供应商洽谈、签订采购合同并推进采购工作；③供应商在约定的时间内将货物、发票、装箱单等送至中国香港指定仓库，光弘集团确认收货；④光弘集团根据收货情况开具装箱单、发票等凭证予公司，公司则根据收到的凭证，逐项办理报关进口手续；⑤光弘集团按照合同约定的结算方式与境外供应商结算材料款；⑥公司向光弘集团支付采购价款。

（3）严格的供应商管理体系

对于新供应商的开发和认证，公司建立了较高的准入门槛，需对供应商的基本信息实施全面调查，并通过质量、价格、交期、服务等各方面的综合对比和评估考核其资质。对于主材料和重要辅材料供应商有专门的审查团队进行现场审核；对于有 RoHS、REACH 或无卤化要求的部品，供应商需提供环保证明资料及第三方测试机构出具的测试报告。预选合格供应商经管理层最终审批确认后，方可列入《合格供方清单》并实施批量采购。

公司持续开发和定期维护进入《合格供方清单》的供应商，每月根据供应商的质量、交付、服务、投诉等情况对供应商进行综合评分，年底进行总体评价确定是否继续合作。对列入《合格供方清单》的重要供应商，公司每年对其进行现场审核。对连续超过一年或以上未供货后需再次合作的，按照供应商开发控制流程重新进行评价和审查，确认合格后方可恢复合作。

2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求情况，进行生产调度、管理和控制。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点均设有 IQC、PQC、FQC 等岗位负责品质检测，力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。

3、销售模式

公司的销售模式为直接销售，即公司或子公司直接与客户签署合同，直接将货物销售给客户并进行结算。公司广泛采用行业交流、展会宣传、网站推广等形式开发客户资源。公司客户主要为国内外知名电子品牌商或 ODM 企业，他们对于供应商有严格的资质审核制度，通常情况下公司需通过客户 1-2 年严格的资质认证后才能进入其合格供应商体系，从而具备参与项目投标的条件。在确立最终合作关系前，公司还需通过客户对公司经营战略、质量管理、风险控制、流程 IT 等多个方面的现场审核。公司在正式获取订单前亦根据客户需求为其提供新产品的试制服务。通常情况下公司进入客户合格供应商体系后，即与客户保持长期稳定的合作关系。公司销售按照产品出货是否涉及报关出口分为境内销售和境外销售两种。

(四) 发行人的生产及销售情况

公司专业从事消费电子类、汽车电子类、网络通讯类、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整的电子制造服务(EMS)。具体经营模式及盈利模式，见本节“四、主要业务模式、产品或服务的主要内容”之“（三）发行人主营业务模式”。

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
消费电子类	183,437.16	55.28	471,347.83	68.50	425,468.00	78.75	333,464.92	79.78
汽车电子类	114,418.63	34.48	159,190.39	23.13	70,291.68	13.01	17,055.58	4.08
网络通讯类	16,491.81	4.97	42,144.01	6.12	34,141.65	6.32	58,905.25	14.09
其他	17,501.12	5.27	15,458.99	2.25	10,343.57	1.92	8,552.28	2.05
合计	331,848.72	100.00	688,141.22	100.00	540,244.90	100.00	417,978.02	100.00

报告期内，公司消费电子类业务占公司营业收入的比重在 50%以上，是公司营业收入的主要组成部分。随着新能源汽车产业的发展，公司积极布局汽车电子类业务并逐步取得成效，2023 年以来，公司汽车电子类产品收入持续增长，占比逐步提升。2023 年 4 月，公司成功对快板电子科技（上海）有限公司进行收购。2025 年 5 月，公司完成对总部位于法国的汽车电子 EMS 企业 AC 公司的收

购。基于上述收购，公司将在现有业务基础上进一步拓展在通信设备、汽车电子、工业控制等领域的发展，满足客户多元化服务的需要，并利用标的公司的优质客户资源，与公司现有业务展开协同发展，增强公司的综合竞争能力。后续，公司将寻求更多机遇，以资本为纽带，推进公司业务的多元化发展。

（五）发行人的采购情况

1、主要原材料采购情况

公司生产所需原材料包括电子元器件、电子配件、塑胶类、锡、胶水等辅料及其他原材料，其中，电子配件包含电池、充电器、摄像头、显示屏、指纹、数据线等。公司在境外及境内均具有良好的采购和配套渠道，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，原材料来源和质量有一定保证。报告期内，原材料采购情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子元器件	50,044.51	44.93	83,447.78	26.37	33,704.50	13.33	34,303.21	24.44
电子配件	37,835.83	33.97	142,794.61	45.13	147,904.75	58.48	55,183.93	39.31
塑胶类	6,539.95	5.87	38,386.88	12.13	37,747.94	14.93	28,305.28	20.16
锡、胶水等辅料	3,648.52	3.28	15,255.39	4.82	3,601.90	1.42	2,481.10	1.77
其他	13,313.84	11.95	36,537.02	11.55	29,946.68	11.84	20,107.26	14.32
合计	111,382.64	100.00	316,421.68	100.00	252,905.77	100.00	140,380.77	100.00

注：上述原材料采购金额不含设备相关采购金额。

2023 年度，电子配件采购额有较大增长，主要原因系印度光弘智能手机订单量较大，相关业务需公司自行采购电池、充电器、摄像头、屏幕等电子配件。2024 年度，电子元器件、锡、胶水等辅料采购金额有较大增长，主要原因系公司汽车电子业务增长，导致相关原材料需求增长。

2、主要能源采购及耗用情况

报告期内，公司生产消耗能源主要为电力及自来水，报告期内供应稳定。报告期内，发行人境内主要公司电力及自来水消耗情况如下：

能源名称	项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
------	----	--------------	---------	---------	---------

自来水	数量（立方米）	281,944.00	737,650.00	652,353.00	638,749.00
	金额（元）	1,322,317.36	3,334,944.06	2,929,064.97	2,867,983.01
	单价（元/立方米）	4.69	4.52	4.49	4.49
电	数量（度）	55,978,325.00	123,902,210.00	102,046,615.00	95,676,455.00
	金额（元）	35,530,083.25	86,543,632.48	80,862,134.92	73,417,164.71
	单价（元/度）	0.63	0.70	0.79	0.77

3、报告期内前五名供应商采购情况

报告期内，公司向前五名供应商的采购情况具体如下：

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
向前五名供应商的采购金额总计（万元）	64,889.69	197,394.05	112,459.87	70,616.06
前五名供应商采购总额占公司当期采购总额的比重	33.07%	49.86%	37.95%	43.24%

报告期内，发行人不存在向单个供应商采购比例超过 50%的情况。龙旗科技及华勤技术系发行人主要关联方、持股 5%以上股东，是发行人报告期内主要供应商。除此之外，发行人董事、高级管理人员、主要关联方和持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（六）与发行人业务相关的资产情况

1、主要固定资产情况

公司的固定资产主要包括：房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备。截至 2025 年 6 月 30 日，公司固定资产原值为 586,878.36 万元，净值为 308,711.05 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋及建筑物	91,833.83	26,165.39	65,668.44	71.51%
机器设备	451,963.42	232,352.13	219,603.57	48.59%
运输工具	1,998.92	1,220.01	778.91	38.97%
办公设备	15,408.17	10,166.94	5,241.23	34.02%
其他	25,674.03	8,255.12	17,418.91	67.85%
合计	586,878.36	278,159.59	308,711.05	52.60%

(1) 不动产权

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的不动产权情况，见本募集说明书“附件一：发行人及其子公司拥有的不动产权情况”。

发行人及其子公司合法拥有该等不动产权的所有权，不动产权权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

(2) 房屋

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司自有房屋情况，见本募集说明书“附件二：发行人及其子公司房屋情况”。

发行人及其子公司合法拥有上述不动产权的使用权，不动产权权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

(3) 租赁房屋

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司租赁房屋情况，见本募集说明书“附件三：发行人及其子公司租赁房屋情况”。

发行人及其子公司合法拥有上述不动产权的使用权，不动产权权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

(4) 其他固定资产

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的机器设备、运输工具、办公设备等与生产经营相关的主要资产不存在产权纠纷或者潜在争议，不存在其他权利受到限制的情况。

2、主要无形资产情况

(1) 专利权

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共拥有和使用 143 项专利，具体情况见本募集说明书“附件四：发行人及其子公司拥有的专利情况”。

发行人及其子公司合法拥有和使用上述专利，上述专利权不存在纠纷或潜在的纠纷。

（2）注册商标

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共拥有 7 项境内注册商标、21 项境外注册商标，该等商标均已取得商标注册证书，具体情况见本募集说明书“附件五：发行人及其子公司拥有的注册商标情况”。

发行人及其子公司拥有的上述注册商标不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

（3）计算机软件著作权

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司取得计算机软件著作权 57 个。著作权具体情况见本募集说明书“附件六：发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权情况”。

（4）集成电路布图设计

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共拥有和使用 2 项集成电路布图设计，具体情况见本募集说明书“附件七：发行人及其子公司集成电路布图设计情况”。

（5）域名

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共拥有和使用 41 项域名，具体情况见本募集说明书“附件八：发行人及其子公司拥有域名情况”。

（七）发行人海外经营情况

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人拥有的境外控股子公司情况如下：

序号	公司名称	注册地	持股比例	主要业务
1	光弘科技电子（香港）有限公司	中国香港	100.00%	投资
2	光弘集团有限公司	中国香港	100.00%	贸易和投资
3	光弘科技（海外）有限公司	中国香港	100.00%	投资
4	勤弘投资有限公司	中国香港	100.00%	投资
5	正弘电子有限公司	中国香港	78.95%	投资
6	光弘科技（投资）有限公司	中国香港	51.00%	投资
7	DBG Technology（India）Private Limited	印度	50.82%	电子制造及销售
8	DBG Technology（Vietnam）Co.Ltd.	越南	51.00%	电子制造及销售
9	DBG Technology BD Ltd.	孟加拉	80.00%	电子制造及销售

序号	公司名称	注册地	持股比例	主要业务
10	UNIVERSAL ELECTRONICS DEVELOPMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	100.00%	贸易
11	ALL CIRCUITS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD	新加坡	100.00%	投资
12	ALL CIRCUITS S.A.S.	法国	100.00%	电子制造及销售

发行人境外重要子公司的设立及境外经营情况合法、合规。

五、技术水平及研发情况

（一）研究开发机构及人员设置

1、研发机构设置

光弘科技以工程技术中心为核心构建研发体系，统筹技术战略与创新转化。该中心下设 IT 研发部、SMT 技术研发部、组装技术研发部及检测中心四大核心部门：IT 研发部专注智能制造系统开发及信息化平台建设；SMT 技术研发部攻克微电子封装工艺，掌握微型元件贴装等国际领先技术；组装技术研发部推动机器人集成应用，打造自动化产线；检测中心持续投入开展可靠性验证。创新层面设立精益生产推进部和先进技术实验室，前者持续投入实施智能制造升级，后者与国内知名企业共建联合实验室，突破汽车电子、新能源设备领域技术。

2、研发人员情况

报告期各期末，公司研发人员数量分别为 1,336 人、1,406 人、1,320 人和 1,192 人。公司注重学习国内外领先的生产管理经验，持续引进高素质研发人才，加快将信息化和自动化技术融入生产制造各个环节的进程。同时，公司鼓励专业技术人员创新研发、精益生产，并提高工程技术中心的专利数量和质量，确保研发项目的高品质和研发人员的稳定性，全面提升公司的研发能力。

（二）主要研发项目

截至报告期末，公司主要研发项目如下：

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
水洗制程与离子污染度检测研究	降低电子产品因离子污染造成的漏电、短路、容值飘移等风险。	已完成	1.通过水洗工艺去除电路板上的污染物，显著提高产品电气性能。 2.通过去除电路板上的污染物，减	提高产品质量，满足客户对产品生产及检测要

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
			少因污染物引起的电路故障，保障产品的安全性和可靠性。 3.优化水洗工艺参数，提高清洗效率，减少生产周期从而提高生产效率。 4.采用环保的清洗剂和工艺，减少对环境的污染。	求，提升企业核心竞争力，符合公司发展方向。
手机摄像头光学解析检测研究	在光学性能方面，不同品牌、型号的手机相机镜头存在显著差异。现有检测方法在精度与效率方面存在局限性，因此，研究一种高效、准确的手机相机镜头光学检测方法具有重要的现实意义。	已完成	1.通过高效筛选出光学性能达标的镜头，确保手机拍摄出清晰、真实、无畸形的图像和视频，大幅提升用户的拍摄体验。 2.深入分析摄像头的光学特性，为手机厂商提供精准的数据支持，助力产品设计与性能优化。 3.在生产线上快速高效甄别出有光学缺陷的产品避免其进入后续生产组装环节，减少因镜头光学问题导致的手机拍照故障，降低产品次品率和生产成本。	提升产品质量，满足客户对产品生产及检测要求，提升企业核心竞争力，符合公司发展方向。
车载项目T-BOX自动化测试工艺研发	T-BOX 作为新能源车主要核心部件之一在当下市场有着明确高效率、高品质的诉求，所以需要对其产品特性、功能特性以及客户需求的分析，设计出自动化产线来实现高质量、高效率的需求。	产线已完成机械手视觉技术、传感器技术、运动控制技术等的优化。	1、产线实现自动测试框架模块化。 2、编写能够模拟用户操作、执行测试任务、验证测试结果，并可执行不同 T-BOX 产品测试需求的通用性高的脚本。 3、将人工智能和机器学习技术引入自动测试系统，进行智能分析，更快地发现和定位问题。 4、持续集成与优化。将技术集成到开发流程中，实现代码的自动构建、测试和部署，提高软件开发的效率和质量。	提升产线的自动化率，降低产品生产成本，提升企业核心竞争力，符合公司发展方向。
无线电探和测距产品智能化制程工艺研发	自动化生产能够降低生产成本、提高生产效率和产品一致性，减少人为误差，确保雷达的稳定性和可靠性。同时，为了满足汽车行业严格的质量标准和安全要求，必须采用先进的自动化生产工艺来保障产品质量。	产线工艺设备的硬件、软件已完成开发，整线的程序基本调试完成。	1、通过智能化制程工艺，自动化设备高效且精准地完成生产任务，降低人力成本，缩短生产周期。 2、项目研发的设备采用中通在线式、模块化设计理念，使设备对后续机型具有高度的改造灵活性和适应性，在面对市场需求变化或产品更新换代时可快速适应应对。 3、运用智能压力自适应控制技术、多参数协同优化的热风冷铆工艺及 AI 驱动的自适应视觉系统等，提升生产精度和产品质量。	提升产线的自动化率，降低产品生产成本，提升企业核心竞争力，符合公司发展方向。
消费类手机项目 IP68 级	提升智能手机、智能手表等电子产品的防尘、防水等级制造	已完成	1、通过 IP68 级防水工艺研究开发大大降低不良率。	提高产品良率，提升企业核心竞

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
防水工艺研究开发	工艺。		2、减少对人工的依赖，节省人力资源成本。	争力，符合公司发展方向。
消费类手机项目高速自动化产线研发	手机消费类产品面临成本和高品质化的压力越来越大，需提高产线的自动化率实现降本增效。	已完成	1、全流程实现自动化率提升30%。 2、效率提升20%。 3、人工成本降低10%。	提升公司在行业内的综合竞争能力，保持行业内的制造技术优势，符合公司发展方向。
车载埋高压磁芯PCBA装配工艺研究开发	随着新能源汽车产业的发展，高压应用成为了国家技术路线研究的重要项目。该项目主要是将传统高压器件通过在PCB上埋设线圈通过磁芯贴附工艺方式实现高压的转换工艺，将可以降低PCBA设计的密度（电子器件），减少功率损耗，降低生产成本。	已完成	通过采用高精度贴片机模组，匹配视觉引导系统，将磁芯与磁芯贴合，综合误差降低到0.1mm以内，CMK到达1.77；开发视觉引导、对位系统，优化运算逻辑，提升装配良率。	提高产品良率，提升企业核心竞争力，符合公司发展方向。
智能大尺寸平板制造工艺研究	消费类大尺寸平板在制造工艺主要为外观功能类损伤为主，同时大尺寸在制造过程中人因工程的配合是研究重点。该项目主要是通过自主研发的中通协作工作平台的方式实现制造产线的中通制造。通过模块化的功能组件的应用降低设备的成本，通过LCIA的应用降低人员的操作难度，来实现制造工艺的能力升级，实现高品质、快速、柔性的制造能力。	小试阶段	降低大尺寸平板装配的不良率，实现量化生产。	提高产品良率，提升企业核心竞争力，符合公司发展方向。
激光雷达产品PCBA全自动水洗工艺研发	随着新能源汽车产业的发展，大量的激光雷达产品应用在新能源车辆中实现视觉计算+雷达测距的智能辅助驾驶的功能。在激光雷达产品中采用了视觉芯片倒装技术需要电性能区域实现无异物、无残留的特殊特性。该项目主要的研究方向是通过水洗工艺的研究将产品清除助焊剂残留、异物作为主要研究方向。通过工艺路线的优化、参数的调优实现高品质的制造技术。	小试阶段	减少制造过程中残留的污染物，确保电路板的电气性能、可靠性和长期稳定性。	提高产品良率，提升企业核心竞争力，符合公司发展方向。
蜂巢车载OBC项目集成制造工艺研发	随着新能源汽车产业的发展，多合一的OBC产品成为行业主要的研究方向。该项目主要研究的方向为倒装焊接工艺、高功率器件焊接空洞工艺、大	研究阶段	提升车载OBC产品生产过程的自动化和智能化。	提升产线的自动化率，降低产品生产成本，提升企业核心竞争力，符合公司发

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	功率器件波峰焊接工艺以及多层部品垒叠累计公差等工艺,以实现高品质、高自动化率的要求。			展方向。

（三）获得技术授权、技术许可的情形

报告期内，公司不存在获得第三方技术授权、技术许可的情况。

（四）研发投入情况

报告期内，研发费用及占当期营业收入比例的情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
研发费用	7,122.46	13,786.87	12,869.40	10,965.03
营业收入	331,848.72	688,141.22	540,244.90	417,978.02
占营业收入比例	2.15%	2.00%	2.38%	2.62%

六、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）公司战略目标

公司本着“人才、效益、发展”的企业宗旨，聚焦于国内外知名品牌商的发展趋势，坚持高品质、低价格、严守交期、一流的服务及安全的工作环境五项基本原则，以创新工艺和精益品质打造高端制造平台，专注为消费电子、通讯设备、物联网、汽车电子、智能穿戴、新能源等领域的客户提供优质、安全、环保的产品和服务，致力于成为客户最可靠的合作伙伴。公司将积极把握 EMS 行业发展机遇，巩固现有成果，积极布局新兴智能硬件领域和国内、国际高端客户，深化智能制造，全面提升公司盈利能力，将公司打造成全球领先的 EMS 企业。

（二）未来三年的业务发展目标

公司将有序完善国内、国际运营布局，积极开拓客户资源，拓展高端产品领域，加强信息化和自动化建设，并积极引进高端人才，提升管理水平。公司具体业务发展目标如下：

在业务开拓方面，第一，扩大产能，提高现有产品的生产规模，扩大市场占有率。第二，完善产业流程布局，在传统业务基础上，以智能化制造对应海外客

户的高端定制需求，完善从产品规划到物料定制采购、质量标准确定、生产制造及仓储物流的一站式服务。第三，丰富市场结构，逐步开拓海外市场，加强对海外业务的支持力度，提高境外客户的占比。第四，进一步完善产品结构，在巩固现有的消费电子、网络通讯、汽车电子类产品市场的基础上，逐步扩大高端客户群体，并策略性布局医疗电子等高附加值细分市场，提升服务客户和产品的多样性，提升营业收入和盈利水平。第五，深化全球布局，在现有国内制造能力的基础上，继续提升并扩大印度光弘的规模和制造能力，加快落实越南、孟加拉等地制造基地的建设。加速对法国 AC 公司的业务整合，为公司拓展包括欧洲、美洲、非洲等地的业务。

在制造能力方面，公司将以“工业 4.0”与“智能制造”赋能制造升级，以信息化技术应用和自动化设备升级为主线，持续进行公司内部驱动技术创新和技术改造，不断提高工艺研发水平，通过引进自动化生产线和开展精益改善、工场 IT 化管理等一系列措施，顺利实施“智能制造改造项目”和“工程技术中心升级建设项目”，实现全面降本增效，进一步向智能制造目标迈进。

在管理方面，公司将以具有大型电子制造企业资深从业经验的高端人才为重点引进对象，结合管理信息系统的应用，进一步完善内部质量管控体系，全面提升公司的人才管理、生产管理和信息技术管理水平，全面提升产品品质和客户认可度。

（三）实现发展目标的路径和计划

为确保公司业务目标的顺利达成，一方面公司将继续深耕消费电子业务，充分利用三期智能制造基地带来的产能空间。另一方面将大力拓展汽车电子、新能源等新兴领域的业务发展，并策略性布局医疗、工控等高附加值领域，丰富公司业务多样性。

公司对印度光弘的控股收购，标志着光弘科技走向了国际市场，公司已开始复制印度工厂的成功海外模式，不断向海外市场进军。随着设备引进和客户的订单需求不断提升，公司不仅会全面提升印度光弘的制造能力和盈利能力，也正加快推进越南、孟加拉制造基地的兴建，同时，公司已于 2025 年 5 月完成对法国 AC 公司的收购，为客户提供在海外更完善、更强大的服务能力。

公司将大力推行先进设备升级和精密制造技改,深入研究工艺流程的各个环节,发掘精益改善的可能性,更大范围地应用自动化设备和精益生产工艺;同时,公司将进一步强化 MES 系统的自主研发及其与信息管理系统相结合,实现基础数据全方位搜集、共享和分析,实现工场运转和设备维护的深度 IT 化管理,逐渐形成智能化制造体系。

公司将注重学习国内外领先的生产管理经验,持续引进高素质研发人才,加快将信息化和自动化技术融入生产制造各个环节的进程。同时,公司将以进入资本市场为契机,逐步完善研发环境、改善研发的奖励机制、创新与相关外部研发机构的合作等多种方式,鼓励专业技术人员创新研发、精益生产,并提高工程技术中心的专利数量和质量,确保研发项目的高品质和研发人员的稳定性,全面提升公司的研发能力。

公司将在现有业务的基础上,以下游品牌商需求为出发点,借助资本运作、垂直整合等方式进一步拓展公司电子制造服务范围,不断优化供应链管理,更充分地满足客户在原材料采购和仓储物流等环节的需求。

七、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况

（一）重大未决诉讼、仲裁

截至 2025 年 6 月 30 日,发行人不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁。

（二）行政处罚

报告期初至本募集说明书签署日,发行人及其境内控股子公司存在的行政处罚如下:

1、职业病防治相关处罚

2023 年 11 月 2 日,上海市徐汇区卫生健康委员会对快板电子科技(上海)有限公司出具《行政处罚决定书》(徐第 2120234008 号),处罚机关在 2023 年 8 月开展监督检查时发现,快板电子科技(上海)有限公司未按照规定组织两名劳动者进行在岗期间相关职业健康检查,并安排未经相关职业健康检查的一名劳动者从事接触相关职业病危害的作业,违反了《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条第一款、第二款,根据《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条

第（四）项、第七十五条第（七）项的相关规定，对快板电子科技（上海）有限公司未按照规定组织职业健康检查的行为进行警告，并对安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害作业的行为处以罚款人民币 50,000 元。

快板电子科技（上海）有限公司已及时缴纳罚款，并组织相关员工进行了职业健康检查。快板电子整改完成后，申请了信用信息修复。相关主管部门对快板电子行政处罚信息信用修复申请材料进行受理审查，认为符合要求，同意予以修复信用记录。根据快板电子的《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》，卫生健康领域的违法记录信息未显示存在违法违规记录或重大失信情形。

根据《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条，“用人单位违反本法规定，有下列行为之一的，由卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款：……（四）未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案或者未将检查结果书面告知劳动者的；……”；第七十五条，“违反本法规定，有下列情形之一的，由卫生行政部门责令限期治理，并处五万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭：……（七）安排未经职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业的；……”。

根据《上海市卫生健康行政处罚裁量适用办法》第五条（罚款裁量原则），“罚款裁量应当充分全面考虑本市社会经济发展水平，并起到相应的惩戒效果。罚款裁量幅度一般按下列规则进行等级划分：（一）罚款为一定数额倍数的，应当在最高倍数与最低倍数之间划分三个阶次，一般处罚按照中间阶次处罚，从轻处罚应当低于中间阶次，从重处罚不得低于中间阶次；（二）罚款为一定幅度数额的，应当在最高额与最低额之间划分三个阶次，一般处罚按照中间阶次处罚，从轻处罚应当低于中间阶次，从重处罚不得低于中间阶次；（三）只规定最高罚款数额没有规定最低罚款数额的，一般处罚按照最高罚款数额 30%至 70%确定，从轻处罚按照最高罚款数额 30%以下确定，从重处罚按照最高罚款数额 70%以上确定。为便于实际操作，上述处罚数额可按四舍五入法取相近数值的整数或整数倍。”

公司上述受处罚行为由主管行政机关按照《中华人民共和国职业病防治法》

相关规定作出最低额罚款，处罚金额较小，不属于《上海市卫生健康行政处罚裁量适用办法》中从重处罚的情况。

2、安全生产行政处罚

2025 年 4 月 21 日，惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局对光弘电子（惠州）有限公司作出《行政处罚决定书》（（惠湾）应急罚〔2025〕12 号），因光弘电子（惠州）有限公司未将危险化学品储存在专用仓库内违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款的规定，根据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第（四）项、《应急管理行政处罚裁量权基准》序号 151 及《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十条的相关规定，对光弘电子（惠州）有限公司处以罚款人民币 6 万元。

光弘电子（惠州）有限公司已及时缴纳罚款，并出具《安全生产隐患整改报告》，说明已对危险化学品暂存处清空、停止使用，并租赁第三方化学品存放仓库用于危险化学品存放。

2025 年 6 月 6 日，惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局出具《关于光弘电子（惠州）有限公司申请开具合规证明的复函》，确认光弘电子（惠州）有限公司的违法行为已整改，隐患问题已消除，罚款已缴纳至指定银行；根据《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十九条和《安全生产严重失信主体名单管理办法》第七条的规定，光弘电子（惠州）有限公司未将危险化学品储存在专用仓库内的行为不属于重大违法违规行为，不存在导致重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，也不属于从重处罚的情形和不属于列入严重失信主体名单的情形。

《危险化学品安全管理条例》第八十条规定，“生产、储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（四）未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的；……”。《应急管理行政处罚裁量权

基准》第 151 条规定，“未将危险化学品储存在专用仓库内的，责令改正，处 5 万元以上 7 万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件。”

光弘电子（惠州）有限公司上述受处罚行为由主管行政机关按照《危险化学品安全管理条例》《应急管理行政处罚裁量权基准》等相关规定作出罚款，主管行政机关作出的行政处罚决定未认定光弘电子（惠州）有限公司上述违法行为存在情节严重的情形，亦未对光弘电子（惠州）有限公司处以责令停产停业整顿的处罚。此外，光弘电子（惠州）有限公司已及时整改，该项行政处罚对光弘电子（惠州）有限公司的持续生产经营未产生重大不利影响。

综上，光弘电子（惠州）有限公司及快板电子科技（上海）有限公司的前述违法行为不构成重大违法行为，上述两项行政处罚不构成重大行政处罚事项，对发行人及相关境内控股子公司的正常生产经营未造成重大不利影响，不构成本次发行的实质性法律障碍。

八、财务性投资情况

（一）财务性投资

1、财务性投资及类金融业务的认定标准

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》：

（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的

财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

(5) 金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

(6) 本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

2、公司最近一期末财务性投资情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司可能涉及财务性投资的会计科目列示如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日账面金额	款项性质	是否涉及财务性投资	涉及财务性投资的金额	财务性投资占当期归属于母公司净资产的比例
交易性金融资产	6,820.70	理财产品、股权投资基金	是	6,820.70	1.41%
其他应收款	4,601.69	主要为往来款项、代缴社保、公积金	否	-	-
其他流动资产	21,339.76	主要为掉期存款、留抵进项税额和预缴企业所得税	否	-	-
其他非流动资产	8,361.81	主要为预付工程及设备款和保证金	否	-	-
合计	41,123.96	-		6,820.70	1.41%

(1) 交易性金融资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产具体情况如下：

项目	期末账面余额（万元）	是否属于财务性投资
股权投资基金	6,820.70	是

截至 2025 年 6 月 30 日，公司持有的股权投资基金明细情况如下：

公司名称	主营业务	账面价值（万元）	光弘科技持股比例	是否属于财务性投资
北京为准智能科技有限公司	无线测试仪表研发	2,000.00	2.50%	是
深圳明锐理想科技股份有限公司	工业自动化装备	1,962.00	3.52%	
深圳市鑫信腾科技股份有限公司	射频检测、视觉定位、视觉检测、工业	1,350.00	1.05%	

公司名称	主营业务	账面价值 (万元)	光弘科技持 股比例	是否属于财 务性投资
	机器人等			
上海金浦创新私募投资基金	股权投资、投资管理	900.00	1.87%	
上海金浦国调并购股权投资基金	股权投资、投资管理	608.70	0.65%	
合计	-	6,820.70	-	

公司持有的股权投资基金主要为直接投资与公司具有一定产业协同效应的公司股权，公司持有上述股权投资基金主要是以短期交易获利为目的，因此属于财务性投资。

(2) 其他应收款

截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面金额为 4,601.69 万元，主要为往来款项、代缴社保、公积金等，不属于财务性投资。

(3) 其他流动资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他流动资产账面金额为 21,339.76 万元，主要为掉期存款、留抵进项税额和预缴企业所得税等。公司购买的掉期存款产品主要系闲置资金进行短期现金管理，旨在提升闲置资金的效率，相关产品期限较短，不属于财务性投资。

(4) 其他非流动资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产账面金额为 8,361.81 万元，主要为预付工程及设备款、保证金等，不属于财务性投资。

(5) 最近一期末财务性投资规模是否符合监管要求

除上述科目外，发行人不存在设立或参与投资基金、并购基金；不存在拆借资金、委托贷款或以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品，以及非金融企业投资金融业务等情形。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司持有的财务性投资合计 6,820.70 万元，占合并报表归属于母公司净资产的 1.41%，未超过 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

3、本次发行董事会决议日前六个月至今公司不存在财务性投资

2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过向特定对象发行股票的相关议案。本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，发行人不存在新投入和拟投入的财务性投资。

(二) 类金融业务

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，除人民银行、银保监会（现“国家金融监督管理总局”）、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

报告期内，公司不存在类金融业务。

九、最近一期业绩波动的原因及合理性

(一) 最近一期业绩波动的原因及合理性分析

公司最近一期业绩与上年同期对比情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	变动率
营业收入	331,848.72	331,294.30	0.17%
营业成本	293,465.50	290,874.18	0.89%
营业利润	11,584.55	16,326.40	-29.04%
净利润	11,167.20	13,298.05	-16.02%
归属于上市公司股东的净利润	9,934.31	9,888.66	0.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,588.32	8,011.04	7.21%

2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 331,848.72 万元，同比增长 0.17%，实现归属于母公司所有者的净利润 9,934.31 万元，同比增长 0.46%。公司整体经营情况良好，且于 2025 年 5 月完成对 AC 公司的收购，整体经营实力进一步提升。营业利润和净利润有所下降，主要系行业竞争加剧、产品结构调整及业务整合等因素影响，使得毛利额下降和期间费用有所增加。

（二）是否与同行业可比公司一致

2025 年 1-6 月，公司与同行业可比公司业绩变动对比如下：

单位：万元

公司简称	股票代码	项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	变动比例
环旭电子	601231.SH	营业收入	2,721,370.13	2,738,561.04	-0.63%
		归属于母公司所有者的净利润	63,804.85	78,440.38	-18.66%
工业富联	601138.SH	营业收入	36,075,965.30	26,609,123.50	35.58%
		归属于母公司所有者的净利润	1,211,335.70	873,909.80	38.61%
卓翼科技	002369.SZ	营业收入	87,021.50	81,356.68	6.96%
		归属于母公司所有者的净利润	-7,838.63	-8,648.64	9.37%
共进股份	603118.SH	营业收入	415,317.23	399,132.31	4.06%
		归属于母公司所有者的净利润	5,749.31	-1,646.27	449.23%
发行人	300735.SZ	营业收入	331,848.72	331,294.30	0.17%
		归属于母公司所有者的净利润	9,934.31	9,888.66	0.46%

整体而言，发行人同行业可比公司因自身情况有所不同，经营业绩波动情况不一。其中工业富联、共进股份的经营业绩实现较大幅度增长，主要系工业富联的云计算业务收入大幅增加，以及客户特定机种热销带动精密结构件业务收入增长；共进股份受高毛利海外业务占比提升、降本增效措施落地等影响实现扭亏为盈。发行人 2025 年 1-6 月经营情况较为稳定。

（三）相关不利影响是否持续、是否将形成短期内不可逆转的下滑

公司持续打造国内、国外双循环的业务体系，满足品牌客户市场全球化的需求，致力于与客户在全世界范围展开更广泛合作。随着收购 AC 公司等一系列业务布局举措落地，公司有望迎来新一轮业绩增长点。

综上，公司整体经营情况稳中向好，最近一期营业收入与归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比较为稳定。营业利润和净利润有所下降，主要系行业竞争加剧、产品结构调整及业务整合等因素影响，使得毛利额下降和期间费用有所增加。

十、报告期内深交所对公司年度报告的问询情况

2023年6月1日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对惠州光弘科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2023】第300号）；2025年6月27日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对惠州光弘科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2025】第641号）。深交所关于公司2022年、2024年年报的问询函主要对以下事项进行了多次问询：

- 1、关注净利润变动趋势与营业收入变动不一致的原因及合理性；
- 2、关注应收账款坏账准备计提是否合理、充分，是否符合企业会计准则的有关规定；
- 3、关注主要业务毛利率下降的原因及合理性；
- 4、关注经营活动现金净流量的变动以及与净利润存在差异的原因及合理性；

根据深交所的有关要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项落实，并于2023年6月15日完成对《关于对惠州光弘科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2023】第300号）之回复，于2025年7月8日完成《关于对惠州光弘科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2025】第641号）之回复。

第三节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家政策鼓励上市公司充分利用并购重组助力主业发展

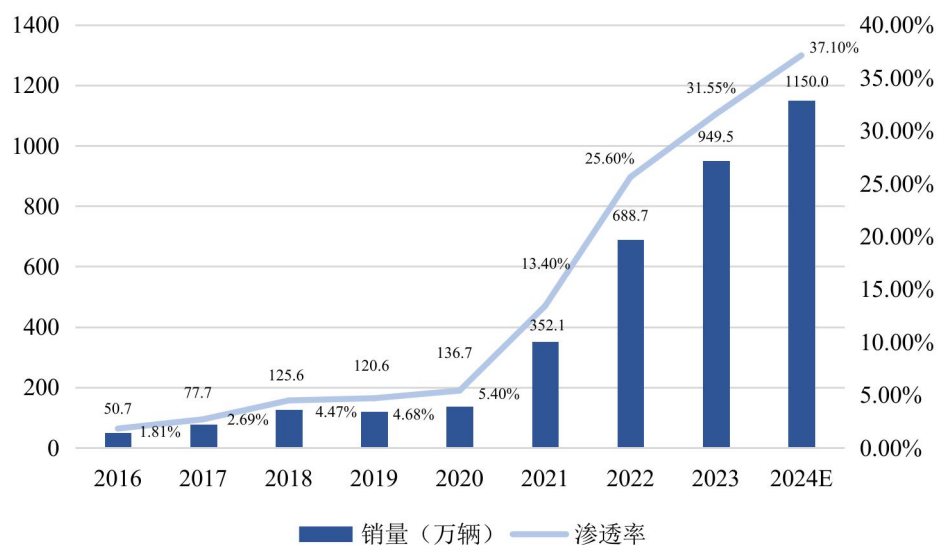
近年来，国家持续不断推动并购重组市场化改革，鼓励上市公司加强产业横向、纵向整合协同，利用产业并购实现资源有效整合。2024年4月，国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2024年6月，国务院发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，鼓励充分发挥沪深交易所主板、科创板、创业板等板块功能，支持符合条件的上市公司并购科技型企业。2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，明确支持跨界并购、允许并购未盈利资产，还将提高监管包容度、提高交易效率。

基于上述，本次通过向特定对象发行股票方式助力上市公司收购优质资产，实现业务资源整合和全球化布局，发挥业务协同效用，提升规模化经营效应，进而提高上市公司持续经营能力和抗风险能力，进一步增厚股东回报。

2、新能源汽车渗透率稳步提升，汽车电子行业迎来新发展机遇

随着人类社会的不断发展，能源和环境问题已成为国家发展必须关注的重要问题，推进节能减排、绿色发展逐渐成为全球共识。新能源汽车是用能端电能替代的重要形式。新能源汽车实现了交通出行领域电能对化石燃料的替换，实现出行领域的零碳排放。在全球“碳达峰、碳中和”的背景下，发展新能源汽车对于控制碳排放具有十分重要的意义，汽车电动化成为各国家在交通领域长期支持的方向。

2016 至 2024 年度我国新能源汽车销量及渗透率



数据来源：中国汽车工业协会

近年来，我国新能源汽车市场蓬勃发展。根据中国汽车工业协会统计数据，2016至2023年度我国新能源汽车年度销量从50.70万辆增长至949.50万辆；2023年度，新能源汽车的渗透率达到31.55%，较2016年已增长近20倍。

随着下游市场的加速发展，汽车电子行业也迎来新的发展机遇，部分新兴企业得以利用行业变革的机遇进入到汽车行业供应链体系当中，不断提升市场份额，从而促进了汽车电子制造服务行业洗牌，并使得汽车电子行业跟随新能源汽车整体产业链蓬勃发展。

本次并购的AC公司长期深耕电子制造服务领域，特别是在汽车电子行业具有深厚的技术储备和广泛的客户积累。通过本次并购，公司将进一步深化自身在汽车电子行业的技术储备，抓住行业变革带来的发展机遇，扩大在汽车电子领域的业务规模 and 市场份额。

3、长期坚持公司发展战略，实现公司业务加速扩展

本次通过向特定对象发行股票方式助力上市公司收购，是公司进一步强化在EMS领域的业务布局，提升规模化经营效应的重要举措。在保持现有优势市场的同时，积极推进设备升级、产能扩充、产业链布局，积极开拓其他业务领域，丰富产品结构，提升盈利规模是公司长期坚持的发展战略。

上市公司和标的公司属于同行业企业，在各自产品的下游应用领域存在一定

互补，并有望在客户结构和销售区域等方面发挥各自优势，实现公司业务扩张。通过本次收购，上市公司将充分发挥双方在产品、市场拓展、生产技术等方面的业务协同效应，通过深耕各自重点服务区域积累的优质客户资源，实现公司在欧美非等国家的市场拓展，提升规模化经营效应，符合公司长期发展战略和全体股东利益。

（二）本次发行的目的

1、基于公司在新兴领域的业务布局，充分实现资源整合

公司成立至今，始终致力于打造全球一流的电子制造平台，以匠心精神，推动制造业向智能化、绿色化、信息化方向发展。经过多年发展，公司在智能手机、平板电脑、网络终端、汽车电子等下游领域已与国内外多家知名客户建立了长期稳定的业务关系。近年来，随着新能源技术的快速发展，汽车制造领域迎来全新发展机遇，行业格局变化为公司扩大在汽车电子领域的市场份额创造了有利条件。AC 公司作为深耕欧洲的 EMS 服务提供商，在汽车制造领域积累了丰富的生产经验和优质的客户资源。本次收购完成后，公司将持续推进与标的方在汽车制造领域的生产技术、服务经营和客户资源整合，实现公司在汽车电子领域的加速布局。

2、拓展海外市场，深入推进公司全球化产业布局

近年来，公司不断推进全球化产业布局。此前，公司已完成对印度光弘的控股收购，标志着公司走向国际市场的发展战略进一步落地，开始了全球化布局之路。随着印度工厂的成功运作，公司亦参照该模式，在越南和孟加拉兴建全新制造基地，为客户海外订单需求提供本地化的制造服务。

此次收购完成后，公司将在欧洲、美洲、非洲形成产业布局，进一步拓展海外市场，并推动公司全球化产业布局逐步完善，助力公司充分利用各地经济政策和地缘优势，满足品牌客户全球化的市场需求。

3、加快市场资源整合，提升上市公司持续经营能力和抗风险能力

AC 公司深耕欧美 EMS 服务领域，具有稳定的经营能力，在欧美多个国家具备稳健的客户基础。本次募投项目收购完成后，上市公司将取得标的公司控制权，进一步提升公司经营规模，强化规模化经营效应。收购完成后，上市公司将

在未来的持续整合中，全面梳理标的公司的销售、采购、研发等各方面管理体系，在保证标的公司经营稳定性的前提下，加快和标的公司的整合，充分发挥本次募投项目收购在业务布局、市场拓展和生产技术等方面的协同效应，有效实现资源共享和优势互补，提高上市公司综合竞争力。本次募投项目收购系上市公司现有业务的扩张和补充，将巩固并提升上市公司持续经营能力和抗风险能力。

4、优化公司财务结构，提高抗风险能力

近年来，公司业务发展较快，在战略发展进程中资产规模不断扩大，为保证公司的资金需求，公司通过银行借款的形式进行债务融资，增加了公司的债务规模及财务杠杆。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并口径资产负债率为 43.70%，合并报表流动负债占总负债的比例为 83.58%，流动负债比例较高。因此，通过使用本次募集资金补充流动资金，将降低公司债务比例，进一步优化公司的财务结构，同时提高公司短期偿债能力。

公司报告期内营业收入分别为 417,978.02 万元、540,244.90 万元、688,141.22 万元和 331,848.72 万元，总体保持增长的态势。公司业务高速发展，对于流动资金的需求规模也相应增加。本次补充流动资金能够部分满足公司未来业务持续发展产生营运资金缺口的需求。

在公司未来发展过程中，时刻面临市场竞争、技术变革等各项风险因素。当前述风险给公司生产经营带来的不利影响时，保持一定水平的流动资金可以提高公司抗风险能力。而在市场环境较为有利时，有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。

二、发行对象及其与公司的关系

本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同

意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

截至本募集说明书签署日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在发行竞价结束后的相关公告中予以披露。

三、本次发行方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册的文件的有效期内择机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

（四）发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

1、派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

2、送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

3、两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。

本次发行的最终发行价格由董事会根据股东会授权，在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。

（五）发行数量

本次发行的股票数量不超过 230,238,206 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，由股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

（六）本次发行的限售期

本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让。

本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

（七）募集资金总额

本次发行股票募集资金总额不超过 103,294.48 万元（含本数）。

（八）募集资金投向

本次发行股票募集资金总额不超过 103,294.48 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权	73,294.48	73,294.48
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		103,294.48	103,294.48

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（九）滚存未分配利润安排

本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

（十）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

（十一）本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。

四、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，因而无法确认发行对象与公司之间的关系。本次发行过程中，公司将针对构成关联交易的认购对象，严格按照有关法律法规要求及公司内部规定履行关联交易审

批程序，并在《发行情况报告书》中予以披露。

五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书签署日，光弘投资直接持有公司股份 395,691,660 股，占公司总股本的 51.56%，为公司的控股股东。

唐建兴直接持有公司股份 282,000 股，占公司总股本的 0.04%，并通过宏天创富有限公司、进科投资有限公司、光弘投资有限公司间接控制公司 395,691,660 股股份，占公司总股本的 51.56%；从而，唐建兴先生合计控制公司 395,973,660 股股份，占公司总股本的 51.60%，为公司实际控制人。

假设本次发行股份的规模为 230,238,206 股，本次发行完成后，公司的总股本为 997,698,895 股，光弘投资持有公司 39.66% 的股份，仍为公司控股股东，唐建兴先生合计控制公司 39.69% 的表决权，仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

六、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）已履行的批准程序

2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。

2025 年 7 月 31 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事项。

（二）尚需履行的批准程序

根据有关法律、法规的规定，本次发行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

在获得中国证监会作出同意注册决定后，公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。

七、发行人符合国家产业政策情况

公司的主营业务为专业从事消费电子类、汽车电子类、网络通讯类、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整的电子制造服务（EMS），根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

本次募集资金用于收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权和补充流动资金。标的公司主要从事电子制造服务业务，为客户提供电子控制模块、电子产品制造及零配件组装服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，与光弘科技属于同一行业。本次募集资金的使用符合国家产业政策要求。

公司成立至今，始终致力于打造全球一流的电子制造平台，以匠心精神，推动制造业向智能化、绿色化、信息化方向发展。公司凭借质量高、交期准的优势，获得了国内外知名企业的认可。近年来，国家、地方政府对消费电子、汽车电子、网络通讯领域不断加大支持力度，相继出台《制造业企业数字化转型实施指南》《工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案》《关于促进电子产品消费的若干措施》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”信息通信行业发展规划》等一系列产业政策，支持电子制造服务行业健康发展，对相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障，同时为发行人经营发展提供了有力的法律保障及政策支持，对公司的经营发展带来积极影响。

发行人主营业务和本次募集资金投向不涉及产能过剩行业、不属于国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单》中的禁止准入类项目，不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制类产业。发行人本次向特定对象发行股票募集资金投资项目与公司主营业务方向一致，标的公司与上市公司属于同一行业。本次募集资金投资项目是基于现有业务的升级完善，以及全球化战略的进一步深化落实，符合产业政策和国家经济发展战略。

综上，本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次发行募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 103,294.48 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权	73,294.48	73,294.48
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		103,294.48	103,294.48

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权

1、本次交易概况

本次交易系公司通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购 AC 公司及 TIS 工厂控制权的交易。2025 年 5 月，AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权已完成交割，转让至公司之子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 名下，AC 公司及 TIS 工厂已成为公司子公司。

本次交易为现金收购，本次交易的对价计划全部以本次向特定对象发行股票募集的资金支付。但本次交易的实施不以本次向特定对象发行股票获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册为前提，本次发行募集资金到位之前，公司已根据收购实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次募集资金收购资产的具体情况，见“第五节 本次募集资金收购资产的有关情况”。

2、交易价格及定价依据

本次交易中，标的资产在北京产权交易所公开挂牌转让。根据北京产权交易所挂牌转让信息，AC 公司 100%股权转让底价为 73,294.48 万元人民币，AC 公司之子公司 TIS 工厂 0.003%股权转让底价为 0.0001 万元人民币。上述挂牌底价系由交易对手根据其聘请的评估机构出具的评估报告结果确定。

公司综合考虑标的公司的财务状况、品牌影响力、客户资源等因素的基础上，以支付现金的方式参与竞拍，最终交易定价根据北京产权交易所公开挂牌结果确定，本次交易定价具有公允性。

3、本次交易的背景和目的

（1）本次交易的背景

①国家政策鼓励上市公司充分利用并购重组助力主业发展

近年来，国家持续不断推动并购重组市场化改革，鼓励上市公司加强产业横向、纵向整合协同，利用产业并购实现资源有效整合。2024 年 4 月，国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2024 年 6 月，国务院发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，鼓励充分发挥沪深交易所主板、科创板、创业板等板块功能，支持符合条件的上市公司并购科技型企业。2024 年 9 月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，明确支持跨界并购、允许并购未盈利资产，还将提高监管包容度、提高交易效率。

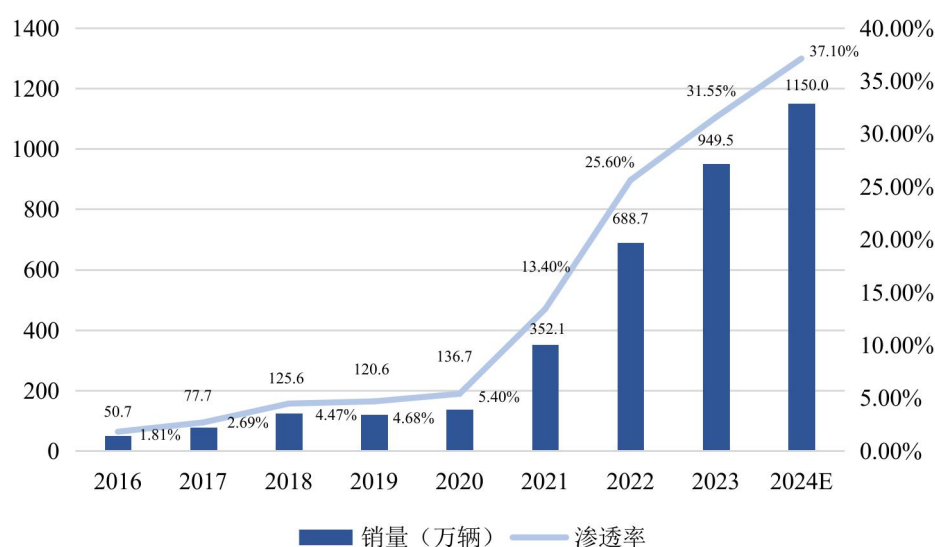
基于上述，本次交易通过收购优质资产，实现业务资源整合和全球化布局，发挥业务协同效用，提升规模化经营效应，进而提高上市公司持续经营能力和抗风险能力，进一步增厚股东回报。

②新能源汽车渗透率稳步提升，汽车电子行业迎来新发展机遇

随着人类社会的不断发展，能源和环境问题已成为国家发展必须关注的重要

问题，推进节能减排、绿色发展逐渐成为全球共识。新能源汽车是用能端电能替代的重要形式。新能源汽车实现了交通出行领域电能对化石燃料的替换，实现出行领域的零碳排放。在全球“碳达峰、碳中和”的背景下，发展新能源汽车对于控制碳排放具有十分重要的意义，汽车电动化成为各国家在交通领域长期支持的方向。

2016 至 2024 年度我国新能源汽车销量及渗透率



数据来源：中国汽车工业协会

近年来，我国新能源汽车市场蓬勃发展。根据中国汽车工业协会统计数据，2016 至 2023 年度我国新能源汽车年度销量从 50.70 万辆增长至 949.50 万辆；2023 年度，新能源汽车的渗透率达到 31.55%，较 2016 年已增长近 20 倍。

随着下游市场的加速发展，汽车电子行业也迎来新的发展机遇，部分新兴企业得以利用行业变革的机遇进入到汽车行业供应链体系当中，不断提升市场份额，从而促进了汽车电子制造服务行业洗牌，并使得汽车电子行业跟随新能源汽车整体产业链蓬勃发展。

本次并购的 AC 公司长期深耕电子制造服务领域，特别是在汽车电子行业具有深厚的技术储备和广泛的客户积累。通过本次并购，公司将进一步深化自身在汽车电子行业的技术储备，抓住行业变革带来的发展机遇，扩大在汽车电子领域的业务规模 and 市场份额。

③长期坚持公司发展战略，实现公司业务加速扩展

本次交易是公司进一步强化在 EMS 领域的业务布局，提升规模化经营效应的重要举措。在保持现有优势市场的同时，积极推进设备升级、产能扩充、产业链布局，积极开拓其他业务领域，丰富产品结构，提升盈利规模是公司长期坚持的发展战略。

上市公司和标的公司属于同行业企业，在各自产品的下游应用领域存在一定互补，并有望在客户结构和销售区域等方面发挥各自优势，实现公司业务扩张。通过本次收购，上市公司将充分发挥双方在产品、市场拓展、生产技术等方面的业务协同效应，通过深耕各自重点服务区域积累的优质客户资源，实现公司在欧美非等国家的市场拓展，提升规模化经营效应，符合公司长期发展战略和全体股东利益。

（2）本次交易的目的

①基于公司在新兴领域的业务布局，充分实现资源整合

公司成立至今，始终致力于打造全球一流的电子制造平台，以匠心精神，推动制造业向智能化、绿色化、信息化方向发展。经过多年发展，公司在智能手机、平板电脑、网络终端、汽车电子等下游领域已与国内外多家知名客户建立了长期稳定的业务关系。近年来，随着新能源技术的快速发展，汽车制造领域迎来全新发展机遇，行业格局变化为公司扩大在汽车电子领域的市场份额创造了有利条件。AC 公司作为深耕欧洲的 EMS 服务提供商，在汽车制造领域积累了丰富的生产经验和优质的客户资源。本次收购完成后，公司将持续推进与标的方在汽车制造领域的生产技术、服务经营和客户资源整合，实现公司在汽车电子领域的加速布局。

②拓展海外市场，深入推进公司全球化产业布局

近年来，公司不断推进全球化产业布局。此前，公司已完成对印度光弘的控股收购，标志着公司走向国际市场的发展战略进一步落地，开始了全球化布局之路。随着印度工厂的成功运作，公司亦参照该模式，在越南和孟加拉兴建全新制造基地，为客户海外订单需求提供本地化的制造服务。

此次收购完成后，公司将在欧洲、美洲、非洲形成产业布局，进一步拓展海外市场，并推动公司全球化产业布局逐步完善，助力公司充分利用各地经济政策

和地缘优势，满足品牌客户全球化的市场需求。

③加快市场资源整合，提升上市公司持续经营能力和抗风险能力

AC 公司深耕欧美 EMS 服务领域，具有稳定的经营能力，在欧美多个国家具备稳健的客户基础。本次收购完成后，上市公司将取得标的公司控制权，进一步提升公司经营规模，强化规模化经营效应。收购完成后，上市公司将在未来的持续整合中，全面梳理标的公司的销售、采购、研发等各方面管理体系，在保证标的公司经营稳定性的前提下，加快和标的公司的整合，充分发挥本次收购在业务布局、市场拓展和生产技术等方面的协同效应，有效实现资源共享和优势互补，提高上市公司综合竞争力。本次收购系上市公司现有业务的扩张和补充，将巩固并提升上市公司持续经营能力和抗风险能力。

4、本次交易的决策和批准情况

(1) 上市公司的决策程序

2024 年 11 月 25 日，光弘科技召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于参与竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》，同意公司通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购 All AC 公司 100%股权及 TIS 工厂 0.003%股权。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》。收购完成后，公司将控制 AC 公司及其控股的 TIS 工厂的 100%股权，AC 公司及 TIS 工厂将成为公司子公司。

(2) 交易对手方的决策程序

2024 年 9 月 9 日，航天科技召开第七届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了《关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的议案》。

2024 年 10 月 28 日，航天科技召开第七届董事会第二十三（临时）会议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的议案》。

2024 年 11 月 14 日，航天科技召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的议案》。

2024 年 11 月 14 日，IEE 公司、Hiwinglux 公司分别召开股东会，审议通过本次股权转让事项。

(3) 有关部门的审批、备案程序

公司已取得广东省发展改革委出具的《境外投资项目备案通知书》、广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，并在外汇管理部门授权的银行完成境外投资外汇登记。本次交易已正式获得法国的外国直接投资许可，亦正式获得了摩洛哥及波兰的反垄断许可。

(二) 补充流动资金

1、项目基本情况

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金 30,000.00 万元。

2、项目的必要性

(1) 优化公司的财务结构，提高短期偿债能力

近年来，公司业务发展较快，公司在战略发展进程中资产规模不断扩大，为保证公司的资金需求，公司通过银行借款的形式进行债务融资，增加了公司的债务规模及财务杠杆。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并口径资产负债率为 43.70%，合并报表流动负债占总负债的比例为 83.58%，流动负债比例较高。因此，通过使用本次募集资金补充流动资金，将降低公司债务比例，进一步优化公司的财务结构，同时提高公司短期偿债能力。

(2) 满足业务资金需求，提高抗风险能力

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月营业收入分别为 417,978.02 万元、540,244.90 万元、688,141.22 万元和 331,848.72 万元，总体保持增长的态势。公司业务高速发展，对于流动资金的需求规模也相应增加。本次补充流动资金能够部分满足公司未来业务持续发展产生营运资金缺口的需求。

在公司未来发展过程中，时刻面临市场竞争、技术变革等各项风险因素。当前述风险给公司生产经营带来的不利影响时，保持一定水平的流动资金可以提高公司抗风险能力。而在市场环境较为有利时，有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。

(3) 帮助标的缓解偿债压力及后续资产整合需要一定资金

本次交易前，AC 公司尚欠 IEE 公司借款本金 1,500 万欧元及根据相关借款协议规定所产生尚未支付的利息，GDL 公司尚欠 IEE 公司借款本金 417.7 万美元及根据相关借款协议规定所产生的尚未支付的利息。根据本次交易的方案，AC 公司及 GDL 公司应不晚于本次交易交割日向 IEE 公司偿还上述借款。为保障交易的正常推进，缓解标的公司短期偿债压力，公司之子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.向 AC 公司及 GDL 公司提供了相应借款以代为偿还所欠款项。此外，为推进标的公司后续发展，充分发挥上市公司与标的公司的协同作用，充分整合上市公司与标的公司资源，预计也将需要上市公司长期、大量的资金投入。因此，为保障标的公司未来持续健康发展，促进上市公司与标的公司逐步实现现有资源整合，公司的经营发展仍需要稳定、充足的流动资金。

综上所述，补充公司生产经营中所需的营运资金，将满足公司业务高速发展产生的营运资金缺口，优化公司的资产负债率，提升公司短期偿债能力，有利于公司业务发展。此外，为帮助标的公司在收购完成后缓解偿债压力及促进双方资源整合需要一定数量资金。因此，本次发行补充上市公司流动资金具有必要性。

3、项目的可行性

本次补充流动资金能够有效增加公司营运资金储备，优化公司债务结构，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，有利于公司的健康可持续发展。该项目符合公司实际发展情况，符合国家相关政策及法律法规。

4、融资规模的合理性

公司本次补充流动资金的需求测算在历史平均经营情况的基础上，根据销售百分比法测算未来营业收入增长所导致的相关经营性流动资产和经营性流动负债的变化，进而测算公司未来期间生产经营对流动资金的需求量。

2022 年至 2024 年公司营业收入及增长情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	复合增长率
营业收入	417,978.02	540,244.90	688,141.22	-
营收增长率	15.99%	29.25%	27.38%	28.31%

假设公司 2025 年至 2027 年营业收入增长率为 28.31%，在公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况长期稳定，未来不发生较大变化的假设前提下，未来三年各项经营性流动资产、经营性流动负债占营业收入的比例与 2024 年一致，则公司 2025 年-2027 年流动资金缺口的测算过程如下：

单位：万元

项目		2024 年		2025 年（E）	2026 年（E）	2027 年（E）
		金额	占比	金额	金额	金额
营业收入		688,141.22	100.00%	882,957.16	1,132,926.40	1,453,663.08
经营性流动资产	应收票据	4,953.63	0.72%	6,356.02	8,155.44	10,464.29
	应收账款	136,568.76	19.85%	175,232.00	224,840.99	288,494.50
	应收款项融资	66.20	0.01%	84.94	108.98	139.84
	预付款项	1,666.90	0.24%	2,138.81	2,744.32	3,521.25
	存货	30,769.22	4.47%	39,480.13	50,657.14	64,998.41
	其他流动资产	60,613.29	8.81%	77,773.19	99,791.14	128,042.47
	合计	234,638.00	34.10%	301,065.10	386,298.01	495,660.75
经营性流动负债	应付账款	118,601.13	17.23%	152,177.65	195,259.85	250,538.81
	合同负债	38,162.30	5.55%	48,966.22	62,828.78	80,615.90
	其他流动负债	1,017.98	0.15%	1,306.17	1,675.95	2,150.42
	合计	157,781.40	22.93%	202,450.04	259,764.58	333,305.13
流动资金占用额		76,856.60	11.17%	98,615.05	126,533.43	162,355.62
至 2027 年末累计流动资金缺口						85,499.03

注：上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，也不构成业绩承诺，仅用于计算本次补充流动资金的假设。

不考虑募投项目实施的影响，根据上表测算过程，公司因业务规模增长和营业收入增加将带来持续性的增量流动资金需求，预计至 2027 年末流动资金占用规模将达到 85,499.03 万元。公司拟用本次发行募集资金 30,000.00 万元补充流动资金，补充流动资金金额未超过公司实际营运资金的需求，整体融资规模具有合理性。

三、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响

募集资金到位后，公司的资产规模预计将有较大增加，公司净资产总额将有所增加，净资产的增加将增强本公司后续竞争能力和抗风险能力。

本次募集资金投资项目对于进一步巩固并提升公司竞争力有较大的作用，随着本次募集资金投资项目的实施，公司经营规模将进一步扩大，全球化布局进一步拓展至欧洲、美洲和非洲地区，综合实力将进一步提升。预计随着募集资金投资项目顺利实施，上市公司与标的公司逐步实现业务协同效应，公司长期盈利能力及对投资者的回报能力也将进一步提升。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

公司自上市以来，致力于为客户提供高质量的电子制造服务，掌握了多个领域的核心工艺技术，在客户资源的深度与广度上形成了自身独有的优势。本次向特定对象发行股票募集资金用于标的收购及补充流动资金，是公司拓展全球产业布局的重要举措。经过审慎讨论分析，公司董事会认为本次募集资金投资项目符合国家的相关产业政策和法律法规以及公司战略发展的需要，具有良好的市场前景和经济效益。通过本次向特定对象发行股票，公司的资金实力得到进一步提升，公司的战略将得到进一步实施，有助于进一步巩固提升公司在行业中的优势地位，同时也将提高公司未来的经营业绩，为公司长期、稳定的可持续发展夯实基础。

综上所述，本次募集资金投资项目具有可行性、必要性，符合公司和全体股东的利益。

五、本次募投项目是否涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业

（一）本次募投项目不涉及产能过剩行业

根据《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2018]554 号）《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2019]785 号）《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行

[2020]901 号)《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7 号)《工业和信息化部关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》(工信部联产业[2011]46 号)以及《2015 年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》(工业和信息化部、国家能源局公告 2016 年第 50 号)等规范性文件,全国淘汰落后和过剩产能行业为:炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥(熟料及磨机)、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池(极板及组装)、电力、煤炭。

公司本次募集资金主要用于收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权及补充流动资金。本次收购的标的公司主要从事电子制造服务业务,为客户提供电子控制模块、电子产品制造及零配件组装服务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),标的公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,与光弘科技属于同一行业,不属于国家淘汰落后和过剩产能的行业。本次募投项目中的补充流动资金亦不涉及上述国家淘汰落后和过剩产能的行业。

(二) 本次募投项目不涉及限制类、淘汰类项目

公司本次募集资金主要用于收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权及补充流动资金。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》,本次募投项目不属于限制类及淘汰类行业。

六、募集资金投向与现有业务、前次募投项目的区别和联系

(一) 与公司现有业务的区别和联系

公司主要从事电子制造服务,下游应用领域主要包括消费电子、网络通讯、汽车电子和新能源等领域,提供服务的主要产品包括消费电子类(智能手机、平板电脑)、汽车电子类、网络通讯类、物联网、新能源等电子产品,其中消费电子是公司最主要的下游服务领域。

随着新能源汽车行业的蓬勃发展,汽车电子 EMS 行业也迎来了新的发展机遇。公司近年来在专注消费电子领域的同时,持续加大在汽车电子类业务的人力、物力投入,希望抓住行业机遇,拓展在汽车电子方面的相关业务机会。同时,随着客户群体的不断丰富,公司近年持续推进全球化产业布局,力求为全球客户提供更及时、更完善的产品与服务。

AC 公司系总部位于法国的 EMS 企业，主要客户遍及欧洲、美洲、非洲等地。AC 公司长期深耕汽车电子领域，在汽车电子领域的 EMS 服务行业具有深厚的技术储备和经验积累，并与众多知名客户建立了长期、稳定的合作关系，在欧洲乃至全球的汽车行业 EMS 服务领域具有一定的行业地位和知名度。

上市公司通过本次收购将推进公司在汽车电子领域的业务布局，强化在汽车电子领域的业务覆盖，提升自身在汽车电子领域的综合实力。同时，本次收购也是推进全球化产业布局的重要一步，有助于完善公司产业布局，扩大公司在欧洲、非洲、美洲等地的业务规模，提升公司服务全球客户的能力。

综上，本次募集资金投资项目与公司现有业务紧密相关，将丰富并优化公司业务结构，对公司经营业务产生积极影响，有利于增强公司的持续经营能力和综合竞争力。

（二）与前次募投项目的区别和联系

2019 年度，发行人非公开发行股票募集资金主要用于“光弘科技三期智能生产建设项目”“云计算及工业互联网平台建设项目”和“补充流动资金项目”，募集资金不用于收购资产，而且直接投资于建设项目，前次募投项目主要是为了解决产能瓶颈、满足业务快速发展，以及顺应行业发展趋势和科技进步的必然要求。

公司本次募集资金用于“收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权”和“补充流动资金”，本次收购是基于公司在新兴领域的业务布局，充分实现资源整合，拓展海外市场，深入推进公司全球化产业布局。

两次募投项目在投资形式、项目建设内容、涉及业务、建设目的等方面均存在显著差异，但均围绕公司现有主营业务展开。公司始终致力于打造全球一流的电子制造平台，以匠心精神，推动制造业向智能化、绿色化、信息化方向发展，两次募投项目的实施都将提升上市公司持续经营能力和抗风险能力。

七、本次募集资金用于研发投入的情况

本次发行募集资金总额不超过 103,294.48 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权及补充流动资金，不存在用于研发投入的情况。

八、本次募集资金用于非资本性支出情况

本次募集资金用于资本性支出和非资本性支出的情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	资本性支出		非资本性支出	
		金额	占比	金额	占比
1	收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权	73,294.48		-	-
2	补充流动资金	-	-	30,000.00	
合计		73,294.48	70.96%	30,000.00	29.04%

如上表所示，本次向特定对象发行股票募集资金用于非资本性支出的比例为 29.04%，不超过 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

九、募投项目实施后新增同业竞争或关联交易的情况

本次发行募集资金总额不超过 103,294.48 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权及补充流动资金。募投项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争，也不会新增显失公允的关联交易。

第五节 本次募集资金收购资产的有关情况

一、标的公司基本情况

（一）AC 公司基本情况

AC 公司注册地址及总部位于法国，其基本情况如下：

名称	All Circuits S.A.S.
注册号	811 931 153 R.C.S. Orléans
类型	简单股份有限公司（Société par actions simplifiée，注册于法国）
住所	6 - 3ème avenue, Parc Synergie Val de Loire 45130 Meung-sur-Loire, France
注册资本	69,000,000 欧元（已发行股份 69,000,000 股，每股面值 1 欧元）
注册日期	2015 年 6 月 10 日
营业期限	2015 年 6 月 10 日至 2114 年 6 月 9 日

（二）TIS 工厂基本情况

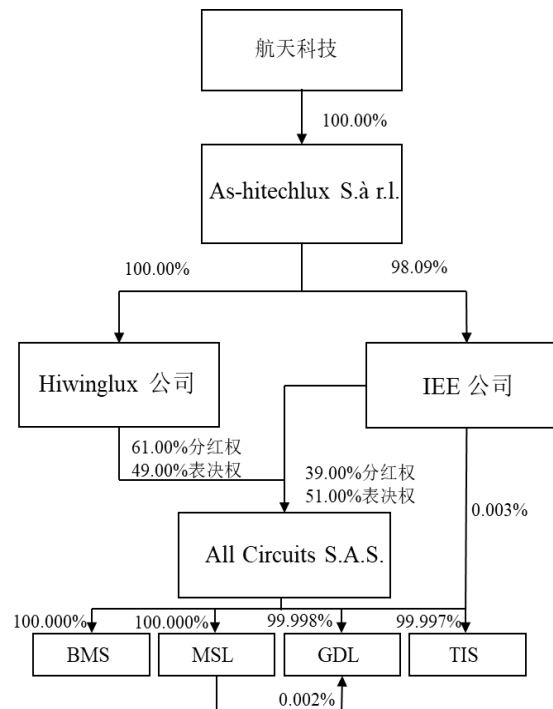
TIS 注册地址及总部位于突尼斯，其基本情况如下：

名称	TIS Circuits SARL
注册号	1159971B
类型	有限责任公司（Société à Responsabilité Limitée，注册于突尼斯）
住所	Industrial zone Borj Ghorbal Yasminet, 2096 Almadina Aljadida, Ben Arous Governorate
注册资本	3,010,000 欧元/5,827,360 突尼斯第纳尔（已发行股份 30,100 股，每股面值 100 欧元/193,600 突尼斯第纳尔）
成立日期	2010 年 7 月 13 日
营业期限	自成立之日起 99 年

二、标的公司的股权及控制关系

（一）标的公司的股权结构及控制关系

本次交易前，AC 公司及 TIS 工厂的股权结构如下：



（二）股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容

本次交易完成前，AC 公司的出资协议及《公司章程》中不存在可能对本次交易产生影响的内容。

（三）本次收购完成后标的公司原董事、高级管理人员安排

AC 公司设立董事会，由 5 名董事构成，设董事会主席 1 名。本次交易完成前，航天科技向 AC 公司派驻 4 名董事，剩余 1 名为 AC 公司总裁。本次交易完成后，原航天科技派驻的 4 名董事已全部辞任，由光弘科技向 AC 公司派驻 4 名董事，参与 AC 公司的日常经营决策。

除上述情况外，AC 公司其余原董事、高级管理人员在标的公司内继续担任原职务。

三、本次收购的背景及目的

本次收购的背景和目的，见“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（一）收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权”。

四、标的公司重要经营性资产、主要负债、对外担保以及重要专利或关键技术情况

（一）主要资产及权属情况

最近一年及一期末，AC 公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,666.01	21,984.11
衍生金融资产	-	566.92
应收账款	49,250.16	47,529.93
预付款项	825.94	355.35
其他应收款	389.98	466.59
存货	45,386.76	43,928.36
其他流动资产	7,667.06	3,323.31
流动资产合计	130,185.91	118,154.56
非流动资产		
长期应收款	701.66	677.31
固定资产	65,180.80	64,654.15
在建工程	2,858.98	2,387.19
使用权资产	6,173.22	6,480.73
无形资产	3,893.99	3,901.71
商誉	10,489.19	10,125.25
递延所得税资产	1,547.97	1,554.89
其他非流动资产	1,551.82	2,117.47
非流动资产合计	92,397.61	91,898.70
资产合计	222,583.52	210,053.26

截至 2025 年 3 月 31 日，AC 公司的资产总额为 222,583.52 万元。流动资产占资产总额的比例为 58.49%，主要由货币资金、应收账款、存货构成；非流动资产占资产总额的比例为 41.51%，主要系固定资产。固定资产主要是机器设备和房屋建筑物，具体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	20,252.17	6,689.32	13,562.84	66.97%
机器设备	86,860.63	56,591.63	30,269.00	34.85%
其他	45,773.09	24,424.13	21,348.96	46.64%
合计	152,885.89	87,705.09	65,180.80	42.63%

截至 2025 年 3 月 31 日，标的公司主要资产的产权清晰，不存在法院或者其他有权机关冻结、查封、拍卖的情形，不存在对其持续生产经营或本次交易的实施具有影响的重大诉讼、仲裁事项。截至 2025 年 3 月 31 日，标的公司所有权或使用权受限的资产情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
应收账款	26,873.24	26,873.24	质押	应收账款保理
固定资产	13,780.06	13,780.06	抵押	售后回租

除上述情况外，标的公司不存在其他资产抵押、质押及其他限制权属转移的情况。

（二）主要负债

截至 2025 年 3 月 31 日，AC 公司负债具体构成如下所示：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	6,984.66	6,595.26
衍生金融负债	371.97	-
应付账款	46,276.30	38,616.68
合同负债	2,883.75	4,091.03
应付职工薪酬	10,762.33	8,470.42
应交税费	2,069.91	1,062.56
其他应付款	15,443.09	15,412.70
一年内到期的非流动负债	15,038.93	14,844.68
其他流动负债	576.75	818.21
流动负债合计	100,407.69	89,911.54
非流动负债：		

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
长期借款	14,148.83	15,712.25
租赁负债	5,102.85	5,434.11
长期应付款	14,763.26	15,128.65
长期应付职工薪酬	5,239.86	4,964.94
预计负债	994.26	945.55
递延收益	1,414.36	1,398.12
递延所得税负债	2,177.37	2,360.17
其他非流动负债	11,603.38	9,589.69
非流动负债合计	55,444.17	55,533.48
负债合计	155,851.85	145,445.01

截至 2025 年 3 月 31 日，标的公司的负债总额为 155,851.85 万元，主要由应付账款、长期借款、长期应付款等构成。

（三）对外担保以及重要专利或关键技术的纠纷情况

截至 2025 年 3 月 31 日，标的公司不存在对外担保情况，亦不存在重要专利或关键技术的纠纷情况。

五、标的公司业务发展情况和主要财务情况

（一）标的公司业务发展情况

AC 公司主要从事电子制造服务业务，其业务主要聚焦于汽车电子领域，并在电气、家电和医疗器械等制造业领域具有一定业务规模，主要为客户提供电子控制模块、电子产品制造及零配件组装服务。公司业务区域主要分布在欧洲、美洲、非洲等地。经过多年的业务发展，AC 公司在电子制造服务领域具备较为深厚的技术储备和广泛的客户群体，并与法雷奥、雷诺、施耐德电气等多个领域的客户建立了较为稳定的合作关系，向其提供 EMS 服务。

AC 公司拥有 MSL Circuits S.A.S.、BMS Circuits S.A.S.、GDL Circuits S.A. de C.V 和 TIS 工厂四家子公司。其中，MSL Circuits S.A.S.和 BMS Circuits S.A.S. 位于法国，主要为部分欧洲区域客户提供服务。GDL Circuits S.A. de C.V 位于墨西哥，专注于为美洲客户提供服务。TIS 工厂主要负责公司在突尼斯的生产基地运营工作，并作为重要生产基地为公司欧洲、美洲、非洲等地客户提供相关服务。

(二) 标的公司主要财务数据

AC 公司最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日/ 2025 年 1-3 月	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度
资产总额	222,583.52	210,053.26
净资产	66,731.67	64,608.25
营业收入	79,526.81	317,872.82
利润总额	-384.32	-3,083.19
净利润	-509.28	-5,434.84
经营活动产生的现金流量净额	10,201.24	26,937.56

标的公司 2024 年度经营业绩由盈转亏，净利润较 2023 年度大幅下滑。标的公司业绩下滑的原因主要系当期标的公司产生较大的汇兑损失。2024 年标的公司财务费用较上年增加 6,488.17 万元人民币，发生了 6,457.98 万元人民币的汇兑损失。标的公司的子公司 GDL 向 AC 公司及原股东 IEE 借入美元和欧元借款，GDL 位于墨西哥，以墨西哥比索为记账本位币，由于墨西哥比索于 2024 年 4 月开始大幅贬值，导致相关借款发生汇兑损失。2025 年一季度以来，公司经营情况逐渐向好，亏损程度已明显收窄。

六、收购完成后对标的公司的影响

本次收购完成后，光弘科技向标的公司派驻 4 名董事，同时还派驻业务、技术、财务人员各 1 名，以促进业务整合协同工作的迅速开展，因此现有管理团队发生一定变化。目前双方仍处在业务整合阶段。光弘科技将加快和标的公司的整合，充分发挥本次收购在业务布局、市场拓展和生产技术等方面的协同效应，有效实现资源共享和优势互补，提高上市公司综合竞争力。上市公司优质的管理模式、供应链渠道、客户资源也可以对标的公司的业务拓展形成促进作用。本次收购完成后，标的公司的主要客户及供应商、公司发展战略等均未发生重大变化。

因此，本次收购不会导致标的公司现有经营管理团队、核心技术人员、主要客户及供应商、公司发展战略等方面产生重大变化。

七、本次交易相关协议的主要内容

（一）AC 公司 100%股权的《产权交易合同》主要内容

（1）合同主体和签订时间

公司之子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 与交易对方 IEE International Electronics & Engineering S.A.、Hiwinglux S.A. 及标的公司 All Circuits S.A.S. 签署了 AC 公司 100% 股权的《产权交易合同》。

转让方一（以下简称甲方一）：Hiwinglux S.A.

转让方二（以下简称甲方二）：IEE International Electronics & Engineering S.A.

受让方（以下简称乙方）：All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.

标的公司（以下简称丙方）：All Circuits S.A.S.

（甲方一、甲方二合称“甲方”，甲方、乙方合称为“甲乙双方”，甲方、乙方、丙方合称“各方”或“合同各方”）

（2）产权转让标的

①本合同转让标的为甲方所持有的标的公司合计 100 % 股权，其中具体为：甲方一持有的标的公司 61% 股权、甲方二持有的标的公司 39% 股权。

②甲方就其持有的标的公司股权（股份）所认缴的出资已经全额缴清。

③转让标的上不存在任何形式的担保，包括但不限于在该转让标的上设置质押或任何影响产权转让的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。

④为避免歧义，在交割日前，标的公司应持续合法有效地直接持有其子公司股份（即 BMS 的 100% 股份，MSL 的 100% 股份，TIS 的约 99.997% 股份以及 GDL 的约 99.998% 股份），以及通过 MSL 间接持有 GDL 约 0.002% 的股份。

（3）标的公司

①本合同所涉及之标的公司是合法存续的、并由甲方合法持有 100% 股权的公司。

②标的公司的全部资产经拥有评估资质的北京中企华资产评估有限责任公司评估，出具了以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日的中企华评报字（2024）第 6506-04 号《资产评估报告书》。

③标的公司不存在《资产评估报告书》或已披露信息及本合同附表中所列以外的、未被披露或遗漏的、可能产生重大不利影响的事项。

④甲乙双方在信赖《资产评估报告书》评估结果和已披露信息中已予适当披露信息的基础上，达成本合同各项条款。

（4）产权转让方式

本合同项下产权交易已于 2024 年 11 月 15 日经北交所公开发布产权转让信息披露公告，公告期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方受让本合同项下转让标的。

（5）产权转让价款、支付以及交易费用的承担

①转让价款

根据公开信息披露结果，甲方将持有的标的公司 100%股权转让给乙方，转让价款人民币（大写）柒亿叁仟贰佰玖拾肆万肆仟捌佰元（即：人民币（小写）732,944,800 元）。

②计价货币

本次产权转让的转让价款以人民币作为计价单位，并以人民币等值美元支付。

转让价款以乙方支付剩余转让价款（定义如下）前一个中国工作日中国人民银行公布的人民币汇率中间价（“基准汇率”）折算确定，已支付的保证金按基准汇率折算转为相应转让价款。

乙方逾期支付转让价款的，应付转让价款最后一日（即指生效日之后的第五个工作日）与实际支付日期期间的汇率风险，由乙方承担。

③转让价款支付方式

乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求已分别向甲方一与甲方二支付保证金，于乙方按照本合同约定支付转让价款扣除保证金按照基准汇率计算的金

额（“剩余转让价款”）后，保证金折抵为转让价款的一部分。

乙方采用一次性付款方式，按照甲方一与甲方二在标的公司中的持股比例将剩余转让价款在交割日汇入甲方一与甲方二指定的账户。

④产权交易费用的承担

本合同项下产权交易过程中所产生的各项税费、产权交易费用，由合同各方依照适用法律自行承担并缴纳。

（6）产权转让的交割事项

①本合同项下的产权转让为甲方打包转让其持有的标的公司 100%股份以及甲方二持有的 TIS 0.003%股份。乙方受让标的公司 100%股份时，必须同时受让甲方二在北交所挂牌转让 TIS 0.003%股份（“TIS 股份交易”）。

②甲乙双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务，并尽最大努力，配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。

③在适用的情况下，如集团公司中存在使用甲方或所属国家出资企业及其各级子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，乙方应当在获得北交所出具的产权交易凭证后 20 个工作日内，办理名称变更登记并承诺不继续使用上述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

④甲乙双方特此承认并声明，本次产权转让在披露公告期为尽职调查期，乙方在披露公告期内有权利和义务对集团公司进行尽职调查。

甲乙双方确认，甲方已按照本合同的条款就已披露信息向乙方已予适当披露，已披露信息的内容状态以其披露时为准，但需符合本合同的约定。

⑤甲乙双方特此承认并声明，乙方递交受让申请、通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可北交所公告及所涉及的包括但不限于审计报告、资产评估报告等置于北交所的备查文件的全部内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容，承担全部相关风险。

⑥合同各方特此声明并同意，

截至本合同签署日，(A) GDL 尚向甲方二欠有借款本金 417.7 万美元（“甲方二给 GDL 贷款”）及根据相关借款协议规定所产生的尚未支付的利息，以及（B）标的公司尚向甲方二欠有借款本金 1,500 万欧元（“甲方二给标的公司贷款”）及根据相关借款协议规定所产生尚未支付的利息。

合同各方一致确认，在本合同签署日：

a) 乙方作为出借人，应当与 GDL 作为借款人签署一份贷款协议（“《GDL 借款协议》”），《GDL 借款协议》于本合同生效日生效。根据《GDL 借款协议》的条款，乙方应向 GDL 出借本金金额不少于甲方二给 GDL 贷款以及截至交割日根据相关借款协议产生的尚未支付的利息的贷款（“乙方给 GDL 贷款”）。

b) 乙方作为出借人，应当与标的公司作为借款人签署一份贷款协议（“《标的公司借款协议》”），《标的公司借款协议》于本合同生效日生效。根据《标的公司借款协议》的条款，乙方应向标的公司出借本金金额不少于甲方二给标的公司贷款及截至交割日根据相关借款协议产生的尚未支付的利息的贷款（“乙方给标的公司贷款”）。

c) 为明确起见，上述乙方给 GDL 贷款及乙方给标的公司贷款不构成转让价款的一部分。

合同各方进一步同意，在本合同签署日：

a) 乙方、GDL 以及甲方二，应当共同签署一份三方协议（“《GDL 贷款三方契据》”），该协议于本合同生效日生效。根据该协议的条款，GDL 应不晚于交割日向甲方二偿还甲方二给 GDL 贷款以及截至交割日根据相关借款协议产生的尚未支付的利息；且根据《GDL 借款协议》以及《GDL 贷款三方契据》，GDL 应指示乙方代为向甲方二偿还甲方二给 GDL 贷款及截至交割日根据相关借款协议产生的尚未支付的利息。

b) 乙方、标的公司以及甲方二，应当共同签署一份三方协议（“《标的公司贷款三方契据》”），该协议于本合同生效日生效。根据该协议的条款，标的公司应不晚于交割日向甲方二偿还甲方二给标的公司贷款及截至交割日根据相关借款协议产生的尚未支付的利息；且根据《标的公司借款协议》以及《标的公司贷款三方契据》，标的公司应指示乙方代为向甲方二偿还甲方二给标的公司贷

款及截至交割日根据相关借款协议产生的尚未支付的利息。

⑦在标的公司及 GDL 归还完毕甲方二借款且交割后，甲方不再拥有标的公司的股东身份，不再享有标的公司表决权等股东权益。乙方可根据标的公司所在地法律规定及自身需求，自行修改标的公司的公司章程等内部文件，甲方将尽最大努力配合。

⑧限制性约定

在符合适用法律规定的前提下，各甲方同意并向乙方及集团公司承诺，甲方（以自身名义或者连同或代表任何其他人士、公司或企业）不得、亦应确保其关联方不得直接或间接地：

a) 在交割日后三年内，与集团公司的主要业务开展竞争，或涉足与集团公司的主要业务类似或有竞争关系的业务。就此明确，甲方及其下属子公司在截至本合同签署日时所从事的业务活动包括但不限于电子产品制造，并不属于类似于或者与主要业务有竞争关系的业务。为避免疑义，特此明确，甲方二正在使用电子制造生产线。甲方二在使用、潜在处置或对此类生产线及/或制造业务进行任何其他处置方面均不受任何限制，但前提是甲方二不得向任何第三方提供与集团公司存在竞争关系的电子制造服务；

b) 在交割日后三年内，主动诱聘、招揽集团公司的任何员工或通过其他方式试图诱使其离开集团公司；

c) 诱导或试图诱导任何重要客户或供应商停止或避免与集团公司的业务往来，减少与集团公司的业务量，对其与集团公司的业务条款做出不利更改；

d) 向任何人士披露或使用在作为集团公司股东、员工、董事或服务提供商期间所获取的任何经营信息或知识，包括技术、商业、财务或任何其他性质的信息或知识，但上述相关信息已成为公开信息的除外；

e) 发表任何对集团公司活动、业务、专有技术、项目和产品、客户、战略、财务或贸易状况不利的公开言论或评论，更广泛地来说，不得做出任何可能损害集团公司形象或声誉的行为。

在符合适用法律规定的前提下，乙方以及标的公司同意，及促使其他集团公

司，向甲方承诺，其不得（a）在交割日后三年内，主动诱聘、招揽甲方的任何员工或通过其他方式试图诱使其离开甲方；及（b）向任何其他人士披露或使用（仅且就乙方而言，以其作为标的公司股东的身份所能获取的）甲方及其关联方的任何经营信息或知识，包括技术、商业、财务或任何其他性质的信息或知识，但上述相关信息已成为公开信息或集团公司有权在正常业务过程中使用的除外。

各方特此承认并声明，如一方违反本条中的限制，违约方需向守约方基于其违反上述合同义务的行为支付赔偿金。赔偿金以违约行为对守约方造成的直接实际损失为限。违约方需在其知晓违约行为发生后尽快通知守约方，并给出相关的证明文件。

（4）各方特此承认并声明，本条中的各项限制在本合同签署日以及生效日的情况下均具有合理性，且上述各项限制均应独立于其他限制予以解释和生效。

（5）本条中的各项约定和协定均具有单独性、独立性和可分割性。

本条明确规定的所有权利、救济和福利均具有可累积性，不与法律、本条或其他处规定的任何权利、救济和福利相斥，一方行使任何救济均不应被视为选择排除任何其他救济（其他各方特此放弃提出任何此类主张）。

（7）职工安置方案

本合同项下的交易不涉及职工调整，不涉及职工安置工作。

（二）TIS 工厂 0.003%股权的《产权交易合同》主要内容

1、合同主体和签订时间

上市公司之子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 与交易对方 IEE International Electronics & Engineering S.A. 及标的公司 TIS Circuits SARL 签署了 TIS 工厂 0.003% 股权的《产权交易合同》。

转让方（以下简称甲方）：IEE International Electronics & Engineering S.A.

受让方（以下简称乙方）：All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.

标的公司（以下简称丙方）：TIS Circuits SARL

（甲方、乙方合称为“甲乙双方”，甲方、乙方、丙方合称“各方”或“合

同各方”）

2、产权转让标的

（1）本合同转让标的为甲方所持有的标的公司 1 股普通股股权，占总股本约 0.003% 股权。

（2）甲方就其持有的标的公司股权（股份）所认缴的出资已经全额缴清。

（3）转让标的上不存在任何形式的担保，包括但不限于在该转让标的上设置质押或任何影响产权转让的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。

3、标的公司

（1）本合同所涉及之标的公司是合法存续的、并由甲方合法持有约 0.003% 股权的公司。

（2）标的公司的全部资产经拥有评估资质的北京中企华资产评估有限责任公司评估，出具了以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日的中企华评报字（2024）第 6506-03 号《资产评估报告书》。

（3）标的公司不存在《资产评估报告书》或已披露信息以外的、未被披露或遗漏的、可能产生重大不利影响的事项。

（4）甲乙双方在信赖《资产评估报告书》评估结果和已披露信息中已予适当披露信息的基础上，达成本合同各项条款。

4、产权转让方式

本合同项下产权交易已于 2024 年 11 月 15 日经北交所公开发布产权转让信息披露公告，公告期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方受让本合同项下转让标的。

5、产权转让价款、支付以及交易费用的承担

（1）转让价款

根据公开信息披露结果，甲方将持有的标的公司 1 股普通股转让给乙方，转让价款人民币（大写）壹元（即：人民币（小写）1 元）。

（2）计价货币

本次产权转让的转让价款以人民币作为计价单位，并以人民币等值美元支付。转让价款以乙方支付转让价款前一个中国工作日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算确定。

乙方逾期支付转让价款的，应付转让价款最后一日（即指生效日之后的第五个中国工作日）与实际支付日期期间的汇率风险，由乙方承担。

（3）转让价款支付方式

乙方采用一次性付款方式，将转让价款对应的等值美元在交割日汇入甲方指定的账户。

（4）产权交易费用的承担

本合同项下产权交易过程中所产生的各项税费、产权交易费用，由合同各方依照适用法律自行承担并缴纳。

6、产权转让的交割事项

（1）本合同项下的产权转让为甲方及 Hiwinglux S.A.打包转让其持有的 All Circuits S.A.S.100%股份以及甲方持有的标的公司约 0.003%股份。乙方受让 All Circuits S.A.S.100%股份时，必须同时受让甲方在北交所挂牌转让标的公司约 0.003%股份。

（2）甲乙双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务，并尽最大努力，配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。

（3）在适用的情况下，如标的公司中存在使用甲方或所属国家出资企业及其各级子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，乙方应当在获得北交所出具的产权交易凭证后 20 个工作日内，办理名称变更登记并承诺不继续使用上述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

（4）甲乙双方特此承认并声明，本次产权转让在披露公告期为尽职调查期，乙方在披露公告期内有权利和义务对标的公司进行尽职调查。

(5) 甲乙双方特此承认并声明，乙方递交受让申请、通过资格确认后，即视为已详细阅读并完全认可北交所公告及所涉及的包括但不限于审计报告、资产评估报告等置于北交所的备查文件的全部内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容，承担全部相关风险。

7、职工安置方案

本合同项下的交易不涉及职工调整，不涉及职工安置工作。

八、董事会对本次资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析

本次交易标的公司系上市公司航天科技的子公司。为落实公司战略规划，优化资产结构，航天科技采用在北京产权交易所公开挂牌方式，打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权。为此，航天科技聘请中企华对标的资产进行评估，并采用此评估结果进行国资备案，以及作为资产在北京产权交易所挂牌转让的挂牌底价依据。根据北京产权交易所挂牌转让信息，AC 公司 100%股权转让底价为 73,294.48 万元人民币，AC 公司之子公司 TIS 工厂 0.003%股权转让底价为 0.0001 万元人民币。

中企华以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日对 AC 公司股东全部权益的市场价值进行了评估，并出具了中企华评报字（2024）第 6506-04 号资产评估报告。截至 2024 年 6 月 30 日，AC 公司合并口径经审计的总资产 31,060.44 万欧元，负债 22,147.78 万欧元，净资产 8,912.67 万欧元。本次评估采用收益法和市场法，最终评估结论采用收益法的评估结果，即 9,351.80 万欧元（按照评估基准日人民币兑欧元汇率 7.6617 折合人民币 71,650.69 万元），较账面价值评估增值 439.14 万欧元（按照评估基准日人民币兑欧元汇率 7.6617 折合人民币 3,364.56 万元），增值率 4.93%。

2024 年 11 月 15 日，北京产权交易所发布产权转让信息披露公告，公告期间，公司之子公司 AC Holdings 是唯一意向受让方。本次交易最终以挂牌底价为成交金额，即 73,294.48 万元人民币。

综上，公司董事会认为：本次交易定价不以评估结果为依据，该次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为交易对方挂牌底价的参考。光弘科技综合考虑标的公司的财务状况、品牌影响力、客户资源等因素的基

础上，以支付现金的方式参与相关资产在北京产权交易所竞拍，最终交易定价系根据北京产权交易所公开挂牌结果确定，本次交易定价具有公允性。

九、本次评估情况

本次交易定价不以评估结果为依据，为验证本次交易定价的公平合理性，公司聘请符合《证券法》规定的评估师国众联对标的公司截至 2024 年 12 月 31 日股东全部权益价值进行评估。

国众联以 2024 年 12 月 31 日为基准日对 AC 公司 100%股权价值进行评估，采用资产基础法和市场法，并以市场法结果作为最终评估结论。经评估，资产基础法下，AC 公司于评估基准日 2024 年 12 月 31 日资产总额账面值 210,053.26 万元，评估值为 215,426.49 万元，评估增值 5,321.56 万元，增值率 2.53%；负债总额账面值 145,445.01 万元，评估值为 145,445.01 万元，评估值与账面值无差异；归属于母公司所有者权益账面值 64,608.35 万元，评估值为 69,929.81 万元，评估增值 5,321.46 万元，增值率 8.24%。市场法下，AC 公司于评估基准日 2024 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益评估值为 72,373.17 万元，评估值较股东权益账面值增值 7,764.81 万元，增值率为 12.02%。

本次评估采用市场法的评估结果，AC 公司于评估基准日的归属于母公司所有者权益价值评估值为 72,373.17 万元。

公司董事会认为：

1、国众联具有证券服务业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估人员与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。

2、国众联对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

本次交易定价不以评估结果为依据，为便于广大投资者对本次交易定价水平的公允性进行判断，验证本次交易定价的公平合理性，公司聘请了符合《证券法》规定的国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为评估机构对标的公司股东全部权益价值进行评估并出具了《评估报告》。本次资产评估工作符合国家相关

法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，选用的参照数据、资料可靠，评估方法选用恰当，评估结论合理。

3、国众联对交易资产采用资产基础法和市场法对标的资产价值进行了评估，并最终采用市场法的评估值作为标的资产的评估值。与评估目的的相关性一致。

4、本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了恰当的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，选取的折现率等重要评估参数符合评估对象的实际情况，评估结论具有公允性。

综上所述，公司董事会认为：评估师国众联具有独立性，评估假设前提和评估结果合理，评估方法具有适用性，评估定价公允。

十、本次收购资产最近三年评估或交易情况

本次发行人收购标的公司的前三年内，标的公司不存在其他评估或交易的情况。

第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构变动情况

（一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次发行募集资金在扣除发行费用后拟用于购买标的资产和补充流动资金。本次交易系上市公司在电子制造服务行业深化全球布局的战略延续。公司通过本次交易，顺利取得 AC 公司和 TIS 工厂 100%的控制权。AC 公司主营业务为汽车行业的电子控制模块制造服务，因此上市公司主营业务不会发生变化，仍为电子制造服务业务。

截至本募集说明书签署日，除本次募集资金投资项目涉及标的公司与公司进行整合外，公司暂无对本次发行完成后的业务和资产作出重大调整计划。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。公司将按照发行的实际情况对公司章程中关于公司注册资本、股本结构及与本次发行相关的事项进行调整，并办理工商变更登记。

（三）本次发行对股本结构的影响

截至 2025 年 6 月 30 日，光弘投资直接持有公司股份 395,691,660 股，占公司总股本的 51.56%，为公司的控股股东。

唐建兴直接持有公司股份 282,000 股，占公司总股本的 0.04%，并通过宏天创富有限公司、进科投资有限公司、光弘投资有限公司间接控制公司 395,691,660 股股份，占公司总股本的 51.56%；从而，唐建兴先生合计控制公司 395,973,660 股股份，占公司总股本的 51.60%，为公司实际控制人。

假设本次发行股份的规模为 230,238,206 股，本次发行完成后，公司的总股本为 997,698,895 股，光弘投资持有公司 39.66%的股份，仍为公司控股股东，唐建兴先生合计控制公司 39.69%的表决权，仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

截至本募集说明书签署日，公司尚无对公司高级管理人员结构进行调整的计划，本次发行不会对公司高级管理人员结构造成重大影响。若公司在未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务结构的影响

本次向特定对象发行的募集资金主要用于购买标的资产和补充流动资金。本次募集资金投资项目收购标的资产的主营业务为汽车行业的电子控制模块制造服务，募集资金投资项目的实施将在公司主营业务保持不变的基础上，丰富并优化公司业务结构，对公司经营业务产生积极影响，有利于增强公司的持续经营能力和综合竞争力。

二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位、募投项目顺利开展和实施后，公司总资产与净资产规模将有所增加，有利于优化公司财务结构，增强公司抵御财务风险的能力，提升公司运营规模和经济效益，为公司后续业务的持续发展提供良好的保障。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行募集资金到位后，公司净资产和总股本将有所增加，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但募投项目顺利实施后，鉴于拟收购的标的公司业务发展稳健，预计未来将产生良好的经营效益，因此从中长期来看，公司的盈利能力和可持续经营能力将得到进一步提升。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着拟收购标的纳入公司合并范围，且募集资金逐步投入到公司的生产经营活动，未来公司经营活动现金流量将逐步增加。

三、本次发行后公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的业务和管理关系、关联交易及同业竞争变化情况

本次发行后，公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争不会发生变化。

本次发行后，若发生关联交易，公司将按照法律法规、《公司章程》的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障公司及非关联股东的利益。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人、控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司的净资产规模将有所提高，资产负债率将下降，资本结构进一步改善。公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在资产负债比率过低、财务成本不合理的情况。

六、本次发行融资间隔合理性说明

公司前次募集资金为 2019 年 12 月核准的非公开发行股票。前次非公开发行股票募集资金到位时间为 2020 年 4 月。本次向特定对象发行股票董事会决议日为 2024 年 11 月 25 日。前次非公开发行股票募集资金到位时间与本次董事会决议日间隔时间已超过 18 个月。本次发行融资间隔时间间隔符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条的规定，具有合理性。

第七节 前次募集资金使用的基本情况

一、前次募集资金情况

公司历次募集资金情况包括首次公开发行股票及 2019 年度非公开发行股票，其中，首次公开发行股票募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，故“前次募集资金”指 2019 年度非公开发行股票。

（一）非公开发行股票基本情况

经证监会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，光弘科技非公开发行 92,216,800 股新股。每股发行价为人民币 23.68 元，募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币 32,755,407.36 元后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。

上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10090 号”验资报告。

（二）前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			218,369.38			已累计使用募集资金总额			158,996.14	
						各年度使用募集资金总额			158,996.14	
变更用途的募集资金总额			不适用			2020 年投入			32,703.63	
						2020 年置换投入			6,891.73	
						2021 年投入			69,585.60	
						2022 年投入			42,801.13	
						2023 年投入			4,803.39	
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2024 年 1-9 月投入			2,210.66	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	光弘科技三期智能生产建设项目	光弘科技三期智能生产建设项目	198,320.66	176,688.44	126,598.95	198,320.66	176,688.44	126,598.95	50,089.49	2023 年 4 月
2	云计算及工业互联网平台建设项目	云计算及工业互联网平台建设项目	20,405.40	20,405.40	14,397.19	20,405.40	20,405.40	14,397.19	6,008.21	2024 年 4 月
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		不适用
合计			236,726.06	215,093.84	158,996.14	236,726.06	215,093.84	158,996.14	56,097.70	

注 1：募集前承诺投资金额系前次非公开原计划募集资金总额上限。实际根据最终发行价及核准的发行数量上限，募集资金总额为 218,369.38

万元，与募集前承诺投资总额存在一定差异。

注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异，主要系募投项目结项后节余资金补流导致。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况如下：

2022年4月21日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，增加公司全资子公司光弘电子（惠州）有限公司为“光弘科技三期智能生产建设项目”的实施主体，同时新增实施主体所在的经营地址，以及上市公司原有厂区增加为实施地点，以加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，符合公司实际需要。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金实际到位前，为了确保前次募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 68,917,364.05 元。2020年4月28日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 68,917,364.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 68,917,364.05 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	预先投入金额	置换金额
1	光弘科技三期智能生产建设项目	68,917,364.05	68,917,364.05
合计		68,917,364.05	68,917,364.05

（五）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		承诺效益	实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2022年	2023年	2024年1-9月		
1	光弘科技三期智能生产建设	本项目建设完成并全部达产	12,688.18	20,176.95	2,738.46	36,570.26	否

实际投资项目		承诺效益	实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2022 年	2023 年	2024 年 1-9 月		
	项目	后，预计可实现年销售收入 216,500 万元，净利润 30,687.04 万元					
2	云计算及工业互联网平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

云计算及工业互联网平台建设项目主要体现在智能化设备的购置及安装费用，一方面该项目的完成进度难以确定，另一方面，其受益为整个工厂精益化生产能力的提高，无法单独核算经济效益。补充流动资金目标是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力，因此无法单独核算经济效益。

3、未能实现承诺收益的说明

2024 年 1-9 月，光弘科技三期智能生产建设项目效益营业收入已达预计目标，净利润未达预计目标，主要原因是受整体行业形势等因素综合影响，公司整体成本、费用有所上升，故项目整体实现预期收入水平，但利润水平有所收窄。

（六）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	光弘科技三期智能生产建设项目	176,688.44	126,598.95	50,089.49
2	云计算及工业互联网平台建设项目	20,405.40	14,397.19	6,008.21
3	补充流动资金项目	18,000.00	18,000.00	-
合计		215,093.84	158,996.14	56,097.70

公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，加强项目

各个环节费用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出，形成了资金节余。

（七）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司将该募集资金投资项目于2023年4月18日节余募集资金约58,402.52万元及其之后产生的利息（实际划转金额为58,521.35万元）用于永久补充流动资金。

2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司将该募集资金投资项目截至2024年4月15日的节余募集资金约7,673.19万元用于永久补充流动资金。

（八）会计师事务所对公司前次募集资金使用情况报告的鉴证结论

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次非公开发行股票募集资金使用情况报告出具了“信会师报字[2024]第ZI10566号”鉴证报告，鉴证结论如下：

“我们认为，光弘科技截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了光弘科技截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况。”

二、对到账时间超过五年的前次募集资金用途是否存在变更的核查

公司到账超过五个会计年度的募集资金为首次公开发行股票募集资金。公司首次公开发行股票募集资金未发生用途变更情况。

第八节 与本次发行相关的风险因素

一、经营与业务风险

（一）国际形势动荡及国际化管理的风险

现阶段国际贸易形势复杂多变，为整个电子行业带来诸多不确定因素。公司从事的电子制造行业可能会受到关税政策的影响。关税政策会推动电子制造供应链在具有地缘优势、政策优势和成本优势的地区投资布局新产能，降低因特定区域加征关税所带来的经营风险；同时也会促使企业推动技术创新，提高产品附加值，增强在高关税环境下的竞争力。在此背景下，公司正积极向海外市场进军，加速在东南亚、欧洲、美洲、非洲等地区布局，在绕开贸易保护主义所带来的壁垒的同时寻找新的机遇。

公司国内工厂生产的产品主要提供给境内客户，由客户实现终端销售，直接外销的金额及占比有限。公司在海外布局的生产场地以在当地实现终端销售为主。本次收购完成后，公司的全球化布局从东南亚进一步拓展至在美洲（墨西哥）、欧洲（法国）以及非洲（突尼斯）新增制造基地，全球化布局进一步完善，可以更灵活调整供应链策略以应对包括加征关税在内的限制性政策影响。

报告期内，公司境外收入分别为 125,289.95 万元、238,174.42 万元、295,448.93 万元、167,374.67 万元，占公司当期收入比例分别为 29.98%、44.09%、42.93%、50.44%，比重逐步提升且报告期最后一期末占比较高，主要系 2025 年 5 月完成对 AC 公司的收购，合并了 AC 公司的境外销售收入，使得境外收入金额占比逐步提升。海外布局的推进为公司新时代下全球化管理带来了新的挑战，海外市场的拓展及全球化管理体系的构建都存在不确定性，可能存在公司实际经营结果不及预期的风险。

（二）人工成本持续上涨的风险

随着未来新厂房投入生产及产能规模持续提升，用工需求仍将持续增加，为了吸引新员工加入和保持员工队伍的稳定，公司可能需要进一步提高其薪酬待遇，未来人工成本依然对公司经营形成一定的负担。如果公司不能通过设备升级和自动化的普及等措施平衡人工成本的上升，可能导致利润规模下降，进而影响公司

发展。

（三）客户集中的风险

2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月，公司来自前五名客户（合并口径）的销售收入金额分别为 306,289.68 万元、411,750.85 万元、497,100.25 万元和 201,124.30 万元，占营业收入的比例分别为 73.28%、76.22%、72.23%和 60.61%，主要客户收入占比较高。如果主要客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，公司可能无法持续获得客户订单以及项目收入，将对公司的生产经营带来不利影响。

（四）环保风险

公司从事的 EMS 服务过程中会产生一定程度的污染。随着环保部门对排放标准和总量控制的日益严格，以及对违法企业和违规项目执法力度的不断加大，公司若无法及时落实最新的环保监管要求或在环保方面出现违法违规行为，也将面临环保处罚的风险。

二、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金投资项目是发行人结合目前行业政策、行业发展、竞争趋势以及发行人发展战略等因素，在现有业务良好的发展态势和充分市场调研的基础上提出的。项目的实施将使得发行人的业务规模和范围将进一步扩展，行业地位提升，有利于发行人进一步增强核心竞争力。但在项目实施过程中，不排除因市场环境、产业政策、技术革新等不确定或不可控因素；或发行人综合管理能力、市场竞争能力、资金实力、技术实力不足等内部因素所带来的风险，从而对项目的顺利实施和预期效益造成不利影响。

（二）标的资产海外经营的合规风险

收购标的资产前，本公司没有在欧洲、美洲、非洲的投资项目，对设立于欧洲、美洲、非洲公司的企业文化、法律法规、商业惯例以及工会制度等经营环境将需一段时间适应，公司因而面临一定的管理和运营风险。同时，AC 公司及其子公司分布于境外多个国家，其实际运营受到不同国家税务、人力资源、环

境保护等法律的监管。如公司后续无法对 AC 公司开展统筹管理，未能发现标的资产在海外经营中可能存在的因税务、人力资源、环境保护等各方面不符合当地法规而导致诉讼、处罚等情况，则可能引发生产经营与财务管理等方面的风险，进而对本公司的盈利状况、长远发展与股东价值的实现造成负面影响。

（三）标的资产海外经营的政治风险

AC 公司及其子公司分布于法国、突尼斯、墨西哥等国家，境外各国的社会治安、政治局势、利益团体可能存在动荡因素，如果 AC 公司及子公司所在国的政治环境发生明显变化或出现社会动荡，可能对标的公司生产经营造成不利影响。

（四）交易完成后标的资产的整合风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的子公司，上市公司规模及业务管理体系进一步扩大，上市公司与各子公司之间的沟通、协调难度亦会随着数量增多而上升。虽然上市公司根据其发展战略在收购标的公司之前积累了一定的整合经验，但本次交易完成后，由于上市公司与标的公司在发展阶段、主要市场、公司文化等方面有所不同，与标的公司能否在发展理念、业务运作、人才和财务管理等方面进行成功整合，以充分发挥本次交易的协同效应，尚存在一定的不确定性。

（五）标的公司经营业绩亏损风险

2024 年度，标的公司营业收入为 317,872.82 万元，净利润为-5,434.84 万元。标的公司经营业绩亏损，主要系当期标的公司产生较大的汇兑损失，使得当期财务费用大幅提高所致。目前，标的公司整体经营状况良好，且为应对此类风险，标的公司已对部分外币结算的销售和采购交易签订了远期外汇合同，用于管理外汇风险。但如果未来行业竞争加剧、汇率持续波动或标的公司整合情况不及预期等，可能导致标的公司经营业绩进一步恶化，进而对上市公司整体经营业绩产生不利影响。

三、财务风险

（一）业绩波动风险

2025 年 1-6 月，公司经营情况良好，实现营业收入 331,848.72 万元，同比增长 0.17%，实现净利润 11,167.20 万元，同比下滑 16.02%。公司营业收入增长的

情况下净利润有所下降，主要系行业竞争加剧、产品结构调整及业务整合等因素影响，使得毛利额下降和期间费用有所增加。公司持续打造国内、国外双循环的业务体系，满足品牌客户市场全球化的需求，致力于与客户在全世界范围展开更广泛合作。随着收购 AC 公司等一系列业务布局举措落地，公司有望迎来新一轮业绩增长点。但若市场、行业发展及业务拓展发展未达到预期，公司经营业绩仍可能存在下滑的风险。

（二）毛利率下滑的风险

2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 18.56%、17.53%、12.83%和 11.57%，整体存在一定的下降趋势，主要系行业竞争加剧、产品结构调整及业务模式变化等因素综合导致。

品结构调整及业务模式变化等因素综合导致。

报告期内，公司营业收入主要来自消费电子类业务和汽车电子类业务。消费电子类、汽车电子类业务的收入、占比和毛利率情况具体如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 1-6 月			2024 年度			2023 年度			2022 年度		
	金额	占比	毛利率	金额	占比	毛利率	金额	占比	毛利率	金额	占比	毛利率
消费电子类	183,437.16	55.28	14.13	471,347.83	68.50	14.65	425,468.00	78.75	18.66	333,464.92	79.78	19.50
汽车电子类	114,418.63	34.48	7.14	159,190.39	23.13	5.64	70,291.68	13.01	10.79	17,055.58	4.08	20.30
小计	297,855.79	89.76	—	630,538.22	91.63	—	495,759.68	91.76	—	350,520.50	83.86	—
营业收入合计	331,848.72	100.00	11.57	688,141.22	100.00	12.83	540,244.90	100.00	17.53	417,978.02	100.00	18.56

报告期各期，公司的消费电子业务毛利率分别为 19.50%、18.66%、14.65%和 14.13%，主要系（1）业务模式占比变化：自购料模式可以大大加深与客户的合作，是 EMS 企业进一步发展的必经之路，公司自购料模式（OEM 业务）销售占比逐年增长，毛利率较公司传统的客供料模式低；（2）生产环节增加：随着经济环境变化及行业竞争逐步激烈，客户通过向上游转移更多生产环节/工艺以降低成本，导致上游企业毛利率下滑。

报告期各期，公司汽车电子业务毛利率分别为 20.30%、10.79%、5.64%和 7.14%，主要系（1）公司汽车电子类业务在报告期内逐步开拓，成功进入知名汽车零部件供应商的供应链行列，2023 年以来随着市场及客户的开拓，业绩规

模快速增长，公司为开拓市场给予新进客户一定的价格让利，故毛利率有所下降；

(2) 2024 年以来，公司汽车电子类业务从销售传感器为主逐步开拓至销售高单位售价的 ADC 制成板，其销售占比上升，其成本也更高，且公司为开拓汽车电子市场采取更具有竞争力的定价策略，因此毛利率略低；(3) 2025 年 5 月起，AC 公司收入纳入公司合并范围，汽车电子业务为 AC 公司最主要业务，导致公司汽车电子产品结构发生变化，来自汽车电子业务的收入及占比大幅提升；产品毛利率较上年同期增加 2.63%，主要系经过前 2 年对汽车电子市场的开拓，以及逐渐开始形成规模经济，若剔除 AC 公司，2025 年 1-6 月光弘科技汽车电子产品的毛利率为 6.02%，较上年同期增加 1.51%，毛利率有所上升；以及 AC 公司主营业务为汽车电子类，且在该行业深耕多年，相对而言毛利率略高。

未来，若上述因素出现重大不利变化或公司未能把握新兴市场机遇、维持客户和品牌优势、积极推进产品升级，可能面临毛利率继续下降的风险，对经营业绩造成不利影响。

(三) 应收款项回收风险

2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 100,206.99 万元、157,100.11 万元、136,568.76 万元和 174,622.06 万元，占资产的比例分别为 17.21%、20.85%、16.62%、18.75%，虽然公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，且公司已经采取了严格的应收账款回收管理措施，以降低应收账款不能按期收回的风险，但是随着业务规模的扩大，公司应收账款金额可能进一步增加。如部分客户经营状况等发生不利变化或公司对应收账款催收不力，公司可能面临应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账的风险，进而影响公司的经营业绩和资金的正常周转。

(四) 汇率波动风险

公司外销收入主要以卢比等外币结算。报告期内，公司境外销售收入分别为 125,289.95 万元、238,174.42 万元、295,448.93 万元和 167,374.67 万元，占营业收入的比例分别为 29.98%、44.09%、42.93%和 50.44%。未来公司计划有序拓展海外市场，外销收入整体规模预计将逐渐增加。近年来我国央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，人民币的国际化程度有望进一步提高，人民币汇率

的双向波动呈现常态化。人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定因素，汇率的波动将影响公司外销产品的价格水平及汇兑损益，进而对公司经营业绩产生一定影响。

（五）本次收购完成后的商誉减值风险

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人因本次收购形成商誉账面价值为 10,639.79 万元。根据企业会计准则规定，商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。若未来发生商誉减值，则可能对本公司业绩造成重大不利影响。

（六）在建工程相关风险

报告期各期末，发行人在建工程账面价值分别为 9,367.03 万元、18,508.90 万元、39,323.86 万元和 61,779.68 万元，占资产的比例分别为 1.61%、2.46%、4.78%及 6.42%，主要为发行人在越南、孟加拉和深圳坪山等地兴建制造基地。若相关项目在建设、实施过程中，因行业政策波动、市场环境变化等因素导致项目的实施进度、预期效益未达预期，则可能导致发行人在建工程存在减值的风险，进而对发行人的盈利能力及财务状况造成不利影响。

此外，若因宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争加剧等因素，发行人在建工程项目产生效益未能弥补新增投资带来的资产折旧费用等，可能对发行人的盈利能力及财务状况带来不利影响。

四、与本次发行相关的风险

（一）审批风险

本次发行尚需深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公司本次发行能否取得相关批准或核准，以及最终取得批准及核准的时间存在一定不确定性。

（二）股市价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受到国家宏观政策的调控、股票市场的交易行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次向特定对象发行需要有关部门审批且需要

一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

（三）募集资金不足的风险

本次发行方案为向不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象定向发行股票募集资金。投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，可能面临募集资金不足乃至发行失败的风险。

（四）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司净资产规模将有所增加，总股本亦相应增加，随着募集资金投资项目的实施，公司的整体经营能力将有所提高，但在公司的总股本增加的情况下，如果公司未来业绩不能实现相应幅度的增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标存在一定的摊薄风险。

第九节 与本次发行相关的声明

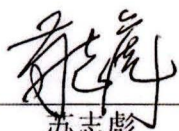
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：



唐建兴



苏志彪

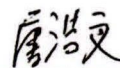


萧妙文

邹宗信



张鲁刚



唐浩文

郑馥丽

汤新联



王文利

非董事高级管理人员（签字）：



朱建军



王军发



邱乐群



徐宇晟

惠州光弘科技股份有限公司

2025 年 11 月 3 日



第九节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事（签字）：


邹宗信

惠州光弘科技股份有限公司

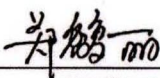
2025年11月3日

第九节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事（签字）：


郑馥丽

惠州光弘科技股份有限公司
2025年11月3日

第九节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事（签字）：



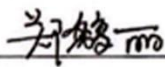
王文利



发行人审计委员会成员声明

本公司全体审计委员会成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员（签字）：



郑馥丽

唐浩文

汤新联



惠州光弘科技股份有限公司

2025 年 11 月 3 日

发行人审计委员会成员声明

本公司全体审计委员会成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员（签字）：

郑馥丽

唐浩文

唐浩文

汤新联

惠州光弘科技股份有限公司

2025 年 11 月 3 日

发行人审计委员会成员声明

本公司全体审计委员会成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员（签字）：

郑馥丽

唐浩文



汤新联

惠州光弘科技股份有限公司

2025年11月3日

二、发行人控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

For and on behalf of
DBG Investment Holdings Limited
光弘投资有限公司
控股股东（盖章）：光弘投资有限公司

.....
Authorized Signature(s)
法定代表人（签名）：_____

唐建兴

For and on behalf of
MENTECH INVESTMENT LIMITED
进科投资有限公司
间接控股股东（盖章）：进科投资有限公司

.....
Authorized Signature(s)
授权代表（签名）：_____

唐建兴

For and on behalf of
GRAND SKY CAPITAL INVESTMENT LIMITED
宏天创富有限公司
间接控股股东（盖章）：宏天创富有限公司

.....
Authorized Signature(s)
授权代表（签名）：_____

唐建兴



三、发行人实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人（签名）：



唐建兴

惠州光弘科技股份有限公司

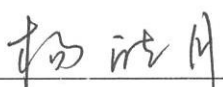
2025 年 11 月 3 日

四、保荐人（主承销商）声明

（一）保荐人（主承销商）声明

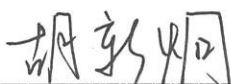
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：


杨皓月


李慧琪

项目协办人：


胡新炯

法定代表人：


朱 健



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 11 月 3 日

(二) 保荐人（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总经理（总裁）：



李俊杰

董事长：



朱 健



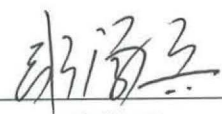
国泰海通证券股份有限公司

2025 年 11 月 3 日

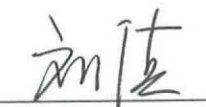
五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：


张学兵

经办律师：


刘 佳


岑梓彬



六、发行人会计师声明

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）

本所及签字注册会计师已阅读《惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称募集说明书），确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

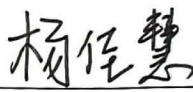

杨志国



签字注册会计师：


龙湖川




杨佳慧



立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年1月3日



（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



李惠琦

签字注册会计师：



路静茹



梁振敏

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



2025 年 11 月 3 日

七、发行人资产评估机构声明

本公司及签字评估师已阅读《关于惠州光弘科技股份有限公司申请向特定对象发行股票募集说明书》，确认募集说明书内容与本所出具的评估报告等文件不存在矛盾。本所及签字评估师对发行人在募集说明书中引用的评估报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

评估机构负责人：



黄西勤

正式执业会员
资产评估师

签字评估师：



肖乐平
47190079
肖乐平

正式执业会员
资产评估师
张明阳
47140009

张明阳

国众联资产评估土地房地产估价有限公司



2025年11月3日

八、发行人董事会声明

（一）公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

1、通过募投项目进一步提升公司持续盈利能力

本次向特定对象发行是公司为进一步提高竞争力及持续盈利能力所采取的重要措施。董事会已对本次向特定对象发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及本公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。

2、严格执行募集资金管理办法

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司将严格执行《募集资金管理办法》，本次发行完成后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，并将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

3、保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求和《公司章程》的相关规定，为健全公司科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制，公司第三届董事会第十六次会议对股东分红回报事宜进行了研究论证，制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，明确了股东的具体回报计划，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，有效维护和增加对投资者的回报。

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规

和规范性文件的要求，不断完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

5、加强人才队伍建设，积蓄发展活力

公司将不断改进绩效考核办法，建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，建立科学合理的用人机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。

（二）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

1、公司控股股东、实际控制人承诺

（1）在持续作为惠州光弘科技股份有限公司控股股东/实际控制人期间，本公司/本人不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；

（2）自本承诺出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本公司/本人届时将按照最新规定出具补充承诺；

（3）作为填补回报措施相关责任主体之一，如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

2、董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）对本人的职务消费行为进行约束；

(3) 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(5) 若公司后续推出股权激励政策, 则该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(6) 自本承诺出具日后, 如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的, 本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;

(7) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人承诺严格履行上述承诺事项, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(以下无正文)

(本页无正文，为本募集说明书之“发行人董事会声明”盖章页)

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2025年11月3日



附件一：发行人及其子公司拥有的不动产权情况

1. 境内土地使用权

序号	使用 权人	证书编号	土地位置	用途	面积（M ² ）	使用期 限至	取得 方式	他项 权利
1	发行人	粤（2017）惠 州市不动产权 第 3002242 号	惠州市惠阳区淡水 东华大坑水库 星河丹堤花园 D 区 66 幢 03 号房	城镇住宅 用地	111,022.85	2080.05.30	出让	无
2	发行人	粤（2017）惠 州市不动产权 第 4012025 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 5 号（光弘公司干 部宿舍楼）	工业用地	60,413.5	2052.11.12	出让	抵押
3	发行人	粤（2017）惠 州市不动产权 第 4012026 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 5 号（2 号厂房）	工业用地	60,413.5	2052.11.12	出让	抵押
4	发行人	粤（2017）惠 州市不动产权 第 4012027 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 5 号（光弘公司员 工宿舍楼 2）	工业用地	60,413.5	2052.11.12	出让	抵押
5	发行人	粤（2017）惠 州市不动产权 第 4012028 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 5 号（光弘公司员 工宿舍楼）	工业用地	60,413.5	2052.11.12	出让	抵押
6	发行人	粤（2017）惠 州市不动产权 第 4012029 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 5 号（厂房）	工业用地	60,413.5	2052.11.12	出让	抵押
7	发行人	粤（2022）惠 州市不动产权 第 4013352 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 8 号（8 号厂房）	工业用地	50,000	2065.10.27	出让	抵押
8	发行人	粤（2020）惠 州市不动产权 第 4091779 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 8 号（1 号门卫室）	工业用地	50,000	2065.10.27	出让	抵押
9	发行人	粤（2020）惠 州市不动产权 第 4091780 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 8 号（5 号员工宿 舍）	工业用地	50,000	2065.10.27	出让	抵押
10	发行人	粤（2020）惠 州市不动产权 第 4091781 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 8 号（6 号停车库）	工业用地	50,000	2065.10.27	出让	抵押
11	发行人	粤（2020）惠 州市不动产权 第 4091782 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 8 号（7 号设备房）	工业用地	50,000	2065.10.27	出让	抵押
12	发行人	粤（2020）惠 州市不动产权 第 4091783 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 8 号（2 号门卫室）	工业用地	50,000	2065.10.27	出让	抵押
13	发行人	粤（2020）惠 州市不动产权	惠州大亚湾西区 响水河永达路 8	工业用地	50,000	2065.10.27	出让	抵押

序号	使用 权人	证书编号	土地位置	用途	面积 (M ²)	使用期 限至	取得 方式	他项 权利
		第 4091784 号	号 (3 号厂房)					
14	发行人	粤 (2020) 惠 州市不动产权 第 4091785 号	惠州大亚湾西区 响水河永达路 8 号 (4 号打卡室)	工业用地	50,000	2065.10.27	出让	抵押
15	发行人	粤 (2022) 惠 州市不动产权 第 4042740 号	惠州大亚湾西区 龙海三路 95 号 (1 号厂房)	工业用地	50,000	2068.01.08	出让	无
16	发行人	粤 (2022) 惠 州市不动产权 第 4042741 号	惠州大亚湾西区 龙海三路 95 号 (2 号厂房)	工业用地	50,000	2068.01.08	出让	无
17	发行人	粤 (2022) 惠 州市不动产权 第 4042742 号	惠州大亚湾西区 龙海三路 95 号 (3 号打卡室)	工业用地	50,000	2068.01.08	出让	无
18	发行人	粤 (2022) 惠 州市不动产权 第 4042743 号	惠州大亚湾西区 龙海三路 95 号 (4 号干部宿舍)	工业用地	50,000	2068.01.08	出让	无
19	发行人	粤 (2022) 惠 州市不动产权 第 4042744 号	惠州大亚湾西区 龙海三路 95 号 (5 号员工宿舍)	工业用地	50,000	2068.01.08	出让	无
20	发行人	粤 (2022) 惠 州市不动产权 第 4042745 号	惠州大亚湾西区 龙海三路 95 号 (6 号门卫室)	工业用地	50,000	2068.01.08	出让	无
21	发行人	粤 (2022) 惠 州市不动产权 第 4042746 号	惠州大亚湾西区 龙海三路 95 号 (地下车库)	工业用地	50,000	2068.01.08	出让	无
22	深圳光弘 通讯电子 有限公司	粤 (2023) 深 圳市不动产权 第 0555511 号	坪山区坑梓街道 沙田社区丹梓北 路与规划中村路 交汇处西南侧	工业用地	53,001.09	2053.05.16	出让	无
23	嘉兴光弘 实业有限 公司	浙 (2021) 嘉 兴市不动产权 第 0003157 号	嘉兴市南湖区城 南街道天枢路 148 号	工业用地	28,725.90	2067.02.15	出让	无

注：发行人第 2-6 项不动产权属同一地块；发行人第 7-14 项不动产权属于同一地块；发行人第 15-21 项不动产权属同一地块。

2. 境外土地使用权

序 号	使用权人	证书编号	土地位置	用途	面积 (M ²)	使用期限 至	取得方 式
1	光弘科技 (越南)有 限公司	DC 280540	越南太原省 普安市社宏 进乡 (22 号 地图, 2206 号地块)	工业 区用 地	79,593.4	2068.08.25	向工业 区开发 商租赁 土地, 一次性 支付土 地租金
2	光弘科技 (越南)有	DH 823756	越南太原省 普安市宏进	工业 区用	116,622.4	2068.08.25	向工业 区开发

序号	使用权人	证书编号	土地位置	用途	面积 (M ²)	使用期限至	取得方式
	限公司		坊 (22 号地图, 2262 号地块)	地			商租赁土地, 一次性支付土地租金
3	光弘科技 (越南) 有限公司	DH 823757	越南太原省 普安市棉进坊 (6 号地图, 244 号地块)	工业区用地	6,592.8	2068.08.25	向工业区开发商租赁土地, 一次性支付土地租金
4	MSL Circuits S.A.S. ^注	ZO101、104、168、169	6 – 3ème avenue – Parc Synergie Val de Loire, 45130 Meung sur Loire, France	工业用地	80,000	-	行使融资租赁合同购买权

注：该地产于 2015 年被一分为二，分别为卢瓦尔河畔默恩 1 号地块和卢瓦尔河畔默恩 2 号地块。MSL 于 2015 年 6 月将卢瓦尔河畔默恩 2 号地块出售给 Bpifrance Financement、Natixis Lease Immo 和 CMCIC Lease，同时与 Bpifrance Financement、Natixis Lease Immo 和 CMCIC Lease 就卢瓦尔河畔默恩 2 号地块签订了融资租赁合同，租赁期限为 2025 年 4 月 1 日至 2040 年 3 月 31 日。

2022 年，1 号地块被一分为二，形成了卢瓦尔河畔默恩 3 号地块和卢瓦尔河畔默恩 4 号地块。MSL 在 2022 年将卢瓦尔河畔默恩 4 号地块出售给 Bpifrance、BPCE Lease Immo 和 Sogefimur，并同时就该卢瓦尔河畔默恩 4 号地块与 Bpifrance、BPCE Lease Immo 和 Sogefimur 签订了一份融资租赁合同，租赁期限为 2022 年 9 月 29 日至 2037 年 9 月 28 日。

根据众达国际法律事务所出具的法律备忘录，卢瓦尔河畔默恩 3 号地块及地上建筑物均由 MSL Circuits S.A.S. 所有。

附件二：发行人及其子公司房屋情况

序号	权利人	房产证号	房屋位置	面积 (M ²)	房屋用途	他项权利
1	发行人	粤(2017)惠州市不动产权第3002242号	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤花园D区66幢03号房	331.42	住宅	无
2	发行人	粤(2017)惠州市不动产权第4012025号	惠州大亚湾西区响水河永达路5号(光弘公司干部宿舍楼)	4,508.21	住宅	抵押
3	发行人	粤(2017)惠州市不动产权第4012026号	惠州大亚湾西区响水河永达路5号(2号厂房)	33,112.46	厂房	抵押
4	发行人	粤(2017)惠州市不动产权第4012027号	惠州大亚湾西区响水河永达路5号(光弘公司员工宿舍楼2)	15,904.09	住宅	抵押
5	发行人	粤(2017)惠州市不动产权第4012028号	惠州大亚湾西区响水河永达路5号(光弘公司员工宿舍楼)	15,782.6	住宅	抵押
6	发行人	粤(2017)惠州市不动产权第4012029号	惠州大亚湾西区响水河永达路5号(厂房)	33,243.72	厂房	抵押
7	发行人	粤(2022)惠州市不动产权第4013352号	惠州大亚湾西区响水河永达路8号(8号厂房)	40,488.99	工业	抵押
8	发行人	粤(2020)惠州市不动产权第4091779号	惠州大亚湾西区响水河永达路8号(1号门卫室)	56.48	工业	抵押
9	发行人	粤(2020)惠州市不动产权第4091780号	惠州大亚湾西区响水河永达路8号(5号员工宿舍)	11,657.97	集体宿舍	抵押
10	发行人	粤(2020)惠州市不动产权第4091781号	惠州大亚湾西区响水河永达路8号(6号停车库)	3,736.99	车库/车位	抵押
11	发行人	粤(2020)惠州市不动产权第4091782号	惠州大亚湾西区响水河永达路8号(7号设备房)	1,440	工业	抵押
12	发行人	粤(2020)惠州市不动产权第4091783号	惠州大亚湾西区响水河永达路8号(2号门卫室)	28	工业	抵押
13	发行人	粤(2020)惠州市不动产权第4091784号	惠州大亚湾西区响水河永达路8号(3号厂房)	40,286.12	工业	抵押
14	发行人	粤(2020)惠州市不动产权第4091785号	惠州大亚湾西区响水河永达路8号(4号打卡室)	19.20	工业	抵押
15	发行人	粤(2022)惠州市不动产权第4042740号	惠州大亚湾西区龙海三路95号(1号厂房)	46,698.70	工业	无
16	发行人	粤(2022)惠州市不动产权第4042741号	惠州大亚湾西区龙海三路95号(2号厂房)	76,957.95	工业	无
17	发行人	粤(2022)惠州市不动产权第4042742号	惠州大亚湾西区龙海三路95号(3号打卡室)	19.20	工业	无
18	发行人	粤(2022)惠州市不动产权第4042743号	惠州大亚湾西区龙海三路95号(4号干部宿舍)	10,031.17	集体宿舍	无
19	发行人	粤(2022)惠州市不动产权第4042744号	惠州大亚湾西区龙海三路95号(5号员工宿舍)	19,535.57	集团宿舍	无
20	发行人	粤(2022)惠州市不动产权第4042745号	惠州大亚湾西区龙海三路95号(6号门卫室)	224	工业	无

序号	权利人	房产证号	房屋位置	面积（M ² ）	房屋用途	他项权利
21	发行人	粤（2022）惠州市不动产权第4042746号	惠州大亚湾西区龙海三路95号（地下车库）	7,645.20	车库/车位	无
22	嘉兴光弘实业有限公司	浙（2021）嘉开不动产权第0003157号	嘉兴市南湖区城南街道天枢路148号	47,539.26	工业	无

附件三：发行人及其子公司租赁房屋情况

1. 境内租赁房产

序号	租赁主体	租赁物业地址	面积(M²)	租赁用途	租赁期限	产权证明
1	出租方：星华电子（惠州）有限公司 承租方：发行人	惠州大亚湾石化大道西 38 号星华电子工业园十栋厂房第三层、第四层	9,720	生产	2024.01.01-2025.12.31	粤房地权证惠州字第 3300006370 号
2	出租方：星华电子（惠州）有限公司 承租方：发行人	惠州大亚湾石化大道西 38 号星华工业园 B 栋宿舍三层至七层 200 间宿舍、A 栋及 B 栋宿舍二层平台、A 栋宿舍三至七层共 200 间宿舍	/	宿舍、职工文体活动室	2024.01.01-2025.12.31	粤（2025）惠州市不动产权第 4024800 号
3	出租方：星华电子（惠州）有限公司 承租方：发行人	惠州大亚湾石化大道西 38 号星华电子工业园第三栋厂房第一层、第二层	8,308	生产	2024.01.01-2025.12.31	粤房地权证惠州字第 3300000353 号
4	出租方：星华电子（惠州）有限公司 承租方：发行人	惠州大亚湾石化大道西 38 号星华电子工业园十栋厂房第二层北面	2,745	生产	2024.03.01-2026.02.28	粤房地权证惠州字第 3300006370 号
5	出租方：星华电子（惠州）有限公司 承租方：发行人	惠州市大亚湾经济技术开发区石化大道西 38 号星华工业园化学品仓库隔间六	15	仓库	2025.03.15-2025.12.31	粤房地权证惠州字第 3300006370 号
6	出租方：敏华智能科技（惠州）有限公司 承租人：发行人	广东省惠州市大亚湾西区新荷大道 433 号敏华智能家居驱动系统园区共 81 间宿舍	2,430	宿舍	2023.11.08-2025.11.30	粤（2024）惠州市不动产权第 4000462 号

2. 境外租赁房产

（1）作为承租方

序号	出租方	承租方	租赁物业地址	面积(M²)	租赁期限
----	-----	-----	--------	--------	------

序号	出租方	承租方	租赁物业地址	面积(M ²)	租赁期限
1	安平开发投资股份公司	光弘科技（越南）有限公司	越南太原省普安市同进坊、棉场坊及宏进坊安平工业区 CN16 及 CN17 号地块	201,808.68	2021 年 1 月至 2064.08.25
2	Alliance Financial Corporation SA	TIS Circuits SARL	Borj Ghorbal, Ben Arous Governorate, 2013 Ben Arous.	15,534	2018.10.01 至 2026.09.29
3	Sinetech, S.A. de C.V.	GDL CIRCUITS S.A. DE C.V.	Av. De las Americas 224, Guadalajara Technology Park, Zapopan, Jalisco.	-	2016.11.30 至 2028.11.30
4	CPMG	BMS Circuits S.A.S.	365 avenue Paul Gellos, industrial area in Mouguerre (64990)	55,613	2021.09.01 至 2030.08.30
5	SAPL ALDEV	BMS Circuits S.A.S.	7 rue du Bon Puits - Saint Sylvain D'Anjou in Verrière en Anjou (49480)	324.17	2019.02.01 至 2028.01.31
6	Hansainvest Hanseatische Investment GmbH	BMS Circuits S.A.S.	2 to 22 Place des Vins de France in Paris (75012)	111.86	2024.07.05 至 2033.07.04

(2) 作为出租方

序号	租赁主体	租赁物业地址	面积(M ²)	租赁用途	租赁期限
1	出租方：光弘科技（越南）有限公司 承租方：RQ Technology Electronics 越南有限责任公司	越南太原省普安市红进坊安平工业区 7 号厂房	19,382	工业厂房、执行办公室	2024.04.01-2029.03.31
2	出租方：光弘科技（越南）有限公司 承租方：Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd	越南太原省普安市红进坊安平工业区 9 号厂房	46,705	工业厂房、执行办公室	2024.08.18-2029.05.17
3	承租方：Totem France 出租方：BMS Circuits S.A.S.	Avenue Paul Gellos Lieu-dit Barthe Neuves, 64990 Mouguerre, 法国	38	-	2024.05.02-2030.05.01
4	承租方：IEE Sensing GDL, S.A. de C.V. 出租方：GDL CIRCUITS S.A. DE C.V.	Av. De las Americas 224, Guadalajara Technology Park, Zapopan, Jalisco, 墨西哥	3,200	-	2018.01.31-2028.11.30
5	承租方：INSOFOS, S.A.P.I. de C.V. 出租方：GDL	Av. De las Americas 224, Guadalajara	1,854	-	2025.03.01-2028.02.29

序号	租赁主体	租赁物业地址	面积(M²)	租赁用途	租赁期限
	CIRCUITS S.A. DE C.V.	Technology Park, Zapopan, Jalisco, 墨西哥			

附件四：发行人及其子公司拥有的专利情况

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	取得方式
1	一种注塑件生产零缺陷质量控制方法及其装置	发行人	发明专利	202411732647.3	2024.11.29	原始取得
2	一种导电布贴合治具	发行人	实用新型	202421513371.5	2024.06.28	原始取得
3	一种导电布贴附折边治具	发行人	实用新型	202420742629.2	2024.04.11	原始取得
4	一种移动终端摄像头自动组装装置	发行人	实用新型	202323651619.2	2023.12.30	原始取得
5	一种音频测试治具移送装置	发行人	实用新型	202420190388.5	2024.01.26	原始取得
6	一种终端测试上料装置	发行人	实用新型	202420078654.5	2024.01.12	原始取得
7	一种中框保护套	发行人	实用新型	202420398384.6	2024.03.01	原始取得
8	一种粘合保压装置	发行人	实用新型	202420040118.6	2024.01.08	原始取得
9	一种移动终端音频测试定位装置	发行人	实用新型	202420148372.8	2024.01.22	原始取得
10	一种电池尺寸检测装置	发行人	实用新型	202323457287.4	2023.12.19	原始取得
11	一种移动终端镜片压贴装置	发行人	实用新型	202323510132.2	2023.12.22	原始取得
12	一种粘接力测试装置	发行人	实用新型	202323569325.5	2023.12.27	原始取得
13	平板电脑生产用显示检测设备及检测方法	发行人	发明专利	202110871597.7	2021.07.30	原始取得
14	一种手机屏幕安装夹具	发行人	发明专利	201711145710.3	2017.11.17	原始取得
15	一种指纹点测机	发行人	实用新型	202223294951.3	2022.12.09	原始取得
16	一种前后工序可直接连接的拉拔设备	发行人	实用新型	202223363737.9	2022.12.15	原始取得
17	一种无尘工作台	发行人	实用新型	202222736287.7	2022.10.18	原始取得
18	一种分盘上料机构	发行人	实用新型	202223410876.2	2022.12.20	原始取得
19	一种吸附上料机构及上料机械手	发行人	实用新型	202223410872.4	2022.12.20	原始取得
20	一种屏幕点击测试装置	发行人	实用新型	202223169462.5	2022.11.29	原始取得
21	一种标签剥离机	发行人	实用新型	202222670226.5	2022.10.11	原始取得
22	一种夹紧定位机构及输送装置	发行人	实用新型	202223170166.7	2022.11.29	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	取得方式
23	一种彩盒抽检设备	发行人	实用新型	202123340827.1	2021.12.29	原始取得
24	一种锁螺钉设备	发行人	实用新型	202123197462.1	2021.12.20	原始取得
25	一种自动贴胶装置	发行人	实用新型	202123272029.X	2021.12.24	原始取得
26	一种自动撕膜装置	发行人	实用新型	202122970287.9	2021.11.30	原始取得
27	一种具有加热时间监控功能的胶水加热装置	发行人	实用新型	202123116664.9	2021.12.13	原始取得
28	一种线路板自动涂覆装置	发行人	实用新型	202123092578.9	2021.12.10	原始取得
29	一种导线自动扣合装置	发行人	实用新型	202123080637.0	2021.12.09	原始取得
30	5G 基站线路板的副板全板面焊接工艺及焊接治具结构	发行人	发明专利	202110242647.5	2021.03.05	原始取得
31	一种生产辅助作业平台	发行人	实用新型	202120996981.5	2021.05.11	原始取得
32	一种改善器件热膨胀变形的回流焊接方法	发行人	发明专利	201811516686.4	2018.12.12	原始取得
33	一种应用于线路板焊接的压板治具	发行人	实用新型	202120473140.6	2021.03.05	原始取得
34	一种高效散热的维修治具	发行人	实用新型	202022265869.2	2020.10.13	原始取得
35	一种物料运送装置	发行人	实用新型	202022265912.5	2020.10.13	原始取得
36	一种手机壳体良品检测的输送线	发行人	实用新型	202022235414.6	2020.10.10	原始取得
37	一种盲孔涂胶设备的定位治具	发行人	实用新型	202022236036.3	2020.10.10	原始取得
38	一种回流炉自动清洁装置	发行人	实用新型	202022266805.4	2020.10.13	原始取得
39	一种自动化工作台	发行人	实用新型	202022266804.X	2020.10.13	原始取得
40	一种自动升降小车	发行人	实用新型	202022235444.7	2020.10.10	原始取得
41	一种 USB 浮动插头	发行人	实用新型	202022235426.9	2020.10.10	原始取得
42	一种 SIM 卡和 SD 卡自动拔插装置	发行人	实用新型	202022236038.2	2020.10.10	原始取得
43	一种基于边缘侧模型处理的 SMT 表面组装组件焊点的质量评定方法	发行人	发明专利	202010025258.2	2020.01.10	原始取得
44	一种基于 iForest 模型验证的 SMT 焊点缺陷检测方法	发行人	发明专利	202010025249.3	2020.01.10	原始取得
45	一种自动拔插卡装置及具有其的手机检测治具	发行人	实用新型	201922308816.1	2019.12.20	原始取得
46	一种用于存放纸箱的镂空货架	发行人	实用新型	201922345104.7	2019.12.24	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	取得方式
47	一种防磨损定位治具	发行人	实用新型	201922296342.3	2019.12.19	原始取得
48	一种便于料盘回收的工作台	发行人	实用新型	201922308803.4	2019.12.20	原始取得
49	一种相邻工位的物料传递系统	发行人	实用新型	201922345119.3	2019.12.24	原始取得
50	一种双面治具及翻板装置	发行人	实用新型	201922322513.5	2019.12.23	原始取得
51	一种自动传卡装置	发行人	实用新型	201922297837.8	2019.12.19	原始取得
52	一种自动上下料工作台	发行人	实用新型	201922308822.7	2019.12.20	原始取得
53	一种保压床	发行人	实用新型	201922322179.3	2019.12.23	原始取得
54	一种多工位生产线的故障快速排查系统	发行人	实用新型	201922345055.7	2019.12.24	原始取得
55	一种改进的 SMT 钢网开口结构	发行人	实用新型	201822081661.8	2018.12.12	原始取得
56	一种焊接结构	发行人	实用新型	201822083529.0	2018.12.12	原始取得
57	一种生产线智能边仓系统	发行人	实用新型	201822129206.0	2018.12.19	原始取得
58	一种手机螺丝拆卸治具	发行人	实用新型	201822032974.4	2018.12.05	原始取得
59	一种手机主板维修治具	发行人	实用新型	201822051992.7	2018.12.07	原始取得
60	一种手机环境光测试装置	发行人	实用新型	201822033010.1	2018.12.05	原始取得
61	一种 SAR 传感器测试装置	发行人	实用新型	201822032335.8	2018.12.05	原始取得
62	一种 POS 机支付板双面焊接装置	发行人	实用新型	201821486353.7	2018.09.12	原始取得
63	一种镜片压合并带震动跌落的装置	发行人	发明专利	201610995926.8	2016.11.12	原始取得
64	一种触控移动终端及制造方法	发行人	发明专利	201810172534.0	2018.03.01	原始取得
65	一种物料箱放置架	发行人	实用新型	201721543092.3	2017.11.17	原始取得
66	一种手机连接线安装辅助笔	发行人	实用新型	201721541382.4	2017.11.17	原始取得
67	一种全自动定量触控面板点胶机	发行人	实用新型	201721543096.1	2017.11.17	原始取得
68	一种屏蔽盖装配装置	发行人	实用新型	201721542359.7	2017.11.17	原始取得
69	一种语音播放测试治具	发行人	实用新型	201721542337.0	2017.11.17	原始取得
70	一种周转车	发行人	实用新型	201721543072.6	2017.11.17	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	取得方式
71	一种物料箱回收辅助装置	发行人	实用新型	201721541401.3	2017.11.17	原始取得
72	一种螺钉机防护治具	发行人	实用新型	201721552512.4	2017.11.20	原始取得
73	一种路由器生产线焊锡工作台	发行人	实用新型	201721543039.3	2017.11.17	原始取得
74	一种路由器主板安装夹具	发行人	实用新型	201721543071.1	2017.11.17	原始取得
75	一种路由器生产线多层工作台	发行人	实用新型	201721542338.5	2017.11.17	原始取得
76	一种 PCBA 自动化测试系统	发行人	实用新型	201721542360.X	2017.11.17	原始取得
77	一种手机侧键测试头	发行人	实用新型	201721549840.9	2017.11.20	原始取得
78	一种外观扫码检测装置	发行人	实用新型	201721543094.2	2017.11.17	原始取得
79	一种手机屏幕安装夹具	发行人	实用新型	201721542346.X	2017.11.17	原始取得
80	一种螺钉锁付机	发行人	实用新型	201621217928.6	2016.11.12	原始取得
81	一种天线自动压合装置	发行人	实用新型	201621217936.0	2016.11.12	原始取得
82	一种在线称重的电子秤	发行人	实用新型	201621217929.0	2016.11.12	原始取得
83	一种万能贴标辅助治具	发行人	实用新型	201621217921.4	2016.11.12	原始取得
84	一种可兼容不同尺寸的保压夹具	发行人	实用新型	201621217925.2	2016.11.12	原始取得
85	一种尺寸可调防反向的机载夹具	发行人	实用新型	201621217884.7	2016.11.12	原始取得
86	一种镜片压合并带震动跌落的装置	发行人	实用新型	201621217926.7	2016.11.12	原始取得
87	一种可适应平板产品不同尺寸的检测夹具	发行人	实用新型	201621217903.6	2016.11.12	原始取得
88	一种静电防控系统	发行人	实用新型	201620392115.4	2016.05.04	原始取得
89	一种热能回收系统	发行人	实用新型	201620392113.5	2016.05.04	原始取得
90	一种点胶装置	发行人	实用新型	201620392153.X	2016.05.04	原始取得
91	一种用于 POS 机终端的防刺探结构	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202420596817.9	2024.03.26	原始取得
92	一种带有防拆组件的 POS 机终端	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202420615235.0	2024.03.28	原始取得
93	网关（新能源车载用）	深圳光弘通信科技	外观设计	202430279658.5	2024.05.13	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	取得方式
		有限公司				
94	一种新能源车载用的以太网网关	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202421044567.4	2024.05.14	原始取得
95	一种移动支付盒子控制系统	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202322852668.6	2023.10.24	原始取得
96	一种支付盒子用支架	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202322598546.9	2023.09.25	原始取得
97	一种扫码盒子安装座	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202322564547.1	2023.09.21	原始取得
98	一种防蓝光干扰的扫码盒子	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202322551027.7	2023.09.20	原始取得
99	一种基于轨道交通信息处理终端的数据监测方法	深圳光弘通信科技有限公司	发明专利	202210125087.X	2022.02.10	原始取得
100	扫码盒子	深圳光弘通信科技有限公司	外观设计	202330610261.5	2023.09.19	原始取得
101	一种多媒体会议终端	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202320238042.3	2023.02.17	原始取得
102	一种商品扫码移动支付装置	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202320238039.1	2023.02.17	原始取得
103	一种视频会议一体机	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202320238034.9	2023.02.17	原始取得
104	一种高清视频会议一体机	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202221149337.5	2022.05.13	原始取得
105	一种餐饮商铺用移动支付终端	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202221149351.5	2022.05.13	原始取得
106	一种高铁座椅显示屏	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202221149190.X	2022.05.13	原始取得
107	移动支付终端（餐饮商铺用）	深圳光弘通信科技有限公司	外观设计	202230280439.X	2022.05.13	原始取得
108	一种便于户外使用的智能手机	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	202220164274.4	2022.01.20	原始取得
109	一种三防平板电脑	深圳光弘	实用	202220179130.6	2022.01.20	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	取得方式
		通信科技有限公司	新型			
110	一种车载智能通讯终端防盗结构	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	201920290477.6	2019.03.07	原始取得
111	一种便于安装的车载终端	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	201920298525.6	2019.03.07	原始取得
112	一种便携式智能终端	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	201920298523.7	2019.03.07	原始取得
113	一种具有调节功能的车载台	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	201920293948.9	2019.03.07	原始取得
114	一种车载终端的报警装置	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	201920301716.3	2019.03.07	原始取得
115	一种防水型智能手机	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	201920368122.4	2019.03.21	原始取得
116	折叠平板支架	深圳光弘通信科技有限公司	外观设计	201830434002.0	2018.08.07	原始取得
117	一种柜台式 POS 机	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	201820104787.X	2018.01.22	原始取得
118	一种平板电脑用摄像头测试架	深圳光弘通信科技有限公司	实用新型	201721645419.8	2017.11.30	原始取得
119	POS 机 (C111)	深圳光弘通信科技有限公司	外观设计	201830003695.8	2018.01.04	原始取得
120	一种用于 SMT 贴片机的防位移贴片装置	嘉兴光弘科技电子有限公司	发明专利	202210581381.1	2022.05.26	原始取得
121	电子价签产品撕离心纸工位自动吸取装置	嘉兴光弘科技电子有限公司	发明专利	202210583920.5	2022.05.27	原始取得
122	PCB 自动扫描测试装置	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	202322778194.5	2023.10.17	原始取得
123	西门子贴片机料架防撞装置	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	202322778199.8	2023.10.17	原始取得
124	保压治具 (TP 屏)	嘉兴光弘科技电子有限公司	外观设计	202330521043.4	2023.08.15	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	取得方式
125	FCT 测试接口自动插接装置	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	202322192204.7	2023.08.15	原始取得
126	GKG 印刷机瓶装锡膏自动加锡装置	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	202322192081.7	2023.08.15	原始取得
127	一种波峰治具旋转机构	嘉兴光弘科技电子有限公司	发明专利	202310728386.7	2023.06.19	原始取得
128	一种电子价签自动超声波压接设备	嘉兴光弘科技电子有限公司	发明专利	202110980676.1	2021.08.25	原始取得
129	一种电子价签生产用全自动组装设备	嘉兴光弘科技电子有限公司	发明专利	202111609328.X	2021.12.27	原始取得
130	管装 IC 自动送料装置	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	202221286470.5	2022.05.27	原始取得
131	一种自动测试治具	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	202221282423.3	2022.05.26	原始取得
132	线路板指示灯测试工装	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	202022891795.3	2020.12.02	原始取得
133	线路板检定用一次性分板测试工装	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	202022890054.3	2020.12.05	原始取得
134	无源式被动 RFID 电子标签	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	202022905839.3	2020.12.05	原始取得
135	一种应用于装配中的两耳打螺钉的打钉装置	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	201922021098.X	2019.11.21	原始取得
136	一种应用于装配中的集天线与外散片打钉装置	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	201922021163.9	2019.11.21	原始取得
137	一种应用于装配中的主板和天线支架打钉装置	嘉兴光弘科技电子有限公司	实用新型	201922027271.7	2019.11.21	原始取得
138	一种圆形电路板及其自动裁线焊接设备和加工方法	嘉兴光弘科技电子有限公司	发明专利	201910898310.2	2019.09.23	继受取得
139	一种检测治具	快板电子科技（上海）有限公司	实用新型	201921849278.0	2019.10.29	原始取得
140	检测治具	快板电子科技（上	外观设计	201930538344.1	2019.09.29	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	取得方式
		海)有限公司				
141	一种平面变压器磁芯 SMT 贴装工艺	发行人	发明专利	2024111626794	2024.08.23	原始取得
142	一种压合装置	发行人	实用新型	202422150075X	2024.09.03	原始取得
143	一种配件包装供给装置	发行人	实用新型	2024218152050	2024.07.30	原始取得

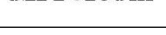
注：截至 2025 年 7 月 10 日，“201920290477.6”“201920298525.6”“201920298523.7”“201920293948.9”“201920301716.3”“201920368122.4”“201820104787.X”号专利处于“等年费滞纳金”状态；“201830434002.0”“201721645419.8”“201830003695.8”“202022891795.3”“202022890054.3”“202022905839.3”“201922021098.X”“201922021163.9”“201922027271.7”号专利处于“未缴年费专利权终止，等恢复”状态。

附件五：发行人及其子公司拥有的注册商标情况

1. 境内商标

序号	商标	注册号	权利人	注册类别	有效期
1		6891247	发行人	9	2020.07.28-2030.07.27
2		1793074	发行人	9	2022.06.21-2032.06.20
3		52933597	深圳光弘通信科技有限公司	9	2021.12.21-2031.12.20
4		28521514	深圳光弘通信科技有限公司	21	2018.12.14-2028.12.13
5		28512196	深圳光弘通信科技有限公司	18	2018.12.14-2028.12.13
6		54018464	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2021-10-28-2031.10.27
7		53996141	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2021.09.28-2031.09.27

2. 境外商标

序号	商标	注册号	权利人	注册类别	有效期	国家/地区
1		761606	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2021.03.26-2031.03.26	瑞士
2		150762	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2022.04.12-2031.12.08	阿曼
3		BT/T/2021/10016	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2021.12.14-2031.12.14	不丹
4		877031	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2022.06.22-2031.11.22	俄罗斯
5		4/2021/527154	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2022.04.25-2032.04.25	菲律宾
6		152824	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2022.11.21-2031.12.06	卡塔尔
7		/	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2022.09.05起	马尔代夫（注）
8		32502/2022	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2022.07.22-2031.11.30	毛里求斯
9		SC/T/2022/20	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2022.01.27-2032.01.27	塞舌尔

序号	商标	注册号	权利人	注册类别	有效期	国家/地区
10	GHTelcom	265816	惠州光弘通讯技术有限公司	9	-	斯里兰卡
11	GHTelcom	231102474	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2021.11.30-2031.11.29	泰国
12	GHTelcom	345899	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2022.07.04-2031.11.23	以色列
13	GHTelcom	IDM001008146	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2021.11.19-2031.11.19	印度尼西亚
14	GHTelcom	483105	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2024.03.14-2031.11.19	越南
15	GHTelcom	N/187122	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2022.01.11-2029.01.11	中国澳门特别行政区
16	GHTelcom	02224433	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2022.06.01-2032.05.31	中国台湾
17	GHTelcom	305717908	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2021.08.13-2031.08.12	中国香港特别行政区
18	GHTelcom	2203403	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2021.08.18-2031.08.18	澳大利亚
19	GHTelcom	018441047	惠州光弘通讯技术有限公司	9	2021.07.17-2031.07.16	欧盟
20		4944251	All Circuits S.A.S.	09, 38, 42	2023.03.10-2033.03.10	法国
21		013409834	MSL Circuits S.A.S.	09, 42	2014.10.28-2034.10.28	欧盟

注：根据发行人的专利代理机构的说明，马尔代夫无商标注册制度，采用警示公告形式。

附件六：发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权情况

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日	取得方式
1	LED 产品制造执行系统 V2.0	发行人	2016SR118743	2014.03.05	原始取得
2	通讯终端生产现场流程管控系统 V1.0	发行人	2016SR118741	2011.10.05	原始取得
3	电子制造看板管理系统[简称：电子看板系统] V1.0	发行人	2016SR118737	2015.10.05	原始取得
4	光纤接入终端测试数据分析系统[简称：测试专家] V1.0	发行人	2016SR093185	2014.08.01	原始取得
5	制造资源数字化信息统筹管理系统[简称：制造资源统筹管理系统] V1.0	发行人	2016SR093182	2016.03.01	原始取得
6	光纤接入终端专用制造执行管理系统[简称：光弘 MES] V2.0	发行人	2016SR093177	2016.03.01	原始取得
7	一键部署服务系统 V2.1.3	发行人	2018SR964207	2018.05.11	原始取得
8	按节拍零缺陷生产管控系统 V1.1.2	发行人	2019SR0131813	2018.07.20	原始取得
9	贴片机实时生产数据采集系统 V1.3.2	发行人	2019SR0131843	2018.10.12	原始取得
10	点胶胶量管控系统[简称：点胶系统] V1.0.0.0	发行人	2020SR0438359	2019.10.08	原始取得
11	胶水用量抽检管控系统 V1.0.0.20	发行人	2020SR1724327	2018.05.23	原始取得
12	回流炉检测炉温自助监控系统 V2.0.24.00	发行人	2021SR0159999	2020.08.08	原始取得
13	智能料车防错料系统 V10	发行人	2021SR1172395	未发表	原始取得
14	全工场全面大数据设备监控系统-SMT 设备监控系统[简称：设备监控系统] V1.0	发行人	2022SR0235493	未发表	原始取得
15	智慧供应链管理系统[简称：ISC 项目] 1.0	发行人	2022SR0088097	未发表	原始取得
16	直发仓系统 V1.0	发行人	2022SR0088098	未发表	原始取得
17	印刷机程序参数防呆管理 1.0.0	发行人	2023SR0180028	未发表	原始取得
18	料位表嵌入元件图例软件 1.0.0	发行人	2023SR0390536	未发表	原始取得
19	供应商管理系统-供应商质量审核管理集成研发 V1.0.9 234656 202309	发行人	2024SR0069226	未发表	原始取得

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日	取得方式
20	质量跟踪与监控系统 V1.0.8	发行人	2024SR0214250	未发表	原始取得
21	物料组单板段出入库记录软件 3.0.20.2	发行人	2023SR1195076	未发表	原始取得
22	一种外接多功能插座应用系统 V1.0	深圳光弘通信科技有限公司	2023SR1354808	2023.08.29	原始取得
23	汽车维修工业智能平板管理软件	深圳光弘通信科技有限公司	2023SR0397563	2022.12.26	原始取得
24	基于 RK 平台的两麦两回采系统软件	深圳光弘通信科技有限公司	2022SR1453150	2022.08.23	原始取得
25	明弘通过 ISP 方式给 MCU 下载固件软件	深圳光弘通信科技有限公司	2022SR1435977	2022.08.05	原始取得
26	用于交通信息处理平板终端的数据监测系统	深圳光弘通信科技有限公司	2022SR0270049	2022.01.04	原始取得
27	5G 移动终端整机信号自动测试系统	深圳光弘通信科技有限公司	2022SR0266820	2022.01.04	原始取得
28	明弘兼容双触摸屏系统	深圳光弘通信科技有限公司	2021SR0201055	2020.07.01	原始取得
29	明弘 RF433 无线传输通信系统	深圳光弘通信科技有限公司	2021SR0176977	2020.11.16	原始取得
30	明弘烤箱显示系统	深圳光弘通信科技有限公司	2021SR0168402	2020.07.10	原始取得
31	明弘 USB 三种模式兼容系统	深圳光弘通信科技有限公司	2021SR0168401	2020.07.01	原始取得
32	明弘触摸屏系统	深圳光弘通信科技有限公司	2018SR298820	2015.11.19	原始取得
33	明弘按键中断调试系统	深圳光弘通信科技有限公司	2018SR298790	2017.12.15	原始取得
34	明弘充电调试系统	深圳光弘通信科技有限公司	2018SR298815	2017.12.15	原始取得
35	H222 电动踏杠控制器软件	深圳光弘通信科技有限公司	2018SR182143	未发表	原始取得
36	一种测试程序防呆调用软件 V1.0	嘉兴光弘科技电子有限公司	2024SR0574990	未发表	原始取得

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日	取得方式
37	智能货架仓库自动盘点系统 V1.0	嘉兴光弘科技电子有限公司	2022SR0856277	未发表	原始取得
38	光弘维修管理系统 V1.0	嘉兴光弘科技电子有限公司	2020SR0016005	2019.08.20	原始取得
39	光弘通用包装管理系统 V1.0	嘉兴光弘科技电子有限公司	2020SR0020587	2019.09.22	原始取得
40	光弘电子看板系统 V1.0	嘉兴光弘科技电子有限公司	2020SR0020274	2019.06.25	原始取得
41	光弘 WIP 管理系统 V1.0	嘉兴光弘科技电子有限公司	2020SR0018894	2019.03.25	原始取得
42	光弘智能质量隔离管理系统 V1.0	嘉兴光弘科技电子有限公司	2018SR898737	2018.03.20	原始取得
43	光弘智能自动停线管理系统 V1.0	嘉兴光弘科技电子有限公司	2019SR0017299	2018.07.10	原始取得
44	光弘锡膏管控系统	嘉兴光弘科技电子有限公司	2017SR241547	2016.02.28	原始取得
45	光弘通用测试数据采集系统	嘉兴光弘科技电子有限公司	2017SR255546	2016.01.30	原始取得
46	光弘 IQC 检验管理系统	嘉兴光弘科技电子有限公司	2017SR256405	2016.01.21	原始取得
47	光弘通用组装关系采集系统	嘉兴光弘科技电子有限公司	2017SR258439	2016.02.28	原始取得
48	光弘仓库系统发料管控系统	嘉兴光弘科技电子有限公司	2017SR258457	2016.01.25	原始取得
49	光弘通用人工检查管控系统	嘉兴光弘科技电子有限公司	2017SR255536	2016.02.19	原始取得
50	DBG MES IQC 系统 [简称: DBG MES] V3.0	嘉兴光弘科技电子有限公司	2021SR1510427	未发表	原始取得
51	DBG MES 资产管理系统 [简称: 资产管理] V3.0	嘉兴光弘科技电子有限公司	2021SR1510452	未发表	原始取得
52	应收逾期款风险冻结系统 V1.0	嘉兴光弘科技电子有限公司	2022SR0856029	未发表	原始取得

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日	取得方式
53	MES 系统功能-不良率超标自动停线系统 V1.0	快板电子科技（上海）有限公司	2024SR1117542	未发表	原始取得
54	ERP 数据集成	快板电子科技（上海）有限公司	2024SR1117544	未发表	原始取得
55	MES 系统功能-员工技能管理及操作控制系统 V1.0	快板电子科技（上海）有限公司	2024SR1108008	未发表	原始取得
56	MES 系统功能-维修池管理系统 V1.0	快板电子科技（上海）有限公司	2024SR1099328	未发表	原始取得
57	MES 系统功能-智能包装及条码打印系统 V1.0	快板电子科技（上海）有限公司	2024SR0804470	未发表	原始取得

附件七：发行人及其子公司集成电路布图设计情况

序号	布图设计名称	布图设计登记号	布图设计申请日期	登记证书号	布图设计权利人
1	智能手机处理器芯片	BS.20561387X	2020.12.04	第 39682 号	深圳光弘通信科技有限公司
2	新型车载网关组件域控制架构电路	BS.245538178	2024.05.30	第 85701 号	深圳光弘通信科技有限公司

附件八：发行人及其子公司域名情况

序号	域名	权利人	到期日
1	dbg.com.cn	发行人	2028.07.04
2	hzdbg.cn	发行人	2028.11.29
3	hzdbg.com.cn	发行人	2028.11.29
4	dbg.ltd	发行人	2034.03.25
5	jx-dbg.com.cn	嘉兴光弘科技电子有限公司	2029.06.10
6	allCircuits.website	BMS Circuits S.A.S.	2025.09.16
7	allCircuits.eu	All Circuits S.A.S.	2026.09.30
8	allCircuits.fr	All Circuits S.A.S.	2025.09.09
9	allCircuits-technologies.com	All Circuits S.A.S.	2025.11.24
10	allCircuits-technologies.eu	All Circuits S.A.S.	2026.11.18
11	allCircuits-technologies.fr	All Circuits S.A.S.	2025.11.24
12	bmsCircuit.com	All Circuits S.A.S.	2025.11.29
13	bms-Circuit.com	All Circuits S.A.S.	2025.11.29
14	bmsCircuit.fr	All Circuits S.A.S.	2025.11.29
15	bms-Circuit.fr	All Circuits S.A.S.	2025.11.29
16	bmsCircuits.com	All Circuits S.A.S.	2025.11.29
17	bms-Circuits.com	All Circuits S.A.S.	2025.11.29
18	bmsCircuits.fr	All Circuits S.A.S.	2025.11.29
19	bms-Circuits.fr	All Circuits S.A.S.	2025.11.29
20	mslCircuit.com	All Circuits S.A.S.	2025.10.05
21	msl-Circuit.com	All Circuits S.A.S.	2025.10.05
22	mslCircuits.com	All Circuits S.A.S.	2025.10.05
23	msl-Circuits.com	All Circuits S.A.S.	2025.10.05
24	tisCircuit.com	All Circuits S.A.S.	2025.11.29
25	tis-Circuit.com	All Circuits S.A.S.	2025.11.29
26	tisCircuits.com	All Circuits S.A.S.	2025.11.29
27	tis-Circuits.com	All Circuits S.A.S.	2025.11.29

附件九：发行人及其子公司经营资质情况

1. 国家强制性产品认证

序号	证书编号	生产厂	有效期至
1	2025011606780481	发行人	2026.01.05
2	2025010902776478	发行人	2030.05.07
3	2025011606768575	发行人	2029.09.03
4	2025010902763442	发行人	2030.03.25
5	2025011606761180	发行人	2030.03.11
6	2025010902757135	发行人	2026.01.05
7	2025011606755616	发行人	2030.02.18
8	2024011606655458	发行人	2030.01.20
9	2024010902726811	发行人	2027.04.07
10	2024011606726592	发行人	2025.11.19
11	2024011606691082	发行人	2029.09.10
12	2024011606643932	发行人	2029.06.17
13	2024011606615670	发行人	2029.03.26
14	2024011606708408	发行人	2029.09.03
15	2024010902623312	发行人	2029.04.22
16	2024011606691085	发行人	2029.09.10
17	2024011606669219	发行人	2028.11.30
18	2024011606664105	发行人	2029.07.24
19	2024010902659275	发行人	2029.07.16
20	2024011606635183	发行人	2029.05.28
21	2024011606604894	发行人	2028.11.29
22	2023010902556038	发行人	2028.07.11
23	2024010902638902	发行人	2029.06.05
24	2024010902648637	发行人	2029.06.27
25	2024010902644936	发行人	2029.06.19
26	2019011606210233	发行人	2029.06.13
27	2024010902640807	发行人	2029.06.10
28	2019011606206169	发行人	2029.06.10
29	2024011606635189	发行人	2029.05.28

序号	证书编号	生产厂	有效期至
30	2024011606628530	发行人	2026.01.05
31	2023011606570926	发行人	2028.09.10
32	2023010902542904	发行人	2028.05.09
33	2022010902477182	发行人	2027.06.15
34	2022010902513288	发行人	2027.11.30
35	2023010902563290	发行人	2028.08.10
36	2024011606603345	发行人	2029.01.18
37	2021010902370100	发行人	2026.02.20
38	2024011606602519	发行人	2029.01.15
39	2023010902544629	发行人	2028.05.16
40	2022011606464685	发行人	2027.04.25
41	2023010902552155	发行人	2028.06.19
42	2023010902527603	发行人	2028.03.05
43	2021011606378689	发行人	2026.04.02
44	2023010902530175	发行人	2028.03.15
45	2023011606541587	发行人	2028.05.04
46	2023010902520246	发行人	2028.01.11
47	2023011606520145	发行人	2028.01.11
48	2023011606547966	发行人	2028.05.31
49	2023011606541891	发行人	2028.05.05
50	2021011606441817	发行人	2026.12.29
51	2020011606357269	发行人	2025.12.24
52	2022011606495007	发行人	2027.09.04
53	2021011606387629	发行人	2026.05.10
54	2023011606527264	发行人	2028.03.02
55	2023011606580691	发行人	2026.01.05
56	2023011606536835	发行人	2028.04.12
57	2023010902586192	发行人	2028.11.09
58	2023010902586205	发行人	2028.11.09
59	2023011606581456	发行人	2028.11.07
60	2023011606584474	发行人	2028.11.05
61	2023011606580942	发行人	2025.11.19
62	2023011606578726	发行人	2028.10.15

序号	证书编号	生产厂	有效期至
63	2022011606508358	发行人	2026.01.06
64	2023011606560560	发行人	2028.07.30
65	2023011606575522	发行人	2028.09.26
66	2023011606574577	发行人	2028.09.24
67	2023011606574204	发行人	2028.09.21
68	2023010907567110	发行人	2028.08.22
69	2023011606566881	发行人	2026.01.05
70	2023011606557202	发行人	2028.07.16
71	2023011606525986	发行人	2028.02.23
72	2022011606514165	发行人	2025.11.19
73	2022011606514164	发行人	2025.11.19
74	2023011606531279	发行人	2028.03.21
75	2023010902531114	发行人	2028.03.21
76	2023011606531867	发行人	2028.03.26
77	2022011606486012	发行人	2027.07.24
78	2022011606478610	发行人	2027.06.22
79	2022010902474942	发行人	2027.06.15
80	2021010902432878	发行人	2026.11.18
81	2022010902482781	发行人	2027.07.10
82	2022011606498276	发行人	2027.09.19
83	2022011606486009	发行人	2027.08.08
84	2022011606456489	发行人	2027.03.20
85	2022011606462061	发行人	2027.04.12
86	2022011606490124	发行人	2027.08.14
87	2023011606531453	发行人	2028.03.22
88	2025011606780481	发行人	2026.01.05
89	2025010902776478	发行人	2030.05.07
90	2025011606768575	发行人	2029.09.03
91	2025010902763442	发行人	2030.03.25
92	2025011606761180	发行人	2030.03.11
93	2025010902757135	发行人	2026.01.05
94	2025011606755616	发行人	2030.02.18
95	2023011606531452	惠州光弘通讯技	2028.01.30

序号	证书编号	生产厂	有效期至
		术有限公司	
96	2023011606580151	惠州光弘通讯技术有限公司	2028.09.26
97	2023011606579918	惠州光弘通讯技术有限公司	2028.09.26
98	2023011606579338	惠州光弘通讯技术有限公司	2028.08.24
99	2022011606492349	惠州光弘通讯技术有限公司	2027.06.29

2. 报关单位备案证明

序号	主体	海关备案编码	所在地海关	有效期
1	发行人	4413930323	深惠州关	长期
2	惠州光弘通讯技术有限公司	4413960BD2	深惠州关	长期
3	嘉兴光弘科技电子有限公司	3304966193	嘉兴海关	长期
4	快板电子科技（嘉兴）有限公司	3304960CMG	嘉兴海关	长期
5	快板电子科技（上海）有限公司	3104340304	沪徐汇关	长期
6	深圳光弘通信科技有限公司	4403961XEM	福中海关	长期

3. 固定污染源排污登记回执

序号	公司	登记编号	有效期
1	发行人	914413006178909639002Y	2024.03.13-2029.03.12
2	光弘电子（惠州）有限公司	91441303MA575WMQX5001W	2021.09.29-2026.09.28
3	嘉兴光弘科技电子有限公司	91330401355367389G001Y	2025.05.13-2030.05.12
4	快板电子科技（上海）有限公司	91310000607411244G001U	2023.05.16-2028.05.15